

股票简称：先锋精科

股票代码：688605

江苏先锋精密科技股份有限公司

(Sprint Precision Technologies Co., Ltd.)

(江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号)



向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 募集说明书 (申报稿)

保荐人（主承销商）



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

公告日期：2026 年 4 月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，先锋精科主体信用级别为 **AAst1**，本次可转换公司债券信用级别为 **AA**，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况

（一）公司持股 5%以上股东的认购情况

1、优立佳合伙、英瑞启、优正合伙

公司持股 5%以上的股东优立佳合伙、英瑞启、优正合伙将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本企业决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本企业将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守中国证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本企业将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的，由此所得收益全部归先锋精科所有，本企业将依法承担由此产生的法律责任。”

2、游利、李欢

公司持股 5%以上的股东游利、李欢将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定

是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本人决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的，由此所得收益全部归先锋精科所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司董事、高管参与本次可转债的认购情况

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如先锋精科启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购先锋精科本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。

2、如届时本人决定认购先锋精科本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得先锋精科本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持先锋精科本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票或可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或

协议转让等方式)进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为,不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持先锋精科股票或可转债的,由此所得收益全部归先锋精科所有,本人将依法承担由此产生的法律责任。”

公司独立董事不参与本次可转债认购,并出具承诺:

本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购,并自愿接受本承诺函的约束。如本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文,并特别注意以下风险:

(一) 行业周期性风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业是半导体行业上游,半导体行业的整体发展情况会对公司所处行业产生较大影响。受扩产周期、创新周期等因素的叠加作用,半导体行业具有典型的周期性特点,通常每 4-5 年完成一轮周期波动,呈螺旋式上升的特点,其中 2-3 年处于上行通道,3-6 个季度处于下行通道。在经历了 2021-2022H1 的较快增长后,2022H2 由于下游消费电子需求疲软,产能紧张时期的供应链库存累积,全球半导体市场进入下行周期,该下行周期在 2023 年下半年起逐渐复苏,并在 2024 年重新进入上升周期。

在行业处于周期性上行通道时,公司需要保持及提高产能来满足产业链下游客户快速提升的需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长,可能会导致公司失去既有或潜在客户;在行业处于周期性下行通道时,计算机、消费电子等终端消费市场需求下降,晶圆厂继而削减资本性支出,对公司产品的需求亦可能下降。

虽然长期看,半导体行业作为电子信息产业的基石,人类社会智能化、数字

化的大趋势将继续演进，半导体行业的长期需求将持续向好，但在行业处于周期性下行通道时，因晶圆制造企业、半导体设备企业削减资本性支出，公司新增订单可能出现下滑，进而影响公司的经营业绩。

（二）半导体功能器件拓展风险

报告期内，发行人收入主要来自于半导体精密零部件，以不带功能的关键工艺部件和工艺部件为主，功能器件收入占比较少。以晶圆加热器为代表的功能器件是发行人对现有精密零部件业务板块产品的丰富、延伸和升级，系围绕现有主营业务展开。发行人基于产品专精的特点，能够将零部件生产制造技术和经验进一步推广至功能器件。

虽然发行人具备研发和量产功能器件对应的人员、技术能力和生产能力，并已经过较长时间的研发积累，但由于发行人在相关产品的人员储备相对不足、先进陶瓷生产工艺尚未完全成熟、新产品开发成本较高，如未来发行人功能器件相关产品市场拓展不及预期，将对发行人盈利能力产生不利影响。

（三）业绩及毛利率下降的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 55,771.69 万元、113,577.41 万元和 123,772.76 万元，2023-2025 年复合增长率为 48.97%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,978.54 万元、21,373.27 万元和 18,608.72 万元，公司主营业务毛利率分别为 29.13%、33.36%和 28.59%。

2025 年度，发行人营业收入同比增长 8.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降 12.93%，主要原因系主营业务毛利率同比下降 4.77%，主营业务毛利率下降的主要原因系：1、公司根据市场需求及发展规划进行了适度的产能预增，2025 年度，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，但下游行业在经历 2023 年下半年、2024 年扩产后进入新增产能消纳阶段，下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得充分吸收；2、为应对下游客户需求，当年员工规模同比提高，导致薪酬支出增加；3、随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品质量要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升。

如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、公

司不能有效拓展国内外新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业化等原因导致产能利用率下降，公司主营业务毛利率将下降，公司将面临一定的经营压力，未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

（四）募集资金用于拓展新产品的风险

本次募投项目中，“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”产品主要为陶瓷加热器，系公司基于现有半导体精密零部件业务所拓展的新材质产品。目前，该项目的产线投建、产品研制、客户验证及销售等均处于相对早期阶段，若公司最终无法顺利建设新材质功能器件产线并实现量产，或新产品无法及时通过下游客户验证、受技术迭代影响市场需求及单价下降等，该募投项目可能存在实施失败、新增产能无法消化等风险，进而对公司业绩产生不利影响。

（五）募投项目研发失败的风险

本次募集资金投资项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”的研发方向为静电吸盘。静电吸盘为半导体设备核心高端零部件，行业在精密加工、分区温控、表面处理及洁净制造等环节存在较高技术壁垒，项目研发难度大、周期较长、资金投入较高。若公司在研发过程中未能攻克关键核心技术、研发进度不及预期，或研发成果无法满足下游客户严苛认证要求、技术路线与行业发展趋势不匹配，将导致项目研发失败。项目研发失败可能使公司无法实现预期研发及产业化目标，前期投入难以收回，进而对公司技术布局、产品拓展及经营业绩产生不利影响。

（六）募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目、半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目和半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目，募投项目涉及现有产品产能扩建、新产品拓展、技术研发等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着集成电路产业和半导体设备行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，如若公司处理不当，募投项目

存在不能达到预期收益或新增产能难以消化的风险,进而对公司经营业绩产生不利影响。

(七) 募投项目产能消化风险

公司本次募集资金投资项目的实施将会新增金属加热器、陶瓷加热器的产能,相关产品主要应用于薄膜沉积设备等半导体核心设备。

当前半导体陶瓷加热器的主要市场份额主要由 NGK、MiCo 等境外龙头厂商占据,中国境内优秀企业如珂玛科技等已经实现对下游客户的批量销售,但相关产品在国内尚处于起步阶段。在国产半导体设备供应链安全需求下,本土厂商的导入和验证将提速,由此半导体陶瓷加热器将迎来广阔发展空间。此外,本土同行业公司也在导入金属加热器产能。

公司本次募投募集资金投资项目虽经过市场分析和论证,但考虑到境外优势半导体陶瓷领先企业和本土同行业公司相关产品产业化投入的形势下,募投产品在未来市场竞争中可能面临产销率不及预期的风险,进而对公司经营业绩产生不利影响。

六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

(一) 公司利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规对于利润分配政策的规定以及《公司章程》的规定,公司的利润分配政策如下:

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

2、利润分配的方式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司具备现金分红条件的,应当优先以现金方式进行股利分配;采用股票股利进行利

利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的期限间隔

公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件时，原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红。

4、现金分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，且经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

满足公司章程规定的现金分红的条件下，且公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，则公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%；重大投资计划或重大资金支出是指公司在一年内拟购买资产以及对外投资等交易涉及的累计支出超过最近一期经审计净资产的 10%或者资产总额的 5%。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、发放股票股利的具体条件

如果公司有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足公司章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配；

采用股票股利分配方式的将结合公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

6、公司利润分配的决策机制和程序

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划制定，董事会对利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。

(2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

(3) 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。

公司董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。

(4) 利润分配预案经审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。股东会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

(5) 公司年度盈利且可供分配利润为正数但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途。

7、利润分配政策调整的决策机制与程序

(1) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所以

有关规定。

(2) 公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况进行一次评估，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，决定是否对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

(3) 公司董事会在审议调整利润分配政策时，必须经全体董事的过半数表决同意通过。审计委员会在审议利润分配政策调整时，须经全体审计委员会成员过半数表决同意通过。

(4) 利润分配政策调整应当分别经董事会和审计委员会审议通过后方能提交股东会审议。股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意。公司股东会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。

(二) 本次发行前后公司利润分配政策变化情况

本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

(三) 最近三年利润分配情况

最近三年内，公司利润分配情况如下：

1、2025 年度利润分配情况

公司 2025 年度计划现金分红总额为 2,023.80 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 10.71%。上述分红方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

2、2024 年度利润分配情况

公司 2024 年度现金分红总额为 4,047.60 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 18.92 %。

3、2023 年度利润分配情况

2023 年度，公司未进行利润分配。

4、公司最近 3 年利润分配情况

公司 2023 年至 2025 年利润分配情况如下所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	18,889.58	21,394.62	8,027.50
现金分红金额（含税）	2,023.80	4,047.60	-
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	10.71	18.92	-
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-	-	-
各年现金分红金额小计（含税）	2,023.80	4,047.60	-
最近三年现金分红金额小计（含税）			6,071.40
最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润			16,103.90
最近三年现金分红金额占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比率			37.70

注：2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准

综上，公司利润分配情况符合公司章程及股东回报规划的要求。

（四）公司最近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常的生产经营，以支持公司未来战略规划和可持续性发展。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项	2
四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况	3
五、特别风险提示	5
六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况	8
目 录	13
第一节 释 义	16
一、一般术语	16
二、专业术语	18
第二节 本次发行概况	21
一、公司基本情况	21
二、本次发行的背景和目的	21
三、本次发行的基本情况	25
四、本次发行可转债的基本条款	30
五、本次发行的有关机构	40
六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系	41
第三节 风险因素	42
一、与发行人相关的风险	42
二、与行业相关的风险	45
三、其他风险	46
第四节 发行人基本情况	51
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况	51
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施	51
三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况	53
四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况	56
五、承诺事项及履行情况	58
六、董事、高级管理人员、其他核心人员	61
七、发行人所处行业的基本情况	68
八、发行人主要业务的有关情况	75

九、与产品或服务有关的技术情况	87
十、主要固定资产及无形资产	94
十一、最近三年的重大资产重组情况	107
十二、境外经营情况和境外资产情况	107
十三、报告期内的分红情况	107
十四、最近三年已公开发行人公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形	111
十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息	111
第五节 财务会计信息与管理层分析	112
一、审计意见	112
二、财务报表	112
三、发行人合并财务报表范围及变化情况	117
四、主要财务指标	118
五、会计政策变更和会计估计变更	119
六、财务状况分析	121
七、经营成果分析	138
八、资本性支出分析	154
九、技术创新分析	155
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项	164
十一、本次发行的影响	164
第六节 合规经营与独立性	165
一、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况	165
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况 ..	165
三、同业竞争情况	165
四、关联方和关联交易	167
第七节 本次募集资金运用	177
一、本次募集资金投资项目计划	177
二、本次募集资金投资项目的具体情况	177
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	195
四、本次募集资金投资项目的资本化情况	196
第八节 前次募集资金的使用情况	198
一、前次募集资金基本情况	198

二、前次募集资金使用情况	199
三、注册会计师对前次募集资金使用情况的审核意见	203
四、前次募集资金项目实施后有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等情况	203
五、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	205
第九节 声明	206
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明.....	206
二、发行人控股股东、实际控制人声明	207
三、保荐人声明.....	208
四、发行人律师声明	210
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明	211
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明	212
七、董事会声明.....	213
第十节 备查文件.....	214

第一节 释 义

一、一般术语

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

《募集说明书》	指	《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》
发行人、公司、本公司、先锋精科	指	江苏先锋精密科技股份有限公司
靖江先捷	指	靖江先捷航空零部件有限公司，为发行人子公司
无锡先研	指	无锡先研新材料科技有限公司，为发行人子公司
先锋精密（新加坡）	指	Sprint Precision Technologies（Singapore）PTE. LTD.,为发行人子公司
无锡至辰	指	无锡至辰科技有限公司，为发行人孙公司
ULYC（新加坡）	指	ULYC PTE. LTD., 为发行人前孙公司，已注销
ULYC（香港）	指	ULYC（HONG KONG）PTE. LTD.,为发行人控股股东、实际控制人游利曾控制的企业，已注销
首发募投项目	指	发行人首次公开发行股票募集资金投资项目
优立佳合伙	指	靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人持股 5%以上的股东
英瑞启	指	上海英瑞启技术咨询有限公司，曾用名“连云港英瑞启技术咨询有限公司”，为发行人持股 5%以上的股东
优正合伙	指	靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人持股 5%以上的股东
优合合伙	指	靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688012.SH，为发行人客户、股东
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司，深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为 002371.SZ，为发行人客户
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688981.SH，为发行人客户
拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688072.SH，为发行人客户
华海清科	指	华海清科股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688120.SH，为发行人客户
屹唐股份	指	北京屹唐半导体科技股份有限公司及其合并范围内子公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688729.SH，为发行人客户
微导纳米	指	江苏微导纳米科技股份有限公司及其同一控制下公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688147.SH，为发行人客户
中硅泰克	指	北京中硅泰克精密技术有限公司及其同一控制下公司，为发行人客户

富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688409.SH，为发行人同行业公司
珂玛科技	指	苏州珂玛材料科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为 301611.SZ，为发行人同行业公司
托伦斯	指	托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司，深圳证券交易所创业板在审企业，为发行人同行业公司
NGK	指	NGK 株式会社，半导体陶瓷加热器、静电吸盘（ESC）等高端功能器件领域的国际龙头企业，东京证券交易所上市公司，股票代码为 5333.T
MiCo	指	MiCo Co., Ltd.，全球半导体先进陶瓷器件领域的重要供应商，韩国科斯达克上市企，股票代码为 059090.KS
靖江佳仁	指	靖江佳仁半导体科技有限公司，报告期内曾经存在的关联方，已注销
佳佳精密	指	靖江佳佳精密机械科技有限公司，为发行人关联方
靖江顺希	指	靖江市顺希再生资源回收有限公司，报告期内曾经存在的关联方，已注销
靖江佳晟	指	靖江佳晟真空技术有限公司，为发行人关联方
大晟航空	指	靖江大晟航空科技有限公司，报告期内曾经存在的关联方
股东会	指	江苏先锋精密科技股份有限公司股东会
董事会	指	江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
本次发行	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券
可转债	指	可转换公司债券
《公司章程》	指	《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》
报告期、最近三年	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末及 2025 年末
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
保荐人、保荐人（主承销商）华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元、资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司

二、专业术语

半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间、加热后可实现单向导通的材料
集成电路 (IC)	指	Integrated Circuit , 指将一定数目的三极管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一个芯片里, 从而实现电路或者系统功能的电路或系统
硅片	指	用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料, 又称裸晶圆
晶圆	指	在裸晶圆上通过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工形成的具有特定电性功能的集成电路产品
芯片	指	集成电路载体, 是集成电路经设计、制造、封装、测试后的结果
先进制程、成熟制程	指	晶体管中栅极的宽度 (也成制程)。宽度越窄, 晶体管就越小, 电流通过时的损耗越低, 性能也越高, 制造工艺也更复杂。先进制程指 7nm 及以下制程, 成熟制程指大于 7nm 制程。
半导体设备	指	用于光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等半导体器件 (主要为集成电路产品) 制造环节的生产设备
光刻	指	光刻是平面型晶体管和集成电路生产中的一个主要工艺。是对半导体晶片表面的掩蔽物 (如二氧化硅) 进行开孔, 以便进行杂质的定域扩散的一种加工技术
离子注入/扩散	指	微电子工艺中的一种重要的掺杂技术, 在真空中、低温下, 把杂质离子加速, 离子束与材料中的原子或分子将发生一系列物理的和化学的相互作用, 从而优化材料表面性能, 或获得某些新的优异性能
退火	指	一种金属热处理工艺, 指的是将金属缓慢加热到一定温度, 保持足够时间, 然后以适宜速度冷却。该工艺可实现降低硬度、去除金属内部应力、改善切削加工性、稳定尺寸、减少变形与裂纹倾向等作用
刻蚀	指	半导体前道工序之一, 用化学或物理方法有选择地在晶圆表面去除不需要的材料的过程, 是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺, 是半导体制造工艺的关键步骤
薄膜沉积	指	半导体前道工序之一, 半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺, 这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料。薄膜沉积设备主要包括 PVD (物理气相沉积)、CVD (化学气相沉积) 和 ALD (原子层沉积) 设备等, 是半导体制造工艺的关键步骤
MOCVD 设备	指	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (金属有机化合物化学气相沉积), 是外延片生产的核心设备, 是 CVD (化学气相沉积) 实现路径中的一种
PECVD 设备	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (等离子体增强化学气相沉积), CVD 的一种, 在沉积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化学反应沉积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法
切削	指	通过机械设备 (一般为数控机床) 精确地去除材料, 以获得一定形状和尺寸产品的制造方法
表面处理	指	利用物理、化学和热处理等学科的边缘性新技术来改变物体表面的状况和性质, 达到清洁零部件、延长零部件使用寿命或改造零部件的目的
阳极氧化	指	金属或合金的电化学氧化, 铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下, 在外加电流的作用下, 在铝制品 (阳极) 上形成一层氧化膜的过程
FSW 搅拌摩擦焊接	指	把一个高速旋转的搅拌工具插入待焊金属之间, 并使搅拌工具以一定速度向前运动, 通过轴肩及搅拌针的旋转使被焊金属加热到塑性状态, 而搅拌工具向前移动, 挤压、搅拌塑性材料, 使塑性材料形成一个稳定的流场, 在搅拌头移过的部位, 随着搅拌工具的移动, 温度逐渐冷却凝固形成焊缝

AlN 原料	指	氮化铝（Aluminum Nitride）粉体 / 坯料，是制备高热导、高绝缘、耐高温氮化铝陶瓷的核心原材料，广泛用于半导体设备、先进封装、晶圆制程关键部件。
静电吸盘（ESC）	指	ESC: Electrostatic Chuck，即静电吸盘，是半导体刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心设备的关键功能部件，主要用于在真空及等离子体环境下对晶圆进行无损伤吸附固定，并实现高精度温度均匀控制。
ERP/MES 系统	指	企业资源计划与制造执行相结合的信息化管理系统，实现从订单、计划、排产、加工、检验到入库的全流程数字化、可追溯管控，提升生产效率与产品一致性。
PPAP	指	Production Part Approval Process，即生产件批准程序，是汽车行业、半导体行业通用的零部件准入与质量认证体系，用于确认供应商是否正正确理解客户工程设计、规格及质量要求，并具备持续稳定生产合格产品的能力。
APQP	指	Advanced Product Quality Planning，即产品质量先期策划，是汽车及半导体行业通用的产品开发与质量管控方法，用于在产品研发、工艺设计、量产前进行全流程质量策划、风险预防、过程控制与验证，确保产品满足客户要求并实现稳定交付。
CNC	指	Computer Numerical Control，即计算机数字控制，指通过计算机程序自动控制机床的坐标运动、切削路径与加工精度，实现高精度、自动化的零部件切削加工。
YF ₃	指	三氟化钇（Yttrium Fluoride），高纯稀土氟化物材料，具备优异耐氟基等离子体腐蚀性能，主要用于半导体刻蚀设备腔体、内衬等部件的抗腐蚀涂层制备。
YOF	指	氟氧化钇（Yttrium Oxyfluoride），氧化钇与氟化钇的复合陶瓷材料，兼具耐高温、高致密度与优异抗等离子体腐蚀性能，是先进制程设备核心防护涂层材料。
YAG	指	钇铝石榴石（Yttrium Aluminum Garnet, Y ₃ Al ₅ O ₁₂ ），高性能稀土陶瓷材料，具备优良光学与结构稳定性，可用于半导体设备观察窗口及耐等离子体部件。
AD	指	Aerosol Deposition，即气溶胶沉积工艺，一种室温下直接将陶瓷颗粒高速喷射沉积形成致密涂层的技术，用于半导体部件高致密、高结合力防护涂层制备。
APS	指	Atmospheric Plasma Spraying，即大气等离子喷涂，利用高温等离子焰流融化粉末并高速喷射形成涂层，适用于大面积、厚膜陶瓷涂层制备。
HVOF	指	High Velocity Oxygen Fuel，即高速火焰喷涂，超音速火焰喷涂技术，形成高致密、高结合强度、低孔隙率的金属 / 陶瓷涂层，耐腐蚀性与耐磨性优异。
ALD	指	Atomic Layer Deposition，即原子层沉积工艺，单原子层逐次沉积，可制备超薄、均匀、台阶覆盖率优异的精密薄膜，广泛用于先进半导体制程与涂层。
EUV 光刻机	指	Extreme Ultraviolet Lithography，即极紫外光刻机，采用 13.5nm 极紫外光作为曝光光源，是 7nm 及以下先进制程芯片制造的核心设备。
真空钎焊	指	钎焊过程全部在真空设备中进行，当被连接的零件和钎料加热到钎料熔化时，利用液态钎料在母材表面间隙中湿润、毛细流动并母材相互溶解、扩散从而达到被连接零件间的连接，具有不氧化、无污染、变形小的优点，可实现多道钎缝、多个组件同焊接的高效工艺手段。
电子束焊接	指	将高能电子束作为加工热源，用高能量密度的电子束轰击焊件接头处的金属，使其快速熔融，然后迅速冷却来达到焊接的目的的焊接技术
CNC	指	计算机数字化控制精密机械加工

真空度	指	处于真空状态下的气体稀薄程度，一般单位用 Torr
纳米、nm	指	长度单位，1 纳米=10 ⁻⁹ 米
微米、μm	指	长度单位，1 微米=10 ⁻⁶ 米
Ra	指	衡量表面粗糙度的指标，指在取样长度内，实际表面距平面绝对值的算术平均值，Ra0.1 微米即多个测量点的表面偏离平面间距的平均值在 0.1 微米。

特别说明：

1、本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本募集说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：江苏先锋精密科技股份有限公司

英文名称：Sprint Precision Technologies Co., Ltd.

注册地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号

股票简称：先锋精科

股票代码：688605

股票上市交易所：上海证券交易所

二、本次发行的背景和目的

半导体晶圆制造是人类迄今最精密的微观制造活动，也是人类工业文明的终极浪漫。其技术突破不仅依赖设备创新，更在于对每一个精密零部件的极致掌控。半导体产业的每一次跃迁，需要的不仅是制造工艺的积累，更是系统性创新与产业链协同的深度融合。在纷繁多变的全球产业竞争格局下，半导体零部件不仅是一类产品，更是一条关乎产业链安全的道路——它象征着中国智造力量在核心技术领域成为可靠支点的决心。

公司自 2008 年创立以来，始终专注于半导体设备核心部件领域，完成了从单点技术突破到全链条能力构建的跨越，从协助客户设备研发定型，到支撑产线量产迭代，最终助力国产设备迈入先进制程领域，不仅是公司的成长轨迹，更是中国半导体装备自主化进程的缩影。作为半导体国产核心零部件先锋，公司核心零部件已深度融入国产关键设备“血脉”，成为支撑国产设备向先进制程跃迁的关键力量。但另一方面，全球半导体产业正加速向更先进制程、更精密结构演进，产业升级对零部件的精度、可靠性和集成度提出了更高挑战——扩大关键工艺器件的产能、向更高制程的零部件品类进军，已成为关乎国产设备产业链安全的必由之路，由此半导体关键工艺部件国产化需求迎来历史性发展机遇。面对历史性机遇，公司计划通过半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目，半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目和半导体设备用陶瓷静电吸盘

研发项目，加速攻关核心零部件技术壁垒，为国产设备零部件产业链安全增添关键助力。

（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券的背景

1、契合产业链安全的战略导向

半导体核心功能器件作为高端装备、新能源、电子信息等战略性新兴产业的核心器件，其自主化水平直接关系到产业链供应链安全稳定，因此我国积极推动产业链安全、制造业高质量发展、强化基础工业能力、以及攻克关键是核心技术的国家战略导向。

2016年12月，由国家发展改革委同科技部、工信部、财政部等部门牵头编制的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将夯实工业基础、突破核心环节作为战略性新兴产业发展的重要支撑，推动核心器件技术攻关与供给能力提升，为半导体金属器件产业发展提供了战略指引；2021年12月，由工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、科技部等八个部门联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出攻克基础技术与核心器件瓶颈，支持核心器件研发与产能扩张；2025年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》进一步明确“十五五”期间（2026-2030）集成电路产业发展目标：关键半导体设备国产化率突破70%，形成产业安全生态。

综上，一系列政策密集出台，明确了产业发展的战略定位，为半导体核心功能器件产业提供了全方位保障，本次募投项目与国家的战略导向高度契合，符合公司的发展规划与长期目标。

2、拥有扎实的技术储备，为项目实施构筑稳固技术根基

公司长期深耕半导体金属核心零部件制造领域，已构建起覆盖原材料加工、精密加工、表面处理、焊接等全流程的成熟工艺体系，核心制造环节历经长期产业化验证与持续优化，形成了兼具稳定性与可靠性的工艺标准。

此外，公司已在半导体先进制程非金属材料及器件领域完成了系统性、前瞻性的技术布局与研发储备，形成了覆盖“材料-工艺-装备-测试”的完整技术链，为本次拟实施的募投项目的产业化实施构筑了坚实的根基。

在材料体系与核心工艺方面，公司已深度介入氮化铝陶瓷的研发全流程。根据已有研发项目，公司明确了以粉末冶金为核心的技术路线，对 AlN 原料粉末选型与造粒、常压/热压烧结等关键工艺环节进行了专项技术攻关规划，旨在实现高导热率、低烧结变形的高性能半导体先进制程非金属材料及器件制备。针对加热器核心结构，公司已开展仿真设计、多层加热盘埋丝设计与热压成形、陶瓷粘接剂配方开发以及高温热压接合等先进工艺研究，以解决内部介质层均匀性、气密性及连接可靠性等技术难点。

在专用技术与装备层面，公司基于研发和生产目标，已规划了覆盖全工艺流程的专用设备方案，包括喷雾造粒系统、粉末压机、热压烧结炉、热压结合炉及各类精密加工与检测设备，如白光干涉仪，高精度工业 CT 设备等。

综上，公司对本次拟实施的募投项目已形成系统性的设计、清晰的工艺路线图和具体的研发行动计划。扎实的前期工作与技术储备，确保了本次拟实施的募投项目能够从目标明确、路径清晰的研发状态，高效有序地过渡到规模化量产，显著降低了技术不确定性带来的产业化风险。

3、利用现有客户资源，加快产品验证及缩短新产品导入周期

公司在半导体设备领域长期深耕，已与国内龙头半导体设备制造商建立了稳定深入的战略合作关系，并已进入其核心供应链体系。这一成熟的客户基础与销售渠道，为本次募投项目老产品扩产及新产品的市场导入提供了优势。

公司现有客户正是国产半导体先进制程设备的主要研发与生产者，其对更高性能、更高可靠性的半导体先进制程功能器件有明确且迫切的需求。公司的新产品研发方向对应客户与现有客户高度重合，市场对接精准，无需从零开始培育客户。凭借在半导体核心零部件领域长期合作所建立的品质信誉，新产品可以借助现有合作关系，更顺畅地与客户对接。公司对客户的设备性能、交付标准有深刻理解，能够更有针对性地进行产品开发与验证，从而加速样品测试、小批量试用直至批量供应的全过程。

此外，半导体先进制程非金属材料及器件与现有主营产品在下游客户设备中属于配套关系。公司可利用现有产品线提供整体解决方案，增强客户黏性，同时带动新产品的销售。客户也更倾向于向已证明可靠性的一级供应商采购新品类产

品，以降低供应链管理复杂度与风险。

综上，本次募投项目并非面向陌生市场进行开拓，而是对现有客户需求的价值延伸。此外，现有客户对陶瓷加热器有明确的产品需求，现有客户资源将成为新产品快速实现市场突破、快速形成销售规模的最有力保障，提高了项目的市场成功率和投资回报确定性。

（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券的目的

1、加快产品性能迭代提升，完善公司高端领域产品布局

以刻蚀、薄膜沉积为代表的前道核心设备对先进制程功能器件需求持续攀升，拉动了对金属加热器、陶瓷加热器等关键功能器件的采购需求。公司作为国内少数能够进入主流设备商供应链并实现批量交付的供应商，已与中微公司、北方华创、拓荆科技等行业龙头建立了稳固的合作关系。

在此背景下，公司需要加快现有主营产品性能迭代升级、完善高端领域产品布局，更加主动规划并匹配客户未来的扩产节奏与技术升级需求。

现有产品线中，金属及陶瓷加热器是公司现阶段重点升级和突破方向。其中，金属加热器是公司成熟产品，但受限于现有厂房及洁净制造环境，亟需突破产能瓶颈；陶瓷加热器是现有成熟产品的延伸与升级，同样受制于现有生产场地的物理空间与环境控制能力，因此，建设具备高阶工艺控制能力的制造基地成为必然，以支撑公司未来技术迭代。

综上，本项目的实施直接响应了下游市场对产品技术指标的持续提升需求，通过建立先进制造能力，不仅能巩固与现有战略客户的合作，更有助于切入高端市场建设具备高阶工艺控制标准的制造基地，是公司突破当前发展瓶颈的必然选择。本项目通过提供与之相适应的硬件设施与工艺平台，将为公司巩固行业领先地位奠定坚实基础。

2、开辟新增长曲线，优化公司产品与盈利结构

当前，半导体制造技术向更高制程的快速演进，对设备核心模块的性能与集成度提出了系统性升级要求。半导体功能器件（如金属及陶瓷加热器）具备独立、完整的物理功能与电气特性，是直接决定设备工艺性能的核心模块，其技术壁垒

与附加值高于基础结构件。然而，此类高端功能器件市场目前主要由少数国际厂商主导，是我国半导体产业链安全的关键短板之一。

公司长期深耕半导体设备金属零部件制造，已建立稳固的市场地位和成熟的工艺体系。但单一依赖金属零部件产品，使公司业务结构与盈利能力面临瓶颈，难以充分适应下游技术快速迭代和材料升级的趋势。通过扩大金属加热器的产能、研发制造陶瓷加热器，将显著提升半导体核心功能器件产品在公司收入中的占比，优化盈利结构，增强抗风险能力。

3、攻克核心功能器件技术壁垒，突破瓶颈

在公司目前关键工艺部件结构中，陶瓷加热器及静电吸盘（ESC）是尚未量产的两大功能器件，也是半导体刻蚀与薄膜沉积设备中负责固定、控温及传导射频信号的核心部件，其技术性能直接决定先进制程工艺的精度与稳定性，属于我国半导体设备产业链中亟待突破的关键环节。

伴随下游半导体设备国产化进程的加速与深入，国产供应链正从工艺部件、结构部件等外围部件向静电吸盘、射频电源等核心功能器件深化，这一趋势对从业企业的技术纵深、跨学科研发能力及与主机设备的协同创新提出了更高要求。

目前，国内半导体功能器件头部公司虽已量产相关产品，但在下游应用中，仍然存在部分缺陷，例如产品使用寿命不及预期等。公司拟依托自身在功能器件领域的长期实践经验和对难熔金属粉末冶金材料科学的深入研究，通过自研技术探索解决方案。

通过本次募投项目的实施，公司能够系统构建半导体核心功能器件从设计仿真、材料制备到精密加工、测试验证的全链条自主能力，显著提升公司在跨学科技术融合、原始创新与系统集成方面的核心能力，补齐半导体核心设备的核心晶圆反应区域中的关键工艺部件的最后一块“短板”，为抢占下一代半导体设备技术制高点、开拓更广阔的战略市场奠定坚实基础。

三、本次发行的基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可

转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

本次拟发行可转换公司债券总额不超过 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行价格按债券面值发行。

（三）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债预计募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（四）募集资金投向

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不

改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（五）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（六）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：【 】-【 】。

（七）发行费用

单位：万元

项目	金额
承销保荐费用	【 】
律师费用	【 】
审计费用	【 】
资信评级费用	【 】
信息披露及发行手续等费用	【 】
合计	【 】

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	发行安排
T-2 日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 日	网上路演；原股东优先配售股权登记日
T 日	刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日
T+1 日	原有限售条件股东网下优先认购资金验资
T+2 日	网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量及网下配售比率、网上中签率；网上申购配号
T+3 日	刊登网上中签率和网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足

日期	发行安排
T+4 日	刊登网上中签率和网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。申请上市的证券交易所为上海证券交易所。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

（十）本次发行可转债规模合理性分析

截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人净资产为 164,326.80 万元，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元。本次发行完成后，假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股，且不考虑可转债计入所有者权益部分的金额，预计发行人累计债券余额为 75,000.00 万元，占 2025 年末发行人净资产的比例为 45.64%，未超过 50%。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司资产负债率分别为 30.54%、25.04%和 24.57%，具有合理的资产负债结构，不存在重大偿债风险。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 7,978.54 万元、21,373.27 万元和 18,608.72 万元，平均可分配利润为 15,986.84 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 75,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

综上，公司本次发行可转换公司债券的规模具有合理性。

(十一) 本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

1、关于本次证券发行数量

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关于融资间隔

上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。

前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

公司本次发行可转债不适用上述规定，符合融资时间间隔的要求。

3、关于募集资金金额及投向

本次募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

本次募集资金主要投向主业。本次募投项目“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”是公司对现有产能的扩充升级，旨在突破现有产能瓶颈，满足下游客户持续增长的订单需求，同时通过建设高规格生产车间，满足半导体产业链升级迭代所带动的对设备零部件更高标准的生产环境和核心性能指标要求；本次

募投项目“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”旨在通过开发陶瓷加热器填补国内缺口，同时突破公司现有业务领域，开辟全新增长曲线，优化公司产品与盈利结构，提升公司细分领域市场地位；本次募投项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”以公司在半导体设备零部件领域十余年的技术储备为基础，围绕半导体设备中重点关键产品静电吸盘（ESC）进行研发，攻克核心部件技术壁垒，进一步巩固公司技术领先优势。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

四、本次发行可转债的基本条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（九）转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转

股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

(十) 转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十三) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在满足附加回售条件后，可以在公司公告的回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利和义务

（1）债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

②根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公

司股票；

③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

⑤依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定享有其作为债券持有人的信息知情权；

⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债的存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 拟修改可转债持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(5) 公司发生减资（因实施员工持股计划或股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(7) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；

(9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 公司提出债务重组方案的；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(十八) 本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十九）募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十一）评级事项

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，先锋精科主体信用级别为 AAsti，本次可转换公司债券信用级别为 AA，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

（二十二）本次发行方案的有效期限

本次向不特定对象发行可转债方案的有效期限为 12 个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

五、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	江苏先锋精密科技股份有限公司
法定代表人	游利
住所	江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号
董事会秘书	XIE MEI
联系电话	0523-85110266

（二）保荐人（主承销商）

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
保荐代表人	刘天宇、金鸣
项目协办人	李雨滋
项目组成员	朱辉
联系电话	010-56839300
传真号码	010-56839300

（三）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
机构负责人	沈国权
住所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
经办律师	阙莉娜、李珊珊
联系电话	021-20511000
传真号码	021-20511999

（四）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经办注册会计师	赵勇、胡国仁、王伟青、杨天航
联系电话	021-23280000
传真号码	021-63392558

（五）申请上市证券交易所

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区浦东南路 528 号
联系电话	021-68808888
传真号码	021-68804868

（六）收款银行

名称	中国工商银行深圳振华支行
开户名称	华泰联合证券有限责任公司
账户号码	4000010209200006013

（七）资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509
经办人员	刘惠琼、李爱文
联系电话	0755-82872897
传真号码	0755-82872090

六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

截至 2025 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的先锋精科前 200 名股东的查询结果，除保荐人母公司控制的华泰创新投资有限公司依据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求实施跟投持有发行人 2,529,750 股，占发行人总股本的 1.25%外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、无法跟随技术升级迭代的风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业属于技术密集型行业，随着芯片制程的不断升级，半导体设备及半导体设备零部件厂商必须紧跟晶圆制造等产业链下游厂商的需求不断提高工艺水平以及产品性能，从而对公司的研发能力、工艺水平不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级优化，提升效率及良品率，公司必须及时研发相匹配的精密零部件产品以应对下游厂商不断提升的技术要求。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

2、技术人才流失与核心技术泄密的风险

随着市场需求的不断增长与行业竞争的日益激烈，半导体设备精密零部件行业对技术人才的需求不断提升，公司需长期维持技术人才充足、队伍稳定以保持市场竞争力。若无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。

同时，随着半导体行业技术壁垒的不断提高，核心技术对于公司保持和提升竞争力至关重要。自成立以来，公司高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因技术人才流失、员工工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而导致公司竞争力下降。

（二）经营风险

1、市场空间风险

相较于一般的机械设备零部件，半导体设备精密零部件通常有着精度高、批量小、多品种、尺寸特殊、工艺复杂、要求较高等特点，需要兼顾强度、应变、耐腐蚀性、电子特性、电磁特性、材料纯度等复合功能要求，对厂商有着较高的

技术挑战。由于半导体设备精密零部件种类繁多复杂，制作工艺差异巨大，因此即使是全球行业领先的头部企业，也只能专注于个别类型生产工艺，行业相对分散。

发行人自设立时起即从事半导体设备精密零部件的研发、生产和销售，主要产品原材料以铝、不锈钢等金属为主，为金属类精密零部件，本次募集资金投资项目开始涉及陶瓷件，但石英件、硅/碳化硅件等其他材质的半导体设备精密零部件不属于发行人目前的目标市场，如未来半导体设备金属及陶瓷精密零部件市场空间被其他材质精密零部件替换，则发行人市场空间将下降。

2、半导体功能器件拓展风险

报告期内，发行人收入主要来自于半导体精密零部件，以不带功能的关键工艺部件和工艺部件为主，功能器件收入占比较少。以晶圆加热器为代表的功能器件是发行人对现有精密零部件业务板块产品的丰富、延伸和升级，系围绕现有主营业务展开。发行人基于产品专精的特点，能够将零部件生产制造技术和经验进一步推广至功能器件。

虽然发行人具备研发和量产功能器件对应的人员、技术能力和生产能力，并已经过较长时间的研发积累，但由于发行人在相关产品的人员储备相对不足、先进陶瓷生产工艺尚未完全成熟、新产品开发成本较高，如未来发行人功能器件相关产品市场拓展不及预期，将对发行人盈利能力产生不利影响。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计分别为 42,087.00 万元、95,332.56 万元和 99,991.00 万元，占同期营业收入的比例分别为 75.46%、83.94%和 80.79%，客户集中度较高且较为稳定，主要原因为半导体行业技术和资本高度密集，导致下游设备企业、晶圆代工企业呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况恶化、或由于半导体行业景气度下降导致客户资本性支出下降，进而导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、业绩及毛利率下降的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 55,771.69 万元、113,577.41 万元和 123,772.76 万元，2023-2025 年复合增长率为 48.97%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,978.54 万元、21,373.27 万元和 18,608.72 万元，公司主营业务毛利率分别为 29.13%、33.36%和 28.59%。

2025 年度，发行人营业收入同比增长 8.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降 12.93%，主要原因系主营业务毛利率同比下降 4.77%，主营业务毛利率下降的主要原因系：1、公司根据市场需求及发展规划进行了适度的产能预增，2025 年度，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，但下游行业在经历 2023 年下半年、2024 年扩产后进入新增产能消纳阶段，下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得充分吸收；2、为应对下游客户需求，当年员工规模同比提高，导致薪酬支出增加；3、随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品质量要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控,成本相应上升。

如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业转化等原因导致产能利用率下降，公司主营业务毛利率将下降，公司将面临一定的经营压力，未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

2、存货余额及存货跌价准备上升的风险

公司存货主要由原材料、在制品、库存商品、委托加工物资和发出商品组成，报告期各期末，存货账面价值分别为 17,664.22 万元、26,637.63 万元和 30,554.39 万元，占总资产的比例分别为 16.50%、13.47%和 14.02%，报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 2,089.15 万元、2,400.44 万元和 2,966.03 万元。

报告期内，公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的存货跌价准备。若公司未来无法及时地预计市场需求的变动，或生产管理不当导致产品滞销、原材料积压等情形，则可能对公司营运资金周转造成不利影响，若半导体市

场增速进一步放缓，原材料价格大幅下跌或市场竞争格局出现重大不利变化，则可能导致存货跌价准备迅速上升的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）行业周期性风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业是半导体行业上游，半导体行业的整体发展情况会对公司所处行业产生较大影响。受扩产周期、创新周期等因素的叠加作用，半导体行业具有典型的周期性特点，通常每 4-5 年完成一轮周期波动，呈螺旋式上升的特点，其中 2-3 年处于上行通道，3-6 个季度处于下行通道。在经历了 2021-2022H1 的较快增长后，2022H2 由于下游消费电子需求疲软，产能紧张时期的供应链库存累积，全球半导体市场进入下行周期，该下行周期在 2023 年下半年起逐渐复苏，并在 2024 年重新进入上升周期。

在行业处于周期性上行通道时，公司需要保持及提高产能来满足产业链下游客户快速提升的需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，可能会导致公司失去既有或潜在客户；在行业处于周期性下行通道时，计算机、消费电子等终端消费市场需求下降，晶圆厂继而削减资本性支出，对公司产品的需求亦可能下降。

虽然长期看，半导体行业作为电子信息产业的基石，人类社会智能化、数字化的大趋势将继续演进，半导体行业的长期需求将持续向好，但在行业处于周期性下行通道时，因晶圆制造企业、半导体设备企业削减资本性支出，公司新增订单可能出现下滑，进而影响公司的经营业绩。

（二）市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

随着全球半导体行业的快速发展，对于半导体设备零部件的需求不断增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，抢夺市场份额，同时行业内领先的企业通过并购重组进一步整合资源，使得市场竞争更加激烈。目前，半导体设备精密零部件市场主要由美国、日本和中国台湾地区的企业占据主导地位，公司与国际领先企业之间在市场竞争力、市场占有率上仍然存在一定的差距。同时，随着半导体领域国产优秀企业的不断涌现，未来可能将有更多国产零部件厂商加入市场竞争。如果公司未来无法通过提升研发实力、产品性能和客户拓展

能力有效应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力及产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（三）主要原材料价格波动风险

公司半导体设备零部件产品的原材料主要包括铝、不锈钢、镍等金属。报告期内，直接材料占公司主营业务成本的比例分别为 47.11%、48.78%和 44.89%，占比较高。原材料价格的波动直接影响公司产品的成本及毛利率水平。公司生产所需的上述大宗金属原材料虽然具有稳定的来源，但价格容易受到宏观环境、经济周期、市场需求、汇率等因素的影响出现较大波动。未来若原材料市场价格持续出现大幅上涨，或公司难以将原材料价格上涨传导至客户端，可能导致公司营业成本上升，对公司业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

1、募集资金用于拓展新产品的风险

本次募投项目中，“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”产品主要为陶瓷加热器，系公司基于现有半导体精密零部件业务所拓展的新材质产品。目前，该项目的产线投建、产品研制、客户验证及销售等均处于相对早期阶段，若公司最终无法顺利建设新材质功能器件产线并实现量产，或新产品无法及时通过下游客户验证、受技术迭代影响市场需求及单价下降等，该募投项目可能存在实施失败、新增产能无法消化等风险，进而对公司业绩产生不利影响。

2、募投项目研发失败的风险

本次募集资金投资项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”的研发方向为静电吸盘。静电吸盘为半导体设备核心高端零部件，行业在精密加工、分区温控、表面处理及洁净制造等环节存在较高技术壁垒，项目研发难度大、周期较长、资金投入较高。若公司在研发过程中未能攻克关键核心技术、研发进度不及预期，或研发成果无法满足下游客户严苛认证要求、技术路线与行业发展趋势不匹配，将导致项目研发失败。项目研发失败可能使公司无法实现预期研发及产业化目标，前期投入难以收回，进而对公司技术布局、产品拓展及经营业绩产生不

利影响。

3、募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金投向半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目，半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目和半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目，对于上述募集资金投资项目公司已经过充分的市场调研和严谨科学的可行性论证，但本次募投项目的实施仍可能受到产业政策环境、行业发展状况、研发进度等不确定性因素的影响，存在未来无法实施或者研发成果竞争力不足的风险。

4、募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目，半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目和半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目，募投项目涉及现有产品产能扩建、新产品拓展、技术研发等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着集成电路产业和半导体设备行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，募投项目存在不能达到预期收益或新增产能难以消化的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

5、新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本次发行的募集资金投资项目实施后公司将新增较大规模的固定资产投资，预计稳定达产后公司固定资产等资本性支出规模将有所增长，本次募投项目的实施会导致公司未来整体折旧和摊销金额增加，在稳定达产前将导致公司生产成本和费用增加。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，预计项目实现的利润规模以及公司未来盈利能力的增长能够消化本次募投项目新增折旧和摊销，但如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致募集资金投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

6、募投项目产能消化风险

公司本次募集资金投资项目的实施将会新增金属加热器、陶瓷加热器的产

能，相关产品主要应用于薄膜沉积设备等半导体核心设备。

当前半导体陶瓷加热器的主要市场份额主要由 NGK、MiCo 等境外龙头厂商占据，中国境内优秀企业如珂玛科技等已经实现对下游客户的批量销售，但相关产品在国内尚处于起步阶段。在国产半导体设备供应链安全需求下，本土厂商的导入和验证将提速，由此半导体陶瓷加热器将迎来广阔发展空间。此外，本土同行业公司也在导入金属加热器产能。

公司本次募投募集资金投资项目虽经过市场分析和论证，但考虑到境外优势半导体陶瓷领先企业和本土同行业公司相关产品产业化投入的形势下，募投产品在未来市场竞争中可能面临产销率不及预期的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

7、前次募集资金项目无法按期实施的风险

公司前次募集资金项目正有序、按期推进，募集资金基本使用完毕但尚未建设完成，如后续建设过程中出现工程进度延缓、设计方案调整或设备调试延期等情况，则前次募集资金项目存在无法按期实施的风险。此外，若项目投入使用后半导体零部件出现周期性需求变化、竞争加剧等情形，也将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险

1、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定范围内增加，而募投项目从开始建设至产生效益需要一定的时间，因此短期内可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标在一定范围内下降。此外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

2、可转债发行导致资产负债率提高的风险

本次可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，资产负债率将进一步提升。若未来可转换公司债券持有人未能顺利转股，则公司

资产负债率将较高。

3、转股风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）可转债提前赎回的风险

本次可转债设有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，发行人公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。如果发行人行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（2）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

（3）可转债未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

4、可转债价格波动风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，为复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性。在二级市场可转债价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能会出现异常波动或严重偏离其自身价值的现象，可能导致投资者的投资收益不及预期。

5、评级风险

公司聘请中证鹏元为本次发行可转债进行了信用评级，主体信用级别为AAst1，本次可转债信用级别为AA。在本期债券存续期限内，评级机构将持续关注公司经营环境、财务状况等重大变化，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

6、利率风险

在可转债的存续期内，如果市场利率上升，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分考虑市场利率波动可能导致的风险，以避免和减少损失。

7、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。但受国家政策、法律法规、行业及市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能回报不及预期，导致公司无法从预期的还款来源获得充足资金，从而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的能力。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 202,379,856 股，其中前十大股东持股情况如下：

单位：股、%

股东名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
游利	境内自然人	32,424,341	16.02	32,424,341
优立佳合伙	其他	25,693,147	12.70	-
英瑞启	境内非国有法人	18,744,694	9.26	18,744,694
优正合伙	其他	15,692,823	7.75	15,692,823
李欢	境内自然人	11,589,973	5.73	11,589,973
XU ZIMING	境外自然人	8,121,706	4.01	8,121,706
聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	5,704,077	2.82	-
优合合伙	其他	4,924,839	2.43	4,924,839
华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	基金、理财产品等	3,851,770	1.90	-
中微半导体设备（上海）股份有限公司	境内非国有法人	2,927,036	1.45	-
合计		129,674,406	64.07	91,498,376

二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

先锋精科在国内半导体设备核心精密零部件领域具有领先的市场地位。公司自成立以来，始终保持高强度研发投入，铸就精密机械制造、表面处理、焊接、高端器件设计开发、高性能陶瓷制备及精加工技术及定制化工装开发等六大核心技术体系，打造行业领先的半导体精密零部件技术平台。经过十余年的持续研发和工艺深耕，公司在关键工艺部件等核心技术关键领域获得多项技术突破。

公司凭借优秀的半导体精密零部件研发与量产能力，通过持续高强度的科技创新，不断满足半导体设备厂商与晶圆厂的高端需求，为客户提供高可靠、高一致性的核心部件与解决方案，累计服务中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清

科等半导体设备龙头客户，深度切入刻蚀、薄膜沉积等核心制程应用场景。目前公司在国内市场已具备相对明显的先发优势，在产品技术储备、工艺稳定性和批量交付能力上已拥有与国外知名品牌竞争的实力。

（二）保持科技创新能力的机制和措施

1、建立了三大技术革新反馈机制

技术创新的动力来自客户及市场需求，公司经过多年与下游头部客户的深度合作，与客户建立了技术革新反馈机制。首先，公司会派出工程师在主要客户处长期驻场，第一时间了解客户对公司产品瑕疵、性能更新需求等，通过该机制，公司能够及时掌握下游客户的发展动态；其次，在与客户的不断沟通交流中实现双方产品的协同及共同迭代进步，因此，公司还与客户建立了合作开发新工艺的机制，即公司会不定期地与客户协同开发重点产品及新工艺研发、验证和应用，通过该机制，一方面公司能够明确技术更新迭代方向，加快技术研发，另一方面也能帮助国产设备厂商加快完成产品的研发和设计。

除与客户建立技术革新反馈机制外，公司也建立了与供应商的技术革新反馈机制。由于半导体设备零部件工序繁多且专业度高，即使是行业龙头也无法覆盖全部生产工序，但公司是向客户交付最终合格产品的第一责任人，因此，公司需要整合多方产业资源，为客户提供优秀的产品解决方案。基于此，公司通过深耕行业，积累了一批长期合作的外协供应商，不断根据客户需求研究技术更新，带领供应商共同发展，在相互配合中共同突破工艺瓶颈、迭代升级。

除上述两大反馈机制外，公司还建立了全平台技术革新反馈机制，即通过全员合理化建议的实施，公司在研发、工程和生产部门间建立了有效、通畅的沟通渠道，定期对员工提出的优化改善措施进行评估和奖励，极大地激发员工创新行动热情。通过该机制，公司将研发和生产两者有机结合，相辅相成，加速完善技术研发的同时，保证了技术研发有效地转化为生产力，进一步丰富了高科技制造型企业的创新路径。

综上，公司通过上述与客户、与供应商、与员工建立的三大技术革新反馈机制，形成了一个以高端零部件为载体的，多工艺联合研发创新和生产的生态系统，在该生态系统下，公司能够以较快的响应速度及具有竞争力的价格为客户提供高

质量的产品，上述机制系公司研发和技术创新的主要机制。

2、前瞻性研究、产品导向、工艺迭代有机结合的研发框架

公司高度重视研发创新活动，设立了专门的研发中心主导工艺和产品开发。公司由首席技术官主持统筹研发中心的研发创新活动，下辖研发管理部、研发一部、研发二部、研发三部和研发四部，具体部门职责如下：

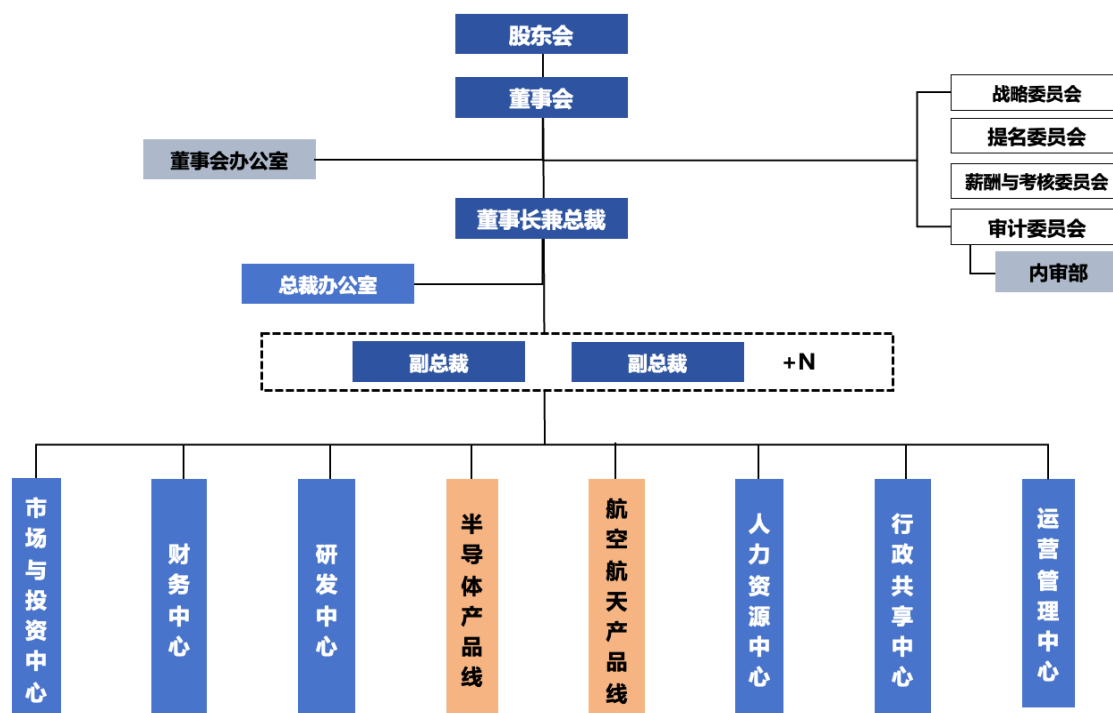
一级部门	二级部门	职责简述
研发中心	研发管理部	1、各级横向及纵向课题、项目的对接和管理。2、研发体系的管理。3、和其他部门日常事务的对接和管理。
	研发一部	1、负责产品的设计及模拟。2、负责金属加热类产品的研发、新品工艺制定及工艺技术支持等工作。3、负责本部门开发产品、工艺标准的制定。
	研发二部	1、负责新材料类产品的研发。2、负责陶瓷类材料及产品的研发。3、负责干法表面处理研发和工艺技术支持。4、负责本部门开发产品、工艺标准的制定。
	研发三部	1、负责公司各品类产品精密加工工艺的开发。2、负责 SHD 产品开发。3、负责本部门工艺标准的制定。
	研发四部	1、负责湿法表处工艺的开发和工艺技术支持。2、负责公司实验室建设和管理。3、负责公司理化性能检测。4、负责本部门工艺标准的制定。

报告期内，公司研发投入金额分别为 3,630.90 万元、6,408.32 万元和 7,137.71 万元，保持持续增长，占各期营业收入的比例分别为 6.51%、5.64% 和 5.77%。截至 2025 年末，公司研发人员 156 人，占员工总数的 10.25%。公司未来将持续加大研发投入，为持续创新和技术储备提供保障。

三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

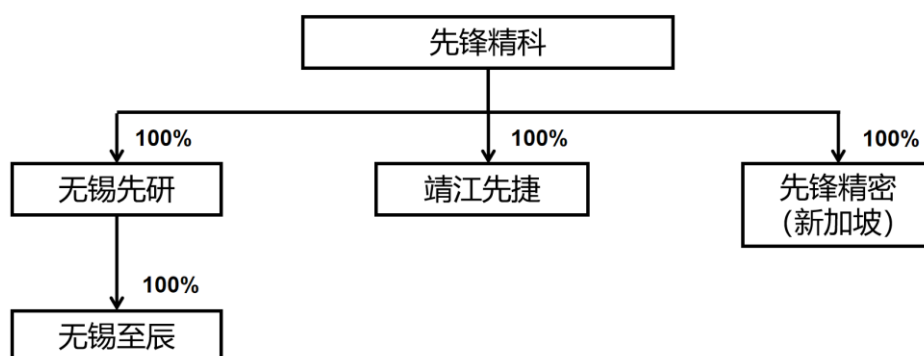
（一）公司的内部组织结构图

截至本募集说明书签署日，发行人的组织结构图如下：



(二) 公司直接或间接控股公司情况

截至本募集说明书签署日，发行人直接或间接控股的公司情况如下：



1、无锡先研

名称	无锡先研新材料科技有限公司
成立日期	2021年2月26日
注册地址	无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号厂房
注册资本	11,000万元人民币
法定代表人	游利
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要业务	与发行人主营业务相关，主要从事半导体设备零部件、模组及医疗设备零部件的研发、生产和销售	
股权结构	股东名称	股权比例
	先锋精科	100.00%
最近一年主要财务数据（万元）	项目	2025 年末/2025 年度
	总资产	39,631.44
	净资产	8,335.71
	营业收入	7,997.20
	净利润	-450.37

2、靖江先捷

名称	靖江先捷航空零部件有限公司	
成立日期	2019 年 5 月 14 日	
注册地址	江苏省靖江市靖江经济技术开发区新兴路 6 号	
注册资本	10,000 万元人民币	
法定代表人	游利	
经营范围	航空器零件制造、加工、销售、维修；机械零部件加工、销售；金属表面喷涂加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要业务	与发行人主营业务相关，主要从事半导体设备零部件、航空零部件的研发、生产和销售	
股权结构	股东名称	股权比例
	先锋精科	100.00%
最近一年主要财务数据（万元）	项目	2025 年末/2025 年度
	总资产	21,911.05
	净资产	6,590.41
	营业收入	2,723.40
	净利润	-2,132.63

3、无锡至辰

名称	无锡至辰科技有限公司	
成立日期	2022 年 3 月 9 日	
注册地址	无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 5 号库二楼	
注册资本	600 万元人民币	
法定代表人	游利	
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	

	技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用零部件制造；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要业务	与发行人主营业务相关，主要从事泛半导体领域的陶瓷涂层业务	
股权结构	股东名称	股权比例
	无锡先研	100.00%
最近一年主要财务数据（万元）	项目	2025 年末/2025 年度
	总资产	2,067.83
	净资产	223.35
	营业收入	1,722.29
	净利润	-71.76

4、先锋精密（新加坡）

名称	Sprint Precision Technologies（Singapore）PTE. LTD.	
成立日期	2021 年 9 月 8 日	
注册地址	987 Serangoon Road, Singapore	
注册资本	3 万新加坡元	
法定代表人	游利	
主要业务	与发行人主营业务相关，协助公司与境外供应商、客户业务沟通	
股权结构	股东名称	股权比例
	先锋精科	100.00%
最近一年主要财务数据（万元）	项目	2025 年末/2025 年度
	总资产	1,080.30
	净资产	1,078.08
	营业收入	-
	净利润	22.25

四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况

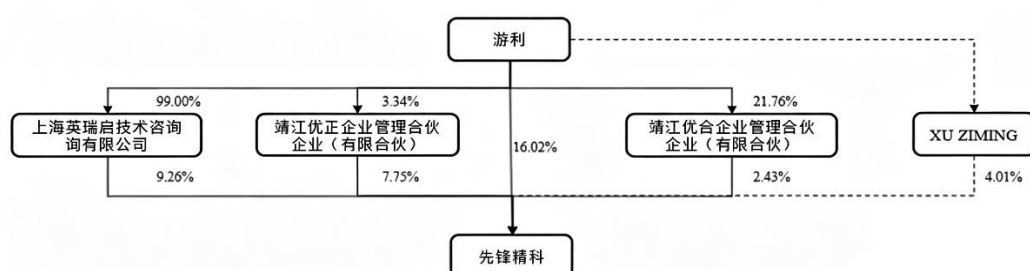
（一）控股股东和实际控制人

1、控股股东、实际控制人基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，游利直接持有公司 32,424,341 股股份，占本次

发行前公司总股本的 16.02%。此外，游利通过英瑞启控制公司 9.26% 股份的表决权，通过优正合伙控制公司 7.75% 股份的表决权，通过优合合伙控制公司 2.43% 股份的表决权，通过与 XU ZIMING 签署的《一致行动协议》控制公司 4.01% 股份的表决权。综上，游利合计控制公司 39.47% 股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的控制结构图如下：



注：游利与 XU ZIMING 已签订《一致行动协议》

游利先生，董事长，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1988 年 9 月至 1994 年 5 月，担任中国空气动力研究与发展中心工程师；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，自由职业；1997 年 4 月至 1997 年 10 月，担任 UMS Group 工程师；1997 年 11 月至 2001 年 11 月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001 年 12 月至 2004 年 7 月，担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004 年 8 月至 2008 年 3 月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008 年 3 月至今，担任公司总经理；2017 年 5 月至 2021 年 11 月，担任公司执行董事；2021 年 12 月至今，担任公司董事长。2019 年 5 月至 2023 年 8 月，担任靖江先捷总经理，2019 年 5 月至今担任靖江先捷执行董事。2021 年 2 月至今，担任无锡先研执行董事；2021 年 9 月至今，担任先锋精密（新加坡）董事；2025 年 3 月至今，担任无锡至辰董事、经理。

2、上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司自上市以来，控股股东、实际控制人均未发生变化。

（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业

除发行人及其子公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

序号	企业名称	控制方式	主营业务
1	英瑞启	游利及其配偶褚激持有 100%的股权	无实际生产经营
2	优正合伙	游利担任执行事务合伙人	发行人员工持股平台
3	优合合伙	游利担任执行事务合伙人	发行人员工持股平台

（三）控股股东所持股份的权利限制情况

截至 2025 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在质押或冻结的情况。

五、承诺事项及履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

截至本募集说明书签署日，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、其他核心人员不存在未履行向投资者所做出的公开承诺的情形。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、相关主体对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺

（1）发行人承诺

发行人对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，作出以下承诺：

“1、加强募集资金的管理和运用，加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到账后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将对募集资金进行专户存储和使用、保障募集资金按照原定用途得到充分有效利用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东会、董事会、审计委员会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

3、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升整体运营效率。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。

本次发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。”

(2) 控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人游利对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上交所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

(3) 董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺支持公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺若公司实施股权激励的，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕

前，若中国证券监督管理委员会、上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上交所的最新规定出具补充承诺。”

2、关于是否参与本次可转债认购的承诺

关于是否参与本次可转债认购的承诺详见“重大事项提示”之“四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况”。

六、董事、高级管理人员、其他核心人员

（一）董事、高级管理人员、其他核心人员基本情况

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、高级管理人员及其他核心人员如下：

序号	姓名	职务	任期起止时间
1	游利	董事长、总经理、核心技术人员	2025.10.16-2028.10.15
2	XU ZIMING	董事、副总经理、核心技术人员	2025.10.16-2028.10.15
3	XIE MEI	董事、董事会秘书	2025.10.16-2028.10.15
4	李镛	董事	2025.10.16-2028.10.15
5	陈彦娥	董事	2025.10.16-2028.10.15
6	管明月	职工代表董事、首席运营官、核心技术人员	2025.10.16-2028.10.15
7	沈培刚	独立董事	2025.10.16-2028.10.15
8	杨翰	独立董事	2025.10.16-2028.10.15
9	于赞	独立董事	2025.10.16-2028.10.15
10	杨丽华	首席财务官	2025.10.16-2028.10.15
11	刘国辉	首席技术官、核心技术人员	2025.10.16-2028.10.15
12	周红旗	核心技术人员	2008.10 起
13	贾坤良	核心技术人员	2011.11 起

（二）现任董事、高级管理人员和其他核心人员的简历

1、董事会成员

游利先生，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”。

XU ZIMING 先生，董事，1963 年 9 月出生，新加坡国籍，已取得中国永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1993 年 10 月，担任上海交通大学讲师；1993 年 11 月至 1995 年 1 月，担任新加坡南洋理工大学研究学者；1995 年 2 月至 2001 年 10 月先后担任新加坡宇航制造公司高级工程师与工程经理；2001 年 11 月至 2004 年 3 月，担任美西航空制造（苏州）有限公司总经理；2004 年 4 月至 2013 年 3 月，担任普美航空制造（苏州）有限公司总经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，自由职业；2014 年 1 月至 2018 年 12 月，担任 OMADA International 亚洲区总裁；2019 年 1 月至今，担任公司副总经理；2021 年 12 月至今，担任公司董事；2021 年 2 月至今任无锡先研监事；2021 年 9 月至今，担任先锋精密（新加坡）董事；2025 年 3 月至今，担任无锡至辰监事。

XIE MEI 女士，董事，1976 年 2 月出生，英国国籍，硕士研究生学历。2002 年 10 月至 2006 年 9 月，担任 Farmiloes Chartered Accountants, Birmingham, UK, 会计师；2006 年 10 月，自由职业；2006 年 11 月至 2011 年 10 月，担任毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011 年 11 月至 2017 年 4 月，自由职业；2017 年 5 月至 2019 年 11 月，担任上海珺容资产管理有限公司机构合作部总监；2019 年 12 月至 2020 年 7 月，自由职业；2020 年 8 月至 2021 年 12 月，担任公司执行董事秘书；2021 年 12 月至今，担任公司董事、董事会秘书。

李镝先生，董事，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。主要经历如下：1992 年 7 月至 2001 年 4 月，担任江苏省扬州市机械进出口公司经理；2001 年 4 月至 2008 年 1 月，担任扬州海外惠通聚酯技术有限公司副总经理；2008 年 1 月至今，担任扬州同辉化工技术有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 月至 2026 年 2 月，担任上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司董事长，2026 年 2 月至今，担任上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司董事；2021 年 12 月至 2022 年 11 月，担任公司董事；2022 年 11 月至 2025 年 10 月，担任公司监事；2025 年 10 月至今，担任公司董事。

陈彦娥女士，董事，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，担任汾西机器厂助理工程师；2002 年 1 月至 2006 年 5 月，担任美西航空制造（苏州）有限公司制造工程师；2006 年 5 月至

2007年1月，担任百得（苏州）科技有限公司夹量工程师；2007年1月至2021年5月，担任普美航空制造（苏州）有限公司生产计划经理；2021年5月至今，担任公司子公司无锡先研总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事；2025年10月至今，担任公司董事。

管明月先生，职工代表董事、首席运营官，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2009年9月，担任江苏正昌集团有限公司机械工程师；2009年9月至今，历任公司制造部经理、制造部总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事会主席、职工代表监事；2025年10月至今，担任公司职工代表董事、首席运营官。

于赟先生，独立董事，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。主要经历如下：1988年4月至1990年12月，担任常州飞机制造有限公司工程师；1990年12月至1994年8月，担任常州铸造总厂工程师；1994年8月至1998年9月，担任伯林盖姆（常州）机械有限公司工程师；1998年9月至2023年10月，担任江苏理工学院教授至退休；2022年11月至今，担任公司独立董事。

杨翰先生，独立董事，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。主要经历如下：1992年7月至1993年10月，担任重庆市万州区供销合作社法律顾问室科员；1993年10月至今，担任江苏骥江律师事务所律师、合伙人；2010年9月至2015年8月及2021年7月至今，担任江苏东华测试技术股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年5月，担任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立董事。

沈培刚先生，独立董事，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。主要经历如下：2004年7月至2006年12月，担任苏州方本会计师事务所有限公司审计助理；2006年12月至2010年8月，担任苏州众勤会计师事务所有限公司项目经理；2010年9月至2011年11月，担任苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理；2011年12月至2015年10月，担任企瑞会计师事务所江苏有限公司部门经理；2015年11月至2017年10月，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任会计师；2017年11月至今，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主任会计师、总所合伙人；2022年11月至今，

担任公司独立董事；2025年11月至今，担任华达汽车科技股份有限公司独立董事。

2、高级管理人员

游利先生，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”。

XU ZIMING 先生，详见以上董事会成员简历。

杨丽华女士，首席财务官，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师协会非执业会员，中国管理会计师。2005年4月至2006年4月，担任中亿光电科技（苏州）有限公司财务主管；2006年4月至2015年7月，担任苏州住矿电子有限公司（现更名为苏州兴胜科半导体材料有限公司）财务经理；2015年10月至2016年4月，担任苏州市意可机电有限公司（现更名为江苏意可航空科技股份有限公司）财务经理；2016年4月至2019年8月，担任苏州奔腾塑业有限公司董事长助理；2019年8月至2019年10月，自由职业；2019年11月至2022年4月，担任苏州艾吉威机器人有限公司财务总监；2022年4月至今，担任公司首席财务官；2022年9月至今，担任靖江先捷监事。

XIE MEI 女士，详见以上董事会成员简历。

管明月先生，详见以上董事会成员简历。

刘国辉先生，首席技术官、核心技术人员，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2000年7月至2022年1月在安泰科技股份有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位。2022年2月，自由职业。2022年3月至2025年2月，担任无锡至辰执行董事、总经理；2025年3月至今，历任公司副总裁兼研发中心总经理、首席技术官。

3、其他核心人员

周红旗先生，工艺器件事业部总监及研发中心研发三部总监，1986年7月出生，中国国籍，本科学历。2008年10月至今，历任公司机械工程师、工艺工程师、工程部经理、机加车间经理、产品工程部高级经理、工研部项目规划与管

理总监、工艺器件事业部总监及研发中心研发三部总监。

贾坤良先生，研发中心研发一部总监，1981年11月出生，中国国籍，本科学历，2011年11月至今，担任公司机械工程师、研发工程师、研发部经理、工研部研发总监、研发中心研发一部总监。

（三）董事、高级管理人员、其他核心人员兼职情况

公司现任董事、高级管理人员、其他核心人员在除公司及控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位名称	兼职职务
游利	英瑞启	董事
	优正合伙	执行事务合伙人
	优合合伙	执行事务合伙人
李镝	优立佳合伙	执行事务合伙人
	扬州同辉化工技术有限公司	执行董事、总经理
	上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司	董事
	扬州市宝茂塑料电器有限公司	董事
沈培刚	中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	主任会计师、总所合伙人
	吴中区木渎浩安商务信息咨询服务部	个体工商户
	苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司	董事
	广上科技（广州）股份有限公司	独立董事
	华达汽车科技股份有限公司	独立董事
	苏州杰特泰克电子科技有限公司	监事
杨翰	江苏骥江律师事务所	律师、合伙人
	江苏东华测试技术股份有限公司	独立董事
杨丽华	苏州友泽财税服务有限公司	监事

（四）董事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况

2025年度，发行人董事、高级管理人员、其他核心人员在公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2025年度薪酬	是否在公司关联方获取报酬
游利	董事长、总经理	171.68	否
XU ZIMING	董事、副总经理	144.86	否

姓名	职务	2025 年度薪酬	是否在公司关联方获取报酬
XIE MEI	董事、董事会秘书	58.76	否
李镝	董事	-	是
陈彦娥	董事	58.39	否
管明月	董事、首席运营官	82.80	否
沈培刚	独立董事	12.00	否
杨翰	独立董事	12.00	否
于赟	独立董事	12.00	否
杨丽华	首席财务官	77.41	否
刘国辉	首席技术官	130.03	否
周红旗	核心技术人员	51.58	否
贾坤良	核心技术人员	52.75	否

(五) 董事、高级管理人员、其他核心人员持有公司股份情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人现任董事、高级管理人员、其他核心人员直接持有发行人股份情况如下表：

单位：万股、%

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	游利	董事长、总经理	3,242.43	16.02
2	XU ZIMING	董事、副总经理	812.17	4.01
3	李镝	董事	0.10	0.00
合计			4,054.70	20.03

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人董事、高级管理人员、其他核心人员间接持股情况如下表所示：

单位：%

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例
游利	董事长、总经理	英瑞启	9.26	99.00
		优正合伙	7.75	3.34
		优合合伙	2.43	21.76
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	36.27
XU ZIMING	董事、副总经理	优正合伙	7.75	14.77
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集	1.90	8.52

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例
		合资产管理计划		
XIE MEI	董事、董事会秘书	优正合伙	7.75	22.16
李镝	董事	优立佳合伙	12.70	8.92
陈彦娥	董事	优正合伙	7.75	3.69
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	5.11
管明月	职工代表董事、首席运营官	优正合伙	7.75	3.69
		优合合伙	2.43	23.26
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	5.45
杨丽华	首席财务官	优正合伙	7.75	5.91
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	8.18
周红旗	核心技术人员	优正合伙	7.75	0.30
		优合合伙	2.43	18.60
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	3.41
贾坤良	核心技术人员	优正合伙	7.75	2.22
		华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.90	3.41

(六) 董事、高级管理人员、其他核心人员最近三年变动情况

1、董事变动情况

最近三年，公司董事变动情况如下：

时间	董事	变动原因
2023年1月-2025年10月	游利、XU ZIMING、XIE MEI、吴晓旭、于赞、杨翰、沈培刚	-
2025年10月至今	游利、XU ZIMING、XIE MEI、李镝、陈彦娥、管明月、于赞、杨翰、沈培刚	董事会换届选举

2、高级管理人员变动情况

最近三年，公司高级管理人员变动情况如下：

时间	高级管理人员	变动原因
2023年1月-2025年10月	游利、XU ZIMING、XIE MEI、杨丽华	-
2025年10月至今	游利、XU ZIMING、XIE MEI、杨丽华、管明月、刘国辉	经公司第二届董事会第一次会议聘任

3、核心技术人员变动情况

2025年12月24日，经第二届董事会第三次会议审议通过，公司新增认定刘国辉先生为核心技术人员。刘国辉先生简历详见本募集说明书本节之“六、董事、高级管理人员、其他核心人员”之“（二）现任董事、高级管理人员和其他核心人员的简历”之“2、高级管理人员”。

（七）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

公司于2020年设立优合合伙和优正合伙用于实施员工股权激励，报告期内，上述平台新增的股权激励情况如下：

2024年6月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司在优正合伙对贾坤良、周红旗两名员工新增实施股权激励。

2024年9月，经第一届董事会第十二次会议审议通过，公司在优正合伙对贾坤良、倪赟两名员工新增实施股权激励。

七、发行人所处行业的基本情况

公司主要从事半导体设备精密零部件的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于门类“C制造业”中的大类“C34通用设备制造业”中“C3484机械零部件加工”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.5智能关键基础零部件制造”，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》中的“高端装备领域”。

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及管理体制

公司所属行业的行政主管部门主要为国家发改委、工信部和科技部。公司所属行业的全国性自律组织主要包括中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业

协会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会、集成电路材料产业技术创新联盟和集成电路零部件产业技术创新联盟。

2、最近三年监管政策变化

公司主要产品为用于半导体设备的精密零部件，属于集成电路、半导体设备相关产业，为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，我国近年来推出了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策，为半导体产业的发展营造了良好的政策环境。主要行业法律法规及产业政策如下：

文件名称	颁布时间	发文机关	主要内容
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	2025年	国务院	明确“十五五”期间（2026-2030）集成电路产业发展目标：关键半导体设备国产化率突破70%
《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》	2023年	工业和信息化部、财政部	全面提升供给能力。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力
《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	2022年	发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局	规定了不同纳米级别、经营期限和投资规模的集成电路生产企业以及集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业所得税的优惠政策，从税收政策上支持集成电路生产企业的发展

（二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

近三年，半导体精密零部件行业在材料创新、工艺突破、核心技术国产化等方面取得显著进展，为半导体设备产业链安全奠定了坚实基础。

1、行业近三年在科技创新方面的发展情况

（1）从单点突破到系统能力构建

近三年，半导体精密零部件行业的技术创新正在努力实现从单一零部件单点突破向多品种系统配套能力构建的跨越式升级。行业早期技术攻关多聚焦于真空腔体、匀气盘、金属加热器等单一核心零部件的国产化，实现关键部件从“无”到“有”的突破。

随着下游半导体设备整机集成化需求提升，行业创新逐步向功能器件化、系统配套化方向发展，企业依托单一零部件的技术积累，向下游与设备整机协同设

计、工艺匹配、验证测试延伸，形成覆盖材料、加工、涂层、装配、检测的全流程技术体系。同时，行业内企业与半导体设备厂商建立深度协同研发机制，从被动适配设备需求转向提前参与设备前端设计，实现零部件与设备整机的性能耦合，系统解决真空密封性、温度均匀性、气体分布稳定性等整机级技术难题，行业整体由单一零件供应商向设备核心功能器件解决方案提供商转型，系统配套与集成创新能力显著增强。

(2) 从适配成熟制程向先进制程迈进

半导体设备的绝大部分关键核心技术需要以关键零部件作为载体来实现，关键零部件是中国半导体设备向先进制程迈进的重要基石。近三年，国内龙头半导体设备技术迭代紧跟芯片制程升级节奏，努力实现从主要适配 28nm 及以上成熟制程向同步支撑 14nm、7nm 及以下先进制程的跨越。在成熟制程领域，行业通过工艺优化与规模化生产，实现精密零部件的稳定供应，在加工精度、批次一致性、可靠性等核心指标上满足成熟制程量产需求，国产化配套能力持续提升。面对更高制程对零部件提出的极致严苛要求，行业围绕超高材料纯度、亚微米级加工精度、超低颗粒污染、耐强等离子体侵蚀、高精度温控等关键技术方向开展攻关，在特种陶瓷材料、异质材料连接、超精密微孔加工、高性能涂层等底层技术上突破，相关产品逐步通过下游设备及晶圆厂验证。同时，行业针对更高制程的热管理、界面可靠性、长寿命服役等痛点持续优化技术方案，逐步缩小与国际先进水平的差距，有力支撑国产半导体产业链向先进制程演进。

2、行业未来发展趋势

(1) 产品专精与关联配套零部件拓展并重

受行业细分领域多、碎片化特征显著的特点影响，未来行业内企业将持续坚持专精化发展核心方向，聚焦自身优势细分零部件领域持续深耕，在材料选型、精密加工、特种表面处理、洁净装配、可靠性验证等核心环节不断打磨工艺技术，持续提升产品精度、批次一致性、服役寿命及环境适配性，不断强化细分领域技术壁垒与核心竞争力。

同时，依托主营业务核心零部件的长期技术积累、工艺能力及客户资源，企业将有序向与原有产品直接配套、同属半导体设备体系内的其他精密零部件品类

进行延伸拓展，围绕下游设备厂商的整体配套需求丰富产品矩阵，通过实现多品类协同供应提升对客户的综合服务能力，进一步增强客户粘性与市场话语权。

(2) 产业链协同创新持续深化

未来行业将进一步强化全产业链协同创新，打通下游设备整机及终端晶圆制造的技术联动与资源共享。行业内企业将与下游半导体设备厂商建立联合设计、同步研发、共同验证的长效机制，提前适配设备迭代与制程升级需求，缩短产品验证与量产周期；通过产业链上下游协同攻关、成果共享，持续破解先进制程零部件的核心技术难题，推动行业整体技术水平提升，构建安全、稳定、产业链安全的半导体精密零部件产业生态。

(三) 行业整体竞争格局及市场集中情况，发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手、行业技术壁垒或主要进入障碍

1、行业竞争格局

半导体设备零部件行业整体市场集中度较低，竞争格局较为分散，行业内具备领先优势的企业主要来自美国、欧洲、日本等半导体产业发达地区及国家。半导体设备精密零部件种类繁多、应用场景各异，不同产品的核心制备工艺、技术路径存在显著差异，即便全球行业头部企业亦仅能专注于特定生产工艺或细分零部件领域深耕，行业碎片化特征突出，上述市场格局为国内企业实现突破创新创造了有利条件。

近年来，在外部产业环境变化背景下，保障产业链安全成为行业亟待解决的核心需求，国内零部件企业积极加大研发投入，持续提升技术研发水平与产能规模。尽管目前国内企业在综合技术实力、产品性能等方面与国际龙头企业仍存在一定差距，但已在多个细分领域实现关键技术突破与产业化落地，包括本公司、富创精密、珂玛科技等在内的国内优质厂商已完成相关零部件产品的规模化量产。未来，国内企业将进一步拓宽产品品类、扩大产能布局，一方面持续提升成熟制程零部件的使用寿命与产品良率，另一方面加速向先进制程零部件领域实现技术精进与产品突破。

随着国家对半导体产业链供应链安全重视程度持续提升，政策导向与产业需求将形成合力，进一步推动内资半导体精密零部件制造企业高质量发展。

2、发行人产品的市场地位

公司是国内半导体设备精密零部件行业有影响力的企业之一，是国家专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，拥有江苏省晶圆刻蚀设备关键零部件智能车间和大规模集成电路高端装备精密零部件智能制造车间，同时也是江苏省气相沉积设备部件工程技术研究中心、江苏省基于 5 纳米芯片工艺刻蚀设备 PM 模块工程研究中心。通过多年的研发和积累，公司具备了满足半导体设备严苛标准的精密零部件制造能力，产品获得主要客户高度认可，腔体、内衬、加热器、匀气盘等关键工艺部件是主要客户刻蚀设备及薄膜沉积设备的重要供应商。

3、主要竞争对手

国内外涉及半导体设备零部件生产制造且与公司业务产品相似的上市公司主要包括 Ferrotec、京鼎精密、富创精密、珂玛科技和托伦斯等企业。

（1）Ferrotec（6890.T）

Ferrotec 于 1980 年在日本注册成立，主营半导体硅片、半导体设备精密零部件、光伏电池及电子设备等业务，旗下的杭州大和热磁电子有限公司为半导体设备精密零部件业务主要经营实体，是国际半导体设备企业的直接供应商。此外，其还间接控股富乐得（301297.SZ），为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务。

（2）京鼎精密（3413.TW）

京鼎精密于 2001 年在中国台湾地区注册成立，主营半导体精密零部件、半导体设备和医疗设备等业务。京鼎精密在中国大陆地区设有富士迈半导体精密工业（上海）有限公司，从事精密零部件的研发及生产。

（3）富创精密（688409.SH）

富创精密成立于 2008 年，是国内半导体设备金属精密零部件的领军企业，也是全球为数不多的部分产品通过直接客户间接应用于 7 纳米工艺制程半导体设备的金属精密零部件制造商。

（4）珂玛科技（301611.SZ）

珂玛科技成立于 2009 年，主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、

销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，产品已批量生产用于 14nm 和 28nm 制程设备中。

(5) 托伦斯（创业板在审）

托伦斯成立于 2017 年，是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商，致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等，同时，公司工艺能力覆盖激光设备领域，可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。

4、行业主要进入障碍

(1) 技术壁垒

相比于其他行业基础零部件，半导体设备零部件尖端技术密集的特性尤其明显，有着精度高、工艺复杂、要求极为苛刻等特点，主要难点如下：

首先，半导体制造属于精密制造业，对关键零部件在原材料的纯度、原材料批次的一致性、质量稳定性、机加精度控制、洁净清洗等方面要求更高，造成了极高的技术门槛。

其次，半导体制造过程经常处于高温、强腐蚀性环境中，且半导体设备需要长时间稳定运行，因此半导体零部件需要兼顾强度、应变、抗腐蚀、电子特性、材料纯度等复合功能要求。特别在超高温晶圆反应环境中，零部件需承受更高的使用温度，同时必须保持更高的洁净度标准，杜绝高温工况下材料释气、微颗粒析出与离子污染，且要在高温、腐蚀、真空耦合的极端条件下始终保持尺寸精度与性能稳定，进一步大幅提升了材料适配与工艺制造的难度。

最后，半导体设备零部件市场细分领域众多，各个分支类别体量较小，且不同细分品类技术要求和技术难点都有所不同，行业新进入者难以在短期内聚集经验丰富的生产技术人才并投入充足的研发费用，以建立完善的研发体系并开发出满足行业标准的产品，因此较难突破技术壁垒。

(2) 客户及认证壁垒

芯片制造过程非常繁琐，往往涉及到数十种原料配比，且对于电压、温度、气压等参数具有非常严格的要求，反应过程较为复杂，因此生产流程及标准一旦

确定后不会轻易更改。对设备制造商来说，零部件供应需要保持高度一致性，因此客户黏性及壁垒较高。此外，半导体设备厂商认证壁垒也相对较高，设备零部件验证程序十分复杂，下游客户往往会选择长期合作或具备品牌口碑的零部件供应商；在长期产品迭代过程中，国外零部件厂商形成了大量的技术及生产经验积累，而国内厂商因缺乏经验和关键技术很难得到认证机会和规模应用，因此难以突破客户及认证壁垒。

（3）资金和供应链壁垒

在资金方面，相较于半导体设备行业，半导体设备零部件属于资金密集型产业，为满足较高的生产能力要求，零部件的原材料及加工装备要求高并且价格昂贵。例如精密金属制造厂商需要购置数控激光切割机、焊接机器人、精密数控系统等大型高端进口设备。在供应链方面，加工件往往要求高纯度的材料，例如铝和石英，需要大型矿山特别定制；小型零部件厂商采购量小，交货条件欠佳，因此处于被动地位，构成行业进入壁垒。

（四）所处行业与上、下游行业之间的关联性及其上下游行业发展状况

半导体精密零部件产业链成熟且复杂，其上游包含高纯金属（各类不锈钢、高纯铝等）、特种陶瓷（氧化铝、碳化硅、氮化铝等）、高性能涂层材料（ Y_2O_3 、 Al_2O_3 等）等核心基础材料，以及精密加工设备、超精密检测仪器等配套产业。

产业中游包括半导体精密零部件的研发、生产与制造环节，核心产品覆盖金属加热器、匀气盘、陶瓷静电吸盘、真空腔体、内衬等关键部件，广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、光刻、清洗等半导体核心工艺设备，是连接上游材料与下游设备的关键枢纽。

产业链下游主要为半导体设备厂商（如刻蚀机、薄膜沉积设备、光刻机等设备制造商），终端应用覆盖晶圆制造、先进封装等环节，最终服务于 3C 电子、汽车电子、AI 算力、半导体存储、新能源等终端市场。下游设备厂商的技术迭代与产能扩张直接拉动零部件需求，而先进制程（如 7nm 及以下）对零部件的精度、耐腐蚀性、洁净度提出更高要求，推动中游企业技术升级。近年来，国内半导体设备厂商加速突破创新，对本土零部件企业的验证与采购力度加大，为先锋精科等中游企业提供了广阔的市场空间与验证机会；同时，终端市场对 AI 芯

片、HBM 存储等高端产品的需求爆发，进一步带动先进制程零部件的需求增长。

八、发行人主要业务的有关情况

（一）公司主营业务、主营产品或服务

1、公司主营业务

公司是全球为数不多的具备量产 7nm 及以下先进制程半导体关键零部件研发、生产能力的精密制造专家，在国内刻蚀和薄膜沉积设备的半导体关键工艺部件领域具有领先的市场地位，直接与国际厂商竞争。作为国内半导体核心零部件先锋，公司核心零部件已深度融入国产关键设备“血脉”，成为支撑国产设备向先进制程跃迁的关键力量。



精密零部件是半导体设备国产化的重要载体，公司凭借产品专精的特点在国内本土半导体设备厂商国产化浪潮中占据重要地位，从协助客户设备研发定型，到支撑产线量产迭代，最终助力国产设备迈入先进制程领域。在刻蚀领域，公司主要提供以反应腔室、内衬为主的系列核心配套件；在薄膜沉积领域，公司主要提供加热器、匀气盘等核心零部件及配套产品。

经过逾 18 年的技术积累和产品工艺自主研发，公司建立了精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、高性能陶瓷制备及精加工技术和定制化工装开发技术等六大核心技术平台，在日趋严苛的应用条件下，通过生产实践不断实现工艺能力的迭代进化，持续满足先进装备更新迭代的工艺需求，致力于成为全球有竞争力的精密制造企业。

2、主要产品及其用途

公司的产品为应用于半导体设备领域及其他领域的精密零部件，在半导体设备领域，公司产品主要分为关键工艺部件、工艺部件和结构部件，重点应用于半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备中。其中，关键工艺部件具体情况如下：

产品类别	典型类型	图示	应用设备	主要作用	核心性能
腔体	反应腔体		刻蚀设备	参与晶圆制备反应工序的核心零部件，为晶圆生产提供耐腐蚀、洁净和高真空环境。	1、耐腐蚀性： 阳极氧化层在一定浓度的盐酸溶液中浸泡数小时不产生气泡； 2、耐击穿电压： 阳极氧化层的耐击穿电压达到较高水平； 3、密封性： 氦测漏率（即标准大气压下，每秒钟检测氦气量）达到极低水平； 4、真空度： 可达到极低的 torr 数值； 5、洁净度： 紫外线检测下表面无可视荧光粒子
			薄膜沉积设备		
内衬	内衬		刻蚀设备	内衬比反应腔更接近晶圆反应过程，因此对洁净度、耐腐蚀度要求较反应腔更高，通过内衬表面的高致密涂层保护腔体及内部暴露在刻蚀环境下的部件不被腐蚀	1、耐腐蚀性： 阳极氧化层在一定浓度的盐酸溶液中浸泡数小时不产生气泡； 2、耐击穿电压： 阳极氧化层的耐击穿电压达到较高水平； 3、密封性： 氦测漏率（即标准大气压下，每秒钟检测氦气量）达到极低水平； 4、真空度： 可达到极低的 torr 数值； 5、洁净度： 液态粒子检测以及金属元素检测低于一定数量要求； 6、致密性： 孔隙率达到较低水平
加热器	金属加热器		薄膜沉积设备	加热器是给晶圆提供温度场的零件，是直接参与晶圆反应的，温度均匀性、洁净度、密封性性能要求极高，极大程度影响晶圆良率	1、温均性： 整个加热盘面温度差小于一定数值； 2、密封性： 加温状态下漏率低于一定数值； 3、真空度： 加温状态下达到极低的 torr 数值； 4、洁净度： 液态粒子检测以及金属元素检测低于一定数量要求

产品类别	典型类型	图示	应用设备	主要作用	核心性能
匀气盘	匀气盘		刻蚀设备	匀气盘直接参与晶圆反应，特种工艺气体通过匀气盘上的小孔后均匀沉积在晶圆表面，保证晶圆表面膜层的均匀性和一致性。需要保证极高的孔径一致性（成千上万个微孔），同时零件需要超高洁净度以提升晶圆良率	1、洁净度： 液态粒子检测以及金属元素检测低于一定数量要求； 2、孔一致性： 孔径公差控制在数微米之内，孔径均方差低于一定数值； 3、耐腐蚀性： 阳极氧化层在一定浓度的盐酸溶液中浸泡数小时不产生气泡
			薄膜沉积设备		

（二）主要业务经营模式

1、盈利模式

公司主要通过向客户销售产品及提供服务获得收入和利润，产品主要为各类半导体设备精密零部件及功能器件，服务主要为为客户提供表面处理及涂层服务，相关收入均计入主营业务收入。

此外，公司将生产过程中产生的金属废料销售给废料回收商，计入其他业务收入。

2、采购模式

（1）原材料采购

公司主要原材料包括铝、不锈钢等金属原材料，除金属原材料外，公司还根据生产计划采购各类定制件、标准件等，公司制定了严格的供应商筛选制度与合格供应商名单，并定期对供应商的品质、交期、服务等方面进行重新评估以更新合格供应商名录。

公司采取以销定采及安全库存相结合的原材料采购模式，在有采购需求时，公司会根据在手订单及交期汇集原材料采购需求，结合预计生产节奏估算安全库存后下单。

（2）外协采购

公司外协采购主要包括粗加工外协和特种工艺外协两类。

报告期内，为应对公司产品多品种、小批量、定制化的特点，在产业协同生态圈下，从细分领域专业化生产、节约成本和提高产品交付的稳定性、提高工序协同能力和解决生产瓶颈工序出发，公司建立了“使用外协厂商协助前道粗加工和特种工艺外协、公司主导中后道精密机械制造和表面处理工序”的协同生产模式。

3、生产模式

（1）客户认证阶段，包括供应商导入与产品导入阶段

半导体设备零部件的认证壁垒极高，客户认证包括供应商资格认证与新产品首件认证两大核心环节。

供应商导入（供应商资格认证）：客户首先会对公司进行全面的质量体系与制造能力审核。体系与工艺认证：客户需对供应商的质量管理体系及现场管理进行审核，此阶段通常持续 1-3 个月。通过后，客户会深入评估公司的精密加工能力、特定工艺及产能规划。公司凭借成熟的工艺库和稳定的良率，确保在 3-6 个月内通过客户对供应商综合制造能力的认证，正式进入合格供应商名录。

产品导入认证（首件认证）：技术协同与评审：在获得具体产品需求后，公司技术团队会与客户进行深度技术交流，不仅论证现有工艺的可行性，更会主动提出工艺优化建议，在满足性能的前提下协助客户优化成本或提升可制造性。公司综合考量工艺难点、开发成本及预期订单价值后决定是否承接。首件试制与验证：立项后，公司通过严格的 APQP（产品质量先期策划）流程进行工艺设计与开发，经客户确认图纸后进入首件试制。试制件需通过客户的全尺寸检测、机械性能及耐腐蚀/耐磨损等专项测试。此阶段周期因产品复杂度而异，一般在 6-12 个月，通过后即标志着产品进入稳定供应阶段。

（2）批量生产阶段

针对“多品种、小批量、定制化”的生产特点，公司采用精益生产与柔性排产相结合的以销定产模式。

计划与排产：计划部门依据客户的滚动需求预测及正式订单，结合产线设备负荷与人员配置，运用 ERP/MES 系统进行精细化的排产管理，公司会基于历史数据和安全库存模型进行适度备货，以平衡交期压力与库存成本。

过程控制与交付：考虑到产品的复杂性，普通产品的单个批次生产周期一般为 4-6 周；特殊产品，周期约为 8-10 周。

4、销售及定价模式

公司销售模式均为直接销售（直销）。在半导体设备制造领域，零部件供应商的一致性、可靠性和快速响应能力是客户选择供应商的关键，因此客户关系一旦确立便具有高度的稳定性。

定价与谈判：公司采用成本加成与价值导向相结合的定价策略。在获取订单时，以严谨的生产成本测算（包含材料成本、制造费用、专用工装及检测费用）为基础，结合产品的技术附加值、市场竞争态势及长期战略，与客户进行商务谈判确定价格。

价格管理：为维护长期稳定的合作关系，在无设计变更或原材料市场剧烈波动等特殊情况下，公司通常与客户约定年度价格协议，确保同一产品在一年内的销售单价保持稳定，实现与客户的互利共赢。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、产能、产量及销售情况

公司产品呈现多品种、定制化的特点，且需经过多道工序组合生产，并存在产线共用的情形，因此产能利用率根据产线的产能计算。公司最主要的生产设备是各类精密机械加工设备，例如卧式加工中心、龙门加工中心等，报告期内，公司产能利用率如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
理论产能（万小时）	72.33	70.11	50.31
实际生产小时（万小时）	65.39	68.30	43.92
产能利用率（%）	90.41	97.41	87.32

2024 年度，发行人前期资本性支出陆续投产，产能大幅提高；受下游半导体行业景气周期影响，产能利用率升至 97.41%。

报告期内公司主要产品产量、销量、产销率情况如下表：

单位：件、%

产品	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
工艺部件	产量	132,346	128,392	39,211
	销量	130,708	119,725	43,373
	产销率	98.76	93.25	110.61
结构部件	产量	255,947	289,696	108,616
	销量	264,908	273,688	134,408
	产销率	103.50	94.47	123.75
其他部件	产量	37,169	3,669	41,654
	销量	36,888	17,070	38,788
	产销率	99.24	465.25	93.12
模组	产量	1,816	455	193
	销量	1,663	474	156
	产销率	91.57	104.18	80.83

公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户需求和交期，结合产线现有排产计划制定生产计划，并基于安全库存考虑适当备货。

2023 年度，发行人工艺部件、结构部件产销率大于 100%，主要原因系前期延期交付的产品陆续实现销售。2024 年度、2025 年度，发行人工艺部件、结构部件产销两旺，产销率维持高位。

公司其他部件产品主要是医疗和光伏领域的非半导体领域的精密零部件产品。2024 年度，发行人其他部件产销率大幅提高，主要原因系当期产能主要投向半导体领域，其他部件产量下降，同时前期生产的光伏领域零部件陆续交付。2025 年度，随着发行人医疗零部件业务放量，其他部件产销量同比大幅上升，产销基本平衡。

报告期内，随着发行人模组业务的深入开展，发行人模组产、销量整体上升。

2、主要客户情况

报告期内，发行人前五大客户具体情况如下：

单位：万元、%

序号	客户集团	收入金额	占营业收入比例	主要销售产品
2025 年度				
1	北方华创	41,777.73	33.75	工艺部件、结构部件、模组

序号	客户集团	收入金额	占营业收入比例	主要销售产品
2	中微公司	35,007.41	28.28	工艺部件、结构部件、模组
3	屹唐股份	9,540.40	7.71	工艺部件、结构部件、其他部件、模组
4	拓荆科技	8,209.92	6.63	工艺部件、结构部件
5	中硅泰克	5,455.54	4.41	工艺部件、结构部件
合计		99,991.00	80.79	-
2024 年度				
1	北方华创	41,451.28	36.50	工艺部件、结构部件、模组
2	中微公司	35,011.79	30.83	工艺部件、结构部件
3	拓荆科技	8,249.88	7.26	工艺部件、结构部件
4	屹唐股份	6,991.21	6.16	工艺部件、结构部件、模组
5	中硅泰克	3,628.39	3.19	工艺部件、结构部件
合计		95,332.56	83.94	-
2023 年度				
1	中微公司	16,398.46	29.40	工艺部件、结构部件
2	北方华创	15,718.62	28.18	工艺部件、结构部件、其他部件、模组
3	拓荆科技	3,755.51	6.73	工艺部件、结构部件
4	微导纳米	3,438.20	6.16	工艺部件、结构部件、其他部件
5	屹唐股份	2,776.21	4.98	工艺部件、结构部件、模组
合计		42,087.00	75.46	-

注：前五名客户按照受同一实际控制人控制或归属于同一集团公司的客户的销售情况以合并口径列示

报告期内，发行人对前五大客户的销售额占当期销售总额的比重分别为 75.46%、83.94%和 80.79%，客户集中度较高且较为稳定，不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。半导体行业技术和资本高度密集，导致下游设备企业、晶圆代工企业呈现数量少、规模大的特征，发行人前五大客户集中度较高符合行业特征，发行人与主要客户合作稳定具有可持续性，不存在重大不确定性风险。

（四）采购情况和主要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，发行人采购的原材料主要包括铝合金和不锈钢等金属原材料、定制件、标准件、刀具和辅材，各类原材料构成情况如下：

序号	类别	具体内容
1	铝合金	各类板材、锻造件、棒材
2	不锈钢	各类不锈钢
3	其他金属原材料	铜材、镍材等
4	定制件	经过机械加工的铝合金、不锈钢等加工件
5	标准件	规格、结构、尺寸统一的通用产品，例如阀门、法兰等
6	工装刀具	设备加工金属材料时使用的铣刀、钻头金属切削工装治具、夹具、模具等
7	辅材	包材、化学品等

报告期内，发行人采购情况及占比如下：

单位：万元、%

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
金属原材料	铝合金	10,004.52	14.06	11,145.39	16.32	7,511.65	24.91
	不锈钢	338.29	0.48	188.61	0.28	419.25	1.39
	其他金属材料	374.31	0.53	308.75	0.45	172.30	0.57
原材料小计		10,717.12	15.06	11,642.75	17.04	8,103.20	26.88
定制件		30,054.44	42.23	28,301.31	41.43	10,560.59	35.03
标准件		3,572.76	5.02	4,191.26	6.14	2,080.21	6.90
工装刀具		854.23	1.20	856.69	1.25	499.71	1.66
辅材		7,187.78	10.10	7,072.08	10.35	2,212.61	7.34
外协加工		18,776.94	26.39	16,242.05	23.78	6,692.99	22.20
合计		71,163.27	100.00	68,306.15	100.00	30,149.31	100.00

报告期内，发行人各类原、辅材料的采购金额与业务规模整体较为匹配。

2024 年度，随着订单规模增加，发行人采购规模随之增大；同时，发行人综合自身产能情况，加大粗加工定制件采购，使得定制件采购占比上升。2025 年度，发行人采购情况与 2024 年度基本一致。

发行人基于成本经济效益原则，将部分非关键工序交由外协厂商处理；同时，对于自身尚不具备加工能力或尚不成熟的生产工艺，根据客户指定或推荐委外生产。

2、主要能源使用情况

公司产品生产主要消耗能源为水、电和蒸汽，报告期内，公司能源耗用具体情况如下所示：

能源	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
水	数量（吨）	300,867.80	97,728.00	68,728.00
	单价（元/吨）	4.11	4.12	4.10
	采购总额（万元）	123.69	40.25	28.19
电力	数量（万度）	2,832.99	1,357.34	1,003.10
	单价（元/度）	0.80	0.86	0.87
	采购总额（万元）	2,258.72	1,160.91	874.77
蒸汽	数量（吨）	9,112.06	6,179.06	2,447.97
	单价（元/吨）	230.12	247.09	277.16
	采购总额（万元）	209.69	152.68	67.85

发行人水、电、蒸汽消耗量整体呈增长趋势，与发行人生产经营规模相匹配。

2025 年度，发行人水采购量大幅上升，主要原因系当期发行人新增多条表面处理产线、提高表面处理标准，相关耗水量增加。

2025 年度，发行人电力采购量大幅上升，主要系为改善加工环境、提升产品工艺能力，发行人新增多间高规格洁净室及大量机器设备，带来耗电量增加；单价略有下降，主要原因系当年发行人接入单价较低的光伏发电。

报告期内，发行人蒸汽主要由表面处理产线使用，其耗用量随着发行人表面处理能力提升而上升；采购单价有所下降，主要系随着蒸汽用量增加，发行人与供应商协商降价。

3、主要供应商情况

报告期内，发行人前五名供应商具体情况如下：

单位：万元、%

序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	主要采购产品
2025 年度				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	8,002.74	11.25	外协加工、定制件、标准件
2	无锡元基精密机械有限公司	5,341.29	7.51	定制件、原材料

序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	主要采购产品
3	东贺隆（昆山）电子有限公司	5,309.51	7.46	外协加工
4	苏州市乐了精密机械制造厂	5,275.70	7.41	定制件、外协加工、标准件
5	苏州首铝金属有限公司	2,749.29	3.86	原材料
合计		26,678.53	37.49	-
2024 年度				
1	苏州市乐了精密机械制造厂	7,639.22	11.18	定制件、辅材、外协加工、标准件
2	靖江新恒和半导体科技有限公司	7,438.90	10.89	外协加工、定制件、辅材、标准件
3	无锡元基精密机械有限公司	5,618.26	8.23	定制件、原材料
4	东贺隆（昆山）电子有限公司	4,796.84	7.02	外协加工
5	优密铝业（苏州）有限公司	2,443.91	3.58	原材料
合计		27,937.12	40.90	-
2023 年度				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	3,520.13	11.68	定制件、外协加工、标准件、辅材
2	苏州市乐了精密机械制造厂	3,047.39	10.11	定制件、外协加工、标准件、辅材
3	无锡元基精密机械有限公司	1,947.59	6.46	定制件、原材料、外协加工
4	苏州首铝金属有限公司	1,536.03	5.09	原材料
5	东贺隆（昆山）电子有限公司	1,485.81	4.93	外协加工、辅材
合计		11,536.95	38.27	-

报告期内，发行人供应商结构较为稳定，不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况，发行人与上述主要供应商不存在关联关系。

（五）境外采购、销售情况

报告期内，公司境内外采购情况及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆地区	70,760.01	99.43	67,877.15	99.37	29,883.42	99.12
中国大陆以外	403.25	0.57	429.00	0.63	265.89	0.88
合计	71,163.27	100.00	68,306.15	100.00	30,149.31	100.00

报告期内，发行人境外采购金额占比分别为 0.88%、0.63%和 0.57%，境外采购比例处于较低水平。

报告期内，发行人主营业务收入分境内外构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆地区	120,875.82	98.25	110,827.51	98.27	53,779.80	97.78
中国大陆以外	2,148.20	1.75	1,954.10	1.73	1,223.13	2.22
合计	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

报告期内，发行人主营业务以中国大陆地区为主，中国大陆以外地区收入占主营业务收入的比例分别为 2.22%、1.73%和 1.75%，占比较低。

（六）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务发展安排

（1）经营目标及发展规划

公司将以公司发展战略为导向，继续巩固和增强公司在行业的市场优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

（2）技术研发规划

未来三年，公司将继续加大技术开发和自主创新力度。在核心技术创新方面，公司将进一步推动现有精密加工技术的优化和应用，并转化为技术专利予以保护，增强公司的技术壁垒，保证公司核心技术的领先性。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 129 项专利。公司未来将继续积极申请相关专利。

同时，公司将根据公司发展战略对产业链横向发展的需要，将现有精密加工技术应用范围进一步在功能器件等应用领域进行推广，补齐短板，促进技术成果向新产品转化，形成新的利润增长点。

（3）营销发展规划

通过长期合作，公司与核心半导体设备制造商的合作关系日趋稳定，与核心客户的合作领域及订单逐步扩大。公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广

力度及合作渠道建设，逐步完善公司的营销能力。

根据公司发展战略，在继续深耕半导体设备领域客户的同时，公司将大力拓展医疗、航空航天等其他领域客户，逐步与一批核心客户建立持续合作关系，为公司创造新的业绩增长点，把握半导体国产化及智能制造发展浪潮所带来的广阔发展空间，依托核心精密制造技术，为公司开辟新的业绩增长点。

（4）人力资源发展规划

技术是公司核心竞争力的源泉，人才是公司最宝贵的资源，高素质的研发人才和管理人才是公司持续发展的基石。公司将持续优化人才结构，在现有人员的基础上，择优引进公司急需的、具有较高素质的各类专业研发人才，重点引进精密机械制造、材料科学、半导体器件设计、表面处理等领域人才，保证在核心技术研发领域的充分投入，进一步提高在半导体设备精密零部件领域技术的领先性。除此之外，公司将持续吸收高水平的经营管理人才、市场策划和营销人才。

未来三年，公司将持续完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，严格遵循薪酬管理基本原则，结合公司经营效益与市场薪酬水平调整薪酬标准，调动员工的积极性。制定各种激励优惠政策，从工资待遇、事业发展、技能培训上给予激励和保障，激励公司人才充分发挥自身优势，增加公司的凝聚力，保证公司的健康、持续发展。

（5）完善内部治理结构规划

公司将按照上市公司的要求，进一步完善法人治理结构，规范股东会、董事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，提升治理规范化水平。通过对组织结构的调整，适配半导体零部件“小批量、多批次、定制化”的产品特点，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司的竞争实力。此外，公司自实施精益化运营管理以来取得良好的成效，未来公司将进一步加大精益化管理的力度和深度，优化柔性化加工生产体系，推进数字化智能管理，实现生产流程实时跟踪与追溯，持续推进降本增效，保障产品一致性与交付效率。

2、未来发展战略

公司致力以核心精密制造技术推动半导体国产化进程，专注服务半导体、医疗、航空航天等工业领域，提供业界领先的高端半导体设备精密零部件产品，以精密制造赋能现代半导体工业高质量发展。

公司在半导体领域，作为国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键精密零部件核心供应商，提供刻蚀腔体、内衬、晶圆加热器等关键工艺部件与结构部件。在医疗领域，依托精密制造技术优势，积极开发高附加值零部件产品，拓展多元精密制造领域。在航空航天领域，逐步突破相关产品表面处理业务，构建多领域发展格局。先锋精科凭借高效可靠的产品能力、全流程自主制造优势及快速供应链响应能力，帮助工业客户提升竞争优势，推动半导体核心零部件生态链的融合创新进程。

先锋精科始终坚持以核心精密制造技术推进半导体核心零部件国产化升级，以高标准严要求成就半导体工业质量与效率。未来，先锋精科将继续坚持长期主义，深耕半导体设备核心精密零部件领域，持续拓展医疗、航空航天等多元领域，持续为客户创造价值，筑牢国产半导体核心设备供应链基础，努力成为全球有竞争力的精密制造专家。

九、与产品或服务有关的技术情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司研发投入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	7,137.71	6,408.32	3,630.90
营业收入	123,772.76	113,577.41	55,771.69
占当期营业收入比例	5.77	5.64	6.51

报告期内，公司研发形成的重要专利详见本节“十、主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产”。

（二）核心技术人员、研发人员情况

报告期各期末，公司研发人员数量及占比情况如下：

单位：人、%

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
研发人员数量	156	157	106
总员工数量	1,522	1,207	710
研发人员占比	10.25	13.01	14.93

公司核心技术人员为游利、XUZIMING、管明月、周红旗、贾坤良、刘国辉。核心技术人员简历及变动情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、董事、高级管理人员、其他核心人员”之“（二）现任董事、高级管理人员和其他核心人员的简历”。

（三）核心技术及技术来源

经过多年积累，公司具备了金属零部件精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、高性能陶瓷制备及精加工技术和定制化工装开发技术等多项技术体系，能够根据产品的不同使用环境需求搭配出最高效的材料方案和工艺实现路径，是发行人的核心技术壁垒。公司主要依托精密机械制造技术、焊接技术进行高精度机械制造，对于需要表面处理技术的产品，公司能够通过自身积累的硬质阳极氧化技术、增强型阳极氧化技术、高性能化学镀镍技术和高洁净度精密清洗技术，满足客户对产品严苛的耐腐蚀性要求。

1、精密机械制造技术

发行人经过多年的制造经验积累和新产品开发经验，针对复杂多样的产品特性，形成了应对多种复杂零件的精密制造技术、高平面度和粗糙度控制制造技术、高精度微小孔制造技术等精密机械制造技术，能够满足半导体设备制程不断迭代演进的技术需求，实现对多种类金属复杂腔体、复杂多面体零部件的超精细切削制造和高精度控制。

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
复杂零件精密制造技术	腔体、内衬等各类金属零部件，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	自主研发	1、多种类铝合金和不锈钢复杂腔体加工：可加工复杂曲面和复杂结构的各类腔室，反应腔最大尺寸可达 2400x2400x300 毫米，传输腔最大尺寸可达 3200x1800x420 毫米，单件几何尺寸达 500 以上； 2、柔性制造技术：实现复杂多面体零部件的连续加工； 3、高精度控制：加工过程中进行实时测量，

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
			确保尺寸； 4、密封面粗糙度加工控制：通过严格的工艺和过程控制，保证了密封面的精度和粗糙度，安装后，保证设备的超高真空密封要求
高平面度和粗糙度控制制造技术	腔体、内衬、匀气盘、真空吸盘、静电吸盘等各类金属零部件，应用于刻蚀设备	自主研发	多种铝合金和不锈钢半导体零部件表面精密零件加工： 通过切削优化与精密研磨技术，平面度平行度小于等于 2 微米；粗糙度控制在 Ra0.02 微米以内
高精度微小孔制造技术	匀气盘，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	自主研发	1、微小孔加工：可加工最小孔径为 0.15 毫米小孔； 2、微小深孔加工：可以加工孔深度与孔直径比为 25 倍的微小深孔； 3、多孔高精度加工：数千到上万个微小孔的孔径标准差最低可达 0.25 微米； 4、微孔内壁粗糙度：Ra0.4微米以内
超精密测量技术	对超精密特征零部件进行准确的检测	自主研发	1、超微特征的尺寸精度以及特征都超过了三坐标的检测范围； 2、选用微米级测量仪器配合自研工装夹具实现对超微特征以及超精尺寸测量，保证零件的尺寸精度； 3、分辨率在 0.1-10 微米之间，测量范围最大可达 1 米

2、表面处理技术

发行人通过综合运用阳极氧化、化学镀镍和高洁净度清洗等多项表面处理工艺，赋予了半导体零部件超高洁净度、超强耐腐蚀能力、高抗裂性等特殊能力，大幅提高了产品的使用寿命和性能。

核心技术名称	主要应用	技术来源	具体特征
高致密硬质阳极氧化技术	刻蚀设备中的腔体、加热器、匀气盘、内衬等	自主研发	1、应用于刻蚀设备中高腐蚀性工作环境，为接触到刻蚀介质的关键部件提供有效保护，隔离杂质元素对晶圆反应环境的渗透污染； 2、耐腐蚀：经过高致密硬质阳极氧化技术处理后的产品，在 5%浓度盐酸浸泡实验中，可取得 400 分钟无气泡产生
增强型阳极氧化技术	特殊刻蚀设备中的高温和强腐蚀环境中的腔体、加热器、匀气盘、内衬等，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	自主研发	1、抗裂性：在大于 100 摄氏度的环境中，无可视裂纹，具有优良的抗裂性； 2、耐腐蚀：经过增强型阳极氧化技术处理后的产品，在 5%浓度盐酸气泡实验中，可取得 600 分钟无气泡产生
高洁净度精密清洗技术	加热器、内衬、传输腔、匀气盘	自主研发	经过高洁净度精密清洗技术处理后的零部件，可达到：

核心技术名称	主要应用	技术来源	具体特征
	等，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等		1、QIII颗粒度：按照零件表面积换算的每平方厘米含有直径大于0.2微米的粒子数量<5； 2、LPC液粒计数：按照零件表面积换算的每平方厘米含有直径大于0.2微米的粒子数量≤100000； 3、ICP-ms微量金属残留：按照零件表面积换算的每平方厘米含有的13种微量金属杂质数量少于标准数量
高性能超高磷镀镍工艺	薄膜沉积先进制程用设备工艺部件	自主研发	1、采用流体涡旋镀膜工艺实现复杂结构、超大面积工件无表面缺陷； 2、镀层磷含量在12%-16%之间； 3、盐雾测试24小时后镀层不能出现基体腐蚀现象； 4、浓硝酸溶液中完全浸泡大于30秒，洗净后镀层无变色

3、焊接技术

发行人为达到对复合结构精密件的导热性、密封性、洁净度等特定性能要求，需要半导体设备零部件制造商充分评估产品材料性能及功能要求，对焊接材料、焊接工艺、焊接参数等进行研究，持续满足不断迭代的半导体设备工艺制程的严苛要求。

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
FSW 搅拌摩擦焊接技术	加热器、内衬、传输腔等，应用于刻蚀、PECVD 和 PVD 设备等	自主研发	1、将摩擦焊工艺引入带磁环阴极内衬制造，通过对零件工艺和结构的改良，解决了传统焊接工艺中的过热导致的磁性失效； 2、通过对摩擦焊的精准控制，极大提高了焊缝质量，使得内衬在高腐蚀环境下的使用寿命提高三倍以上
机器人自动焊接技术	冷却环，应用于刻蚀、PVD 设备等	自主研发	1、具备稳定的焊接质量，一致性高，可精确定位控制焊接轨迹，有效克服手工焊接一致性差的问题； 2、解决传统手工大批量加工受人为因素影响焊熔深不稳定的问题，焊接质量达到国内半导体设备龙头企业标准
真空钎焊技术	加热器、内衬和水冷板等，应用于刻蚀、PECVD 和 PVD 设备等	自主研发	1、将真空钎焊技术应用在具有复杂构造的晶圆加热器生产中，实现多达5层结构的结合面熔合，满足加热器严苛温均性要求下的高效热传导； 2、可实现大截面产品的焊接要求，在复杂结构匀气盘制造中采用真空钎焊技术，最大直径可达900mm； 3、通过精准控制焊料，可解决薄壁复杂流道结构的焊接，实现流道畅通无堵塞
真空电子束焊接技术	加热器、匀气盘等工艺部件	自主研发	1、更高的深宽比，且无需焊接坡口，深宽比最大可达50:1；

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
			2、热输入非常少，所以只有非常小的焊接变形，直径300mm特征焊接，变形量可以控制在0.05mm以内； 3、热输入小，接头及影响区性能接头性能更高可达母材的80%； 4、配合先锋柔性制造技术以及定制化工装开发技术，焊接自动化程度以及焊接一致性上更高，目前已经实现焊接过程完全自动化

4、高端器件的设计及开发技术

从全球范围看，半导体设备内使用的高端器件市场主要为国外厂商所垄断，其中加热器是半导体设备零部件中技术难度较高、工艺制造较为复杂且具备完整功能的高端器件之一。经过多年自主研发，公司是国内少数已实现量产金属加热器的供应商，并成为国内龙头半导体装备企业的战略合作伙伴。

基于晶圆先进制程中对加热器多样性、高功效、高温均性、高洁净等的严苛要求，发行人需要针对性结构设计，将经过特殊设计的发热元件与载台匹配组合，通过热场设计、仿真模拟和功能实验等技术手段，使得发热元件性能和晶圆接触结构精确匹配，实现半导体制程中的精准温控，并满足半导体产品工艺效益和持续可靠性。

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
均匀温场设计技术	加热器，应用于刻蚀、薄膜沉积设备等	自主研发	1、可根据客户不同应用场景，进行多种加热器的整体设计； 2、根据使用工况，进行力学、加热器功率计算、温度分布仿真，确保结构稳定、温度分布最优； 3、使用特殊设计的快速样件进行温度测试，确保温度分布符合客户需求； 4、各种应用环境产品的设计加工；积累了300余种型号的各类晶圆加热器的研发设计经验
热损控制技术		自主研发	1、可通过隔热设计，引入合适的金属隔热层，以低成本降低热量损失，确保晶圆加热器表面温度均匀性； 2、使用特殊热喷涂技术，在易导热界面上形成陶瓷隔热层，可大幅提升密封圈的使用寿命和晶圆加热器的表面温度均匀性； 3、通过多区温度补偿技术，通过控制功率输出百分比，减少因腔体内部结构导致的局部热量损失过大的问题，实现一款加热器可使用于多种不同尺寸的真空腔体内
协同控温技术		自主研发	1、可通过特殊冷却结构设计，使得在500°C高温运行时也可进行水冷和气冷，抵消工艺产生的

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	具体特征
			大量热量对温度控制的影响，确保控温准确； 2、通过设计内置的全贴合冷却部件，加热管加热、冷却部件同时通冷却液，可以在<100°C低温工况时获得更精准的温度均匀性
高均匀性晶圆加热器制造技术		自主研发	1、可通过特殊的表面粗糙度制造技术，减少金属盘面与晶圆的接触面积，大幅减少金属离子污染； 2、可通过精密加工，在晶圆加热器表面加工数百个微型凸台，与晶圆的接触面积降至 1%； 3、通过定制化精密抛光工艺，控制表面平面度 $\leq 2.5\mu\text{m}$ ，粗糙度 $< \text{Ra}0.025$ ，减少颗粒吸附； 4、在工作温度的温度均匀性可以保证 $\pm 0.8\%$ ； 5、产品正常使用寿命可以 $\geq 30,000$ 小时
核心部件性能升级技术		自主研发	1、可通过流道、冷却管路、增加辅助加热等的结构设计，大幅提升机台的冷却和升温速度，可以缩短 2/3 的冷却时间，提升工艺效率； 2、通过升级局部辅热装置，消除原有的冷点，提升整体的加热效率，可将晶圆达到热平衡所需的时间缩短至原来的 50%，温度均匀性提升至 $\pm 0.5\%$ ，提升工艺效率； 3、通过对零部件表面形貌、电极等的优化设计，减少卡盘类零件被等离子体击穿的风险，使用寿命可以提升至 2 倍以上
晶圆检测模组和真空腔体模组设计组装技术		自主研发	1、模块化设计：允许灵活配置和升级，内部集成快速调温装置，以兼容 6、8、12 及更大尺寸的晶圆加热器； 2、集成温度控制系统，以控制腔体内的温度，可搭载自动化控制系统，集成高效真空泵和精密控制阀门，用于抽气和气体流量控制，气体流量控制兼容从 0-6000SCCM 的气体流量需求，测试模组腔体压力可以精准控制在 0.01mtorr-10torr

5、高性能陶瓷制备及精加工技术

陶瓷加热器在材料纯度、高温耐受性及服役寿命方面设定了严苛标准，制造过程对热场一致性、耐腐蚀能力与长期运行可靠性提出了极高挑战。核心工艺作为决定产品性能与良率的关键环节，其技术水准与过程管控能力直接影响到芯片制造环节中的加热精度与最终产出表现。发行人通过长期研发构建了涵盖原料掺杂及造粒、热压烧结、冷等静压及常压烧结、多层填埋加热盘共烧成形以及陶瓷精密加工等在内的核心技术体系，在此过程中推动制造工艺不断迭代、生产效能稳步提升。

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	先进性及具体表征
原料掺杂及造粒	盘体, 主要应用于薄膜沉积设备	自主研发	<p>1、原始氧化铝粉体流动性差, 难以直接成型。喷雾造粒将粉体制成球形造粒粉, 流动性好、松装密度高, 在模压或冷等静压成型时均匀填充模具, 减少空洞和缺陷, 确保素坯密度分布均匀。</p> <p>2、造粒过程中可同步引入烧结助剂和功能掺杂剂, 通过浆料混合实现各组分的高度均匀分散, 避免干法混合导致的成分偏析。均匀掺杂可有效降低烧结温度、促进致密化, 同时调控晶界相组成和微观结构。</p>
热压烧结技术	盘体, 主要应用于薄膜沉积设备	自主研发	<p>1、热压烧结使氧化铝陶瓷致密且热导率高, 进而保证加热器升温迅速、热场分布均匀, 充分满足晶圆加工对温度一致性的严苛要求。</p> <p>2、热压烧结无需添加或仅需极少量烧结助剂, 并在真空或保护气氛下进行, 有效避免杂质污染。氧化铝陶瓷加热器因此具备高纯度、优异的耐腐蚀性能, 符合半导体设备对洁净度的严格标准, 保障真空环境下的长期稳定运行。</p>
冷等静压及常压烧结技术	支撑轴, 主要应用于薄膜沉积设备	自主研发	<p>1、冷等静压利用液体介质对粉末施加各向均匀压力, 使坯体密度分布一致, 有效减少烧结变形和开裂风险。同时, 该工艺可成型细长、带台阶、螺纹等复杂结构的支撑轴素坯, 满足不同型号加热器的多样化设计需求, 为后续烧结提供高质量、形状适配的坯体基础。</p> <p>2、常压烧结无需外加压力, 可得到高致密的烧坯, 具备良好的机械强度、绝缘性能和耐腐蚀性能。该工艺无需昂贵模具, 设备投入和运行成本较低, 可灵活排产, 适合多品种、小批量生产, 且批次一致性好。</p>
多层填埋加热盘热压成形技术	盘体, 主要应用于薄膜沉积设备	自主研发	<p>1、RF mesh网在热压过程中与陶瓷基体同步烧结, 通过均匀分散压力确保RF mesh网在加热盘内部保持平整。同时, RF mesh网与陶瓷基体热膨胀系数匹配良好, 热压过程中界面结合应力均匀释放, 避免因热应力集中导致的界面开裂或分层, 保证加热盘的结构完整性。</p> <p>2、加热丝经模具定位后与陶瓷同步烧结成型, 牢固镶嵌于陶瓷内部, 避免烧结收缩导致偏移。界面结合紧密, 无明显缺陷, 防止热应力产生微裂纹, 确保长期可靠性。</p>
陶瓷精加工技术	普遍适用	自主研发	<p>1、采用精密磨削、研磨、抛光等工艺, 实现微米级尺寸公差控制, 确保加热器与晶圆、腔体等部件的精准配合。</p> <p>2、通过精密平面磨削和化学机械抛光, 获得亚微米级表面粗糙度 ($Ra \leq 0.5\mu m$) 和极高平面度, 保障晶圆加热均匀性。</p> <p>3、采用数控磨削实现热电偶孔、安装孔、定位槽、台阶、螺纹等复杂结构的精准成型</p>

6、定制化工装开发技术

半导体设备金属零部件具有结构复杂、加工精度要求高、多品种、小批量的特点，加工制造过程对一致性和生产效率的要求极高。精密工装作为对零部件进行定位、夹持、锁紧的工具，其设计和使用会对产品的质量和生产效益产生较大影响。发行人通过长期研发积累了门式工装、动力工装、标准化和互换性工装等技术并应用于生产实践，高效完成客户的定制化复杂产品需求，以此使得生产制造方式不断优化、现有设备及生产效率持续提升，同时与先进加工管理流程进行结合，实现了良好的成本与质量效益。

核心技术名称	主要应用产品	技术来源	先进性及具体表征
典型反应腔室高效生产工装技术	腔体，主要应用于刻蚀设备	自主研发	1、通过门式工装的设计，仅两次作业工序转换，就可以集成所有 CNC 精密作业任务，装夹次数减少 50%，降低多次定位精度偏差； 2、结合刀具及程序优化，使得加工时间降低 20% 以上，实现腔体单机连续生产
动力装置设计及应用技术	腔体、法兰盘等，主要应用于刻蚀设备及光伏设备	自主研发	1、在精密加工中，通过运用动力工装，对 CNC 设备低效作用区和加工死区进行替换和补充作业，起到增加产能和提效降本作用； 2、在依赖传统手工作业的局部表处理工序中，通过动力装置实现人工替换，保障工艺稳定性，并提高生产效率； 3、在洁净工艺中，通过动力装置，在局部死角实现循环清洗
标准化和互换性工装技术	各类零部件	自主研发	1、在各类设备以及工装设计中，将标准化技术应用于定位、锁紧和夹持等执行功能中，支持零件和工装在多工种、多类型设备间的快速和灵活转换； 2、通过互换性技术设计的同类零部件通用型工装，有效应对同类型多品种研发快速响应需求，显著提升新品开发能力

十、主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备及构筑物等，目前使用状况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人固定资产情况如下：

单位：万元、%

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	17,056.30	2,005.41	15,050.89	88.24

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
机器设备	31,523.36	9,186.27	22,337.09	70.86
运输设备	489.16	324.95	164.21	33.57
电子设备	827.58	426.76	400.82	48.43
其他设备及构筑物	9,781.96	4,179.57	5,602.39	57.27
合计	59,678.37	16,122.97	43,555.40	72.98

1、房屋及建筑物

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有房产情况如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落位置	房屋建筑面积 (m ²)	用途	登记时间	他项权利
1	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000283号	靖江市新港大道195号9幢	28.77	工业	2023.1.9	-
2	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000284号	靖江市新港大道195号5幢	3,338.71	工业	2023.1.9	-
3	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000286号	靖江市新港大道195号4幢	3,487.95	工业	2023.1.9	-
4	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000287号	靖江市新港大道195号7幢	4,995.57	工业	2023.1.9	-
5	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000288号	靖江市新港大道195号3幢	4,194.06	工业	2023.1.9	-
6	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000289号	靖江市新港大道195号6幢	2,096.08	工业	2023.1.9	-
7	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000290号	靖江市新港大道195号8幢	3,337.50	工业	2023.1.9	-
8	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000291号	靖江市新港大道195号2幢	6,290.22	工业	2023.1.9	-
9	先锋精科	苏(2025)靖江市不动产权第1148271号	靖江市新港大道195号10幢	1,657.42	工业	2025.3.17	-
10	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0020087号	靖江市新港大道195号11幢	2,893.16	工业	2026.2.25	-
11	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0020088号	靖江市新港大道195号12幢	1,330.58	工业	2026.2.25	-
12	先锋	苏(2026)靖江市不	靖江市新港	1,082.38	工	2026.4.10	-

序号	权利人	不动产权证号	坐落位置	房屋建筑面积 (m ²)	用途	登记时间	他项权利
	精科	动产权第 0064440 号	大道 195 号 13 幢		业		
13	先锋精科	苏 (2026) 靖江市不动产权第 0064441 号	靖江市新港大道 195 号 14 幢	979.79	工业	2026.4.10	-
14	靖江先捷	苏 (2023) 靖江市不动产权第 0042591 号	靖江经济技术开发区新兴路 6 号	15,578.16	工业	2023.11.22	抵押注
15	靖江先捷	苏 (2026) 靖江市不动产权第 0020243 号	靖江经济技术开发区新兴路 6 号 3 幢	25,981.91	工业	2026.2.25	抵押注
16	靖江先捷	苏 (2026) 靖江市不动产权第 0020244 号	靖江经济技术开发区新兴路 6 号 4 幢	3,427.44	工业	2026.2.25	抵押注

注：该三项不动产已向招商银行股份有限公司泰州分行设定抵押，担保最高债权额为 2.10 亿元，贷款期限为 2025.1.24-2035.1.23

2、租赁房产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司租赁的主要房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
1.	先锋精科	鼎电智能科技 (江苏) 有限公司	靖江经济开发区新太路 1 号 6 号楼	3,100.00	2023 年 7 月 18 日-2026 年 7 月 17 日	厂房
2.	先锋精科	鼎电智能科技 (江苏) 有限公司	靖江经济开发区新太路 1 号 5# 制造车间	3,100.00	2024 年 3 月 1 日-2027 年 2 月 28 日	厂房
3.	先锋精科	鼎电智能科技 (江苏) 有限公司	靖江经济开发区新太路 1 号 (4# 试验车间) 1 至 3 楼	4,337.73	1 楼：2024 年 7 月 1 日-2027 年 6 月 30 日，2-3 楼：2024 年 8 月 1 日-2027 年 7 月 30 日	厂房
4.	先锋精科	鼎电智能科技 (江苏) 有限公司	靖江经济开发区新太路 1 号 3 号楼第五层楼	1,800.00	2025 年 4 月 1 日-2026 年 3 月 31 日	厂房
5.	先锋精科	靖江佳晟	靖江经济开发区新兴路 9 号车间 3	1,974.98	2022 年 8 月 1 日-2027 年 9 月 30 日	厂房、办公
6.	先锋精科	靖江佳晟	靖江经济开发区新兴路 9 号车间 3	1,974.98	2022 年 5 月 1 日-2027 年 7 月 31 日	厂房、办公
7.	无锡先研	无锡普诚节能科技产业发展有限公司	无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 4 号库一楼部分面积	3,297.67	2024 年 9 月 1 日-2026 年 8 月 31 日	厂房、办公

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
8.	无锡先研	无锡普诚节能科技产业发展有限公司	无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号库一楼部分面积	2,808.47	2025年5月1日-2026年4月30日	厂房、办公
9.	无锡先研	无锡普诚节能科技产业发展有限公司	无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号厂房二楼右侧	1,699.44	2025年5月1日-2026年4月30日	厂房、办公
10.	无锡至辰	无锡普诚节能科技产业发展有限公司	无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号厂房二楼左侧	1,552.00	2025年7月1日-2026年4月30日	厂房、办公
11.	靖江先捷	靖江中渊储能科技有限公司	靖江市经济技术开发区新太路51号厂区西南空地	11,449.00	2024年7月10日-2026年7月9日	停车场

(二) 主要无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落位置	宗地面积 (m ²)	用途	土地使用权 期限至	取得 方式	他项 权利
1	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000283号	靖江市新港大道195号9幢	40,017.00	工业	2068.11.28	出让	-
2	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000284号	靖江市新港大道195号5幢					-
3	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000286号	靖江市新港大道195号4幢					-
4	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000287号	靖江市新港大道195号7幢					-
5	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000288号	靖江市新港大道195号3幢					-
6	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000289号	靖江市新港大道195号6幢					-
7	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000290号	靖江市新港大道195号8幢					-
8	先锋精科	苏(2023)靖江市不动产权第0000291号	靖江市新港大道195号2幢					-
9	先锋精科	苏(2025)靖江市不动产权第1148271号	靖江市新港大道195号10幢					-

序号	权利人	不动产权证号	坐落位置	宗地面积 (m ²)	用途	土地使用权 期限至	取得 方式	他项 权利
10	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0020087号	靖江市新港大道195号11幢					-
11	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0020088号	靖江市新港大道195号12幢					-
12	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0064440号	靖江市新港大道195号13幢					-
13	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0064441号	靖江市新港大道195号14幢					-
14	先锋精科	苏(2026)靖江市不动产权第0039323号	靖江市斜桥镇罗家村、柏一村	33,299.00	工业	2076.03.19	出让	-
15	无锡先研	苏(2022)无锡市不动产权第0184013号	新吴区新华路东侧、南丰一路北侧	10,543.10	工业	2072.06.22	出让	-
16	无锡先研	苏(2023)无锡市不动产权第0249944号	新吴区新华路与南丰一路交叉口东北侧	20,790.20	工业	2073.04.11	出让	-
17	靖江先捷	苏(2023)靖江市不动产权第0042591号	靖江经济技术开发区新兴路6号					抵押 ^注
18	靖江先捷	苏(2026)靖江市不动产权第0020243号	靖江经济技术开发区新兴路6号3幢	39,797.00	工业	2070.09.23	出让	抵押 ^注
19	靖江先捷	苏(2026)靖江市不动产权第0020244号	靖江经济技术开发区新兴路6号4幢					抵押 ^注

注：该三项不动产已向招商银行股份有限公司泰州分行设定抵押，担保最高债权额为 2.10 亿元，贷款期限为 2025.1.24-2035.1.23

2、商标

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人共拥有 6 项商标权，具体情况如下：

序号	类别	权利人	有效期限	商标注册号	商标标识	取得方式
1	7、9	发行人	2023.2.14-2033.2.13	66336191A	SPRINTEC	原始取得
2	7、9	发行人	2023.5.7-2033.5.6	66419047	SPRINTU	原始取得
3	7、9	发行人	2023.10.7-2033.10.6	67516913A	先峯	原始取得
4	7、9	发行人	2023.10.28-2033.10.27	70541006	SPRINTSEMI	原始取得
5	7、9	发行人	2024.2.28-2034.2.27	70552360	SPRINTAERO	原始取得

序号	类别	权利人	有效期限	商标注册号	商标标识	取得方式
6	9	发行人	2025.7.14-2035.7.13	82632648A	先锋精科	原始取得

3、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 38 项授权发明专利、91 项授权实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
1	ZL202211692721.4	一种高温金属外壳晶圆加热器及其加工方法	先锋精科;无锡至辰	发明专利	2022 年 12 月 28 日起 20 年	原始取得
2	ZL201210012959.8	一种新的电介质刻蚀机气体分配器加工工艺	先锋精科	发明专利	2012 年 1 月 17 日起 20 年	受让取得
3	ZL201210012960.0	一种 P5000 刻蚀机中阴极内衬的修复工艺	先锋精科	发明专利	2012 年 1 月 17 日起 20 年	受让取得
4	ZL201210013007.8	一种 LED 刻蚀机托盘的加工工艺	先锋精科	发明专利	2012 年 1 月 17 日起 20 年	受让取得
5	ZL201210013008.2	一种用于半导体介质刻蚀机的气体分配加热器的制作方法	先锋精科	发明专利	2012 年 1 月 17 日起 20 年	受让取得
6	ZL201310072046.X	一种引脚基座的加工工艺	先锋精科	发明专利	2013 年 3 月 6 日起 20 年	原始取得
7	ZL201310636876.0	铝及其合金的表面导电氧化处理工艺	先锋精科	发明专利	2013 年 12 月 3 日起 20 年	原始取得
8	ZL201310637094.9	一种具有双温控制功能的加热器的加工方法	先锋精科	发明专利	2013 年 12 月 3 日起 20 年	原始取得
9	ZL201310637095.3	一种用于半导体介质刻蚀机的盖板结构	先锋精科	发明专利	2013 年 12 月 3 日起 20 年	原始取得
10	ZL201310638126.7	一种带氧化钽涂层的高耐腐蚀性气体分配器的生产工艺	先锋精科	发明专利	2013 年 12 月 3 日起 20 年	原始取得
11	ZL201410666275.9	一种刻蚀机内部的水冷卡盘结构	先锋精科	发明专利	2014 年 11 月 20 日起 20 年	原始取得
12	ZL201510132394.0	镶入式梅花型电极结构	先锋精科	发明专利	2015 年 3 月 25 日起 20 年	原始取得
13	ZL201510558433.3	一种等离子体反应腔室用带磁铁环的直冷阴极	先锋精科	发明专利	2015 年 9 月 6 日起 20 年	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
		衬套			年	
14	ZL201510748681.4	一种孔内壁研磨抛光夹具	先锋精科	发明专利	2015年11月7日起20年	原始取得
15	ZL201810799732.X	一种带磁铁环的直冷阴极衬套的焊接工艺	先锋精科	发明专利	2018年7月20日起20年	原始取得
16	ZL201811195847.4	一种刻蚀机腔体的内腔真空烘烤除气热板	先锋精科	发明专利	2018年10月15日起20年	原始取得
17	ZL201910331548.7	一种多盲孔、深孔铝制零件阳极氧化设备	先锋精科	发明专利	2019年4月24日起20年	原始取得
18	ZL201910941551.0	一种等离子体CVD晶圆加热器用表面修磨装置	先锋精科	发明专利	2019年9月30日起20年	原始取得
19	ZL201911278469.0	一种降低晶圆离子污染的高均匀性晶圆加热器	先锋精科	发明专利	2019年12月13日起20年	原始取得
20	ZL202010154358.5	一种等离子刻蚀机用全封闭式云母加热基座	先锋精科	发明专利	2020年3月7日起20年	原始取得
21	ZL202011062065.0	晶圆传输装置及底座的加工方法	先锋精科	发明专利	2020年9月30日起20年	原始取得
22	ZL202110810658.9	可大幅度调节冷却能力的晶圆加热器	先锋精科	发明专利	2021年7月19日起20年	原始取得
23	ZL202111077955.3	一种微细绝缘式热电偶包装结构及包装工艺	先锋精科	发明专利	2021年9月15日起20年	原始取得
24	ZL202111077961.9	一种多工位不锈钢加热基座表面处理装置及方法	先锋精科	发明专利	2021年9月15日起20年	原始取得
25	ZL202111084289.6	一种用于刻蚀机的具有冷却结构的内衬及其加工方法	先锋精科	发明专利	2021年9月15日起20年	原始取得
26	ZL202111599769.6	一种耐腐蚀性混酸阳极氧化工艺	先锋精科	发明专利	2021年12月24日起20年	原始取得
27	ZL202210853522.0	一种除气预热腔用晶圆预热装置及其制造方法	先锋精科	发明专利	2022年7月9日起20年	原始取得
28	ZL202211211980.0	一种电源接口面板的加工方法	先锋精科	发明专利	2022年9月30日起20年	原始取得
29	ZL202211266222.9	一种多孔零件表面加工方法及焊接式喷淋盘制	先锋精科	发明专利	2022年10月15日起	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
		造方法			20年	
30	ZL202310283885.X	一种铝合金材料高绝缘性阳极氧化工艺	先锋精科	发明专利	2023年3月22日起20年	原始取得
31	ZL202310344288.3	一种半导体设备部件清洗机	先锋精科	发明专利	2023年4月3日起20年	原始取得
32	ZL202310433115.9	一种立式加工机床换刀机构	先锋精科	发明专利	2023年4月21日起20年	原始取得
33	ZL202310673286.9	一种晶圆搬运机械手臂平面度检验工装及检验方法	先锋精科	发明专利	2023年6月8日起20年	原始取得
34	ZL202310725939.3	一种立式加工中心夹具	先锋精科	发明专利	2023年6月19日起20年	原始取得
35	ZL202310952425.1	一种半导体去胶设备的异形密封区域检验工装及检验方法	先锋精科	发明专利	2023年8月1日起20年	原始取得
36	ZL202411009208.X	一种伽马刀传动滑块的表面处理工装及表面处理方法	先锋精科	发明专利	2024年7月26日起20年	原始取得
37	ZL202411978667.9	一种半导体薄壁不锈钢腔体焊接工艺	先锋精科	发明专利	2024年12月31日起20年	原始取得
38	ZL202211169708.0	一种用于加热管和热电偶的接线装置及接线工艺	无锡先研;先锋精科	发明专利	2022年9月22日起20年	原始取得
39	ZL202221586593.0	一种可拆卸氦气检漏接头	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年6月14日起10年	原始取得
40	ZL202221808690.X	一种用于加工圆弧类零部件的工装	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年7月13日起10年	原始取得
41	ZL202222043979.3	一种用于调整及固定自由开口零件开口尺寸的工装	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年8月4日起10年	原始取得
42	ZL202222082559.6	一种镀膜气体分配法兰气体分配孔加工装置	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年8月9日起10年	原始取得
43	ZL202222124321.5	一种半导体设备冷凝板进出水口的焊接工装	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年8月12日起10年	原始取得
44	ZL202222533630.8	一种用于加热管和热电偶接线的定位烘干装置	先锋精科;无锡先研	实用新型	2022年9月22日起10年	原始取得
45	ZL201620481667.2	一种可替换定位销结构的托盘	先锋精科	实用新型	2016年5月25日起	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					10年	
46	ZL201620581882.X	一种快速膨胀定位装夹系统	先锋精科	实用新型	2016年6月16日起 10年	原始取得
47	ZL201620611082.8	一种水冷盘钎焊结构	先锋精科	实用新型	2016年6月21日起 10年	原始取得
48	ZL201620611083.2	一种射频金属激光器电极结构	先锋精科	实用新型	2016年6月21日起 10年	原始取得
49	ZL201721321904.X	一种金属加热基座除气设备	先锋精科	实用新型	2017年10月14日起 10年	原始取得
50	ZL201721321905.4	一种半导体生产设备用真空电极	先锋精科	实用新型	2017年10月14日起 10年	原始取得
51	ZL201721604567.5	一种用于钻孔机床的微钻延长装置	先锋精科	实用新型	2017年11月27日起 10年	原始取得
52	ZL201721606236.5	一种半导体处理液用加热装置	先锋精科	实用新型	2017年11月27日起 10年	原始取得
53	ZL201721606246.9	气体分配器孔径检验工装	先锋精科	实用新型	2017年11月27日起 10年	原始取得
54	ZL201821149091.5	等离子体反应腔室用带磁铁环的直冷阴极衬套	先锋精科	实用新型	2018年7月20日起 10年	原始取得
55	ZL201821665636.8	一种刻蚀机腔体的内腔真空烘烤除气热板	先锋精科	实用新型	2018年10月15日起 10年	原始取得
56	ZL201821666184.5	一种匀气冷却装置用内部水路检测机构	先锋精科	实用新型	2018年10月15日起 10年	原始取得
57	ZL201921655188.8	一种等离子体CVD晶圆加热器用表面修磨装置	先锋精科	实用新型	2019年9月30日起 10年	原始取得
58	ZL201922228713.4	一种达芬奇测试插座用插销顶板结构	先锋精科	实用新型	2019年12月13日起 10年	原始取得
59	ZL201922228724.2	一种晶圆加热器表面温度分布检测装置	先锋精科	实用新型	2019年12月13日起 10年	原始取得
60	ZL201922229131.8	降低晶圆离子污染的高均匀性晶圆加热器	先锋精科	实用新型	2019年12月13日起 10年	原始取得
61	ZL201922229133.7	一种达芬奇测试插座的插销底板结构	先锋精科	实用新型	2019年12月13日起	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					10年	
62	ZL202020270294.0	一种等离子刻蚀机用全封闭式云母加热基座	先锋精科	实用新型	2020年3月7日起10年	原始取得
63	ZL202022178448.6	用于冷却板上通水柱的防变形焊接工装	先锋精科	实用新型	2020年9月29日起10年	原始取得
64	ZL202022178449.0	刻蚀机核心部件流转箱	先锋精科	实用新型	2020年9月29日起10年	原始取得
65	ZL202022178450.3	便于安装和调整角度的角度头工装	先锋精科	实用新型	2020年9月29日起10年	原始取得
66	ZL202022199576.9	刻蚀机反应腔顶盖的冷却管成型工装	先锋精科	实用新型	2020年9月30日起10年	原始取得
67	ZL202022199614.0	PECVD 晶圆加热用保护装置	先锋精科	实用新型	2020年9月30日起10年	原始取得
68	ZL202022199637.1	MOCVD 装置输运管检漏用连接机构	先锋精科	实用新型	2020年9月30日起10年	原始取得
69	ZL202022199641.8	具有高温加热功能的晶圆传输装置	先锋精科	实用新型	2020年9月30日起10年	原始取得
70	ZL202121630282.5	一种可大幅度调节冷却能力的晶圆加热器	先锋精科	实用新型	2021年7月19日起10年	原始取得
71	ZL202122171500.X	一种气体分配器平面度检验工装及组合检验工装	先锋精科	实用新型	2021年9月9日起10年	原始取得
72	ZL202122193745.2	一种用于真空环境的小直径加热装置	先锋精科	实用新型	2021年9月9日起10年	原始取得
73	ZL202122665845.0	一种用于晶圆升降的支撑装置的装配工装	先锋精科	实用新型	2021年11月1日起10年	原始取得
74	ZL202122676524.0	一种用于 MOCVD 的加热盘保护装置	先锋精科	实用新型	2021年11月1日起10年	原始取得
75	ZL202122830853.6	一种用于 MOCVD 系统的水冷盘翻转工装结构	先锋精科	实用新型	2021年11月11日起10年	原始取得
76	ZL202122771551.6	一种用于刻蚀机气体分配器清洗装置	先锋精科	实用新型	2021年11月12日起10年	原始取得
77	ZL202122773586.3	一种新型检测工件偏心工装	先锋精科	实用新型	2021年11月13日起	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					10年	
78	ZL202122801461.7	一种高效半自动刷镍机	先锋精科	实用新型	2021年11月13日起10年	原始取得
79	ZL202122830892.6	一种用于半导体设备的加热器	先锋精科	实用新型	2021年11月13日起10年	原始取得
80	ZL202122907583.4	一种双轴水平变位机	先锋精科	实用新型	2021年11月20日起10年	原始取得
81	ZL202123009518.6	一种晶圆加热器平面度检测工装	先锋精科	实用新型	2021年12月1日起10年	原始取得
82	ZL202222474374.X	一种不锈钢电解管磨粒流工装	先锋精科	实用新型	2022年9月19日起10年	原始取得
83	ZL202222623497.5	一种用于刻蚀机反应腔内衬的燕尾刀及连接器	先锋精科	实用新型	2022年9月30日起10年	原始取得
84	ZL202223384733.9	一种储存腔体焊接夹紧装置	先锋精科	实用新型	2022年12月16日起10年	原始取得
85	ZL202223409633.7	一种高效储存腔体焊接变位机	先锋精科	实用新型	2022年12月16日起10年	原始取得
86	ZL202320319676.1	一种具有冷却结构的静电卡盘	先锋精科	实用新型	2023年2月27日起10年	原始取得
87	ZL202320321771.5	一种用于MOCVD水冷盘循环清洗工装结构	先锋精科	实用新型	2023年2月27日起10年	原始取得
88	ZL202320934655.0	一种基于零件侧面圆弧面手动打孔工装	先锋精科	实用新型	2023年4月24日起10年	原始取得
89	ZL202321358220.2	一种加工方形类零件的侧压工装	先锋精科	实用新型	2023年5月31日起10年	原始取得
90	ZL202321360440.9	一种用于刻蚀机气体保护机构的检验工装	先锋精科	实用新型	2023年5月31日起10年	原始取得
91	ZL202321402987.0	一种实现异形零件压铆及局部校形的工装及工装组件	先锋精科	实用新型	2023年6月5日起10年	原始取得
92	ZL202321447943.X	一种实现紧固销快速安装到位的工装	先锋精科	实用新型	2023年6月8日起10年	原始取得
93	ZL202321479024.0	一种新型三针装配体流转保护性工装	先锋精科	实用新型	2023年6月12日起	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					10年	
94	ZL202321479566.8	一种用于焊接大型圆形零件的工装	先锋精科	实用新型	2023年6月12日起10年	原始取得
95	ZL202321514976.1	一种伽玛刀驱动轴承座检验工装及工装组件	先锋精科	实用新型	2023年6月14日起10年	原始取得
96	ZL202321523618.7	一种应用在阳极氧化产品上的光孔挂装工装	先锋精科	实用新型	2023年6月15日起10年	原始取得
97	ZL202321695643.3	一种用于半导体设备孔内嵌密封槽的铣削组件	先锋精科	实用新型	2023年6月30日起10年	原始取得
98	ZL202322597035.5	一种用于加工伽马刀滑块的铰刀	先锋精科	实用新型	2023年9月25日起10年	原始取得
99	ZL202420920446.5	一种断裂真空螺栓	先锋精科	实用新型	2024年4月29日起10年	原始取得
100	ZL202421699702.9	一种卧式加工中心用排屑机	先锋精科	实用新型	2024年7月18日起10年	原始取得
101	ZL202421711803.3	一种改进型加工中心侧孔加工装置	先锋精科	实用新型	2024年7月19日起10年	原始取得
102	ZL202421783063.4	一种改良型铝制真空吸盘夹具装置	先锋精科	实用新型	2024年7月26日起10年	原始取得
103	ZL202421783622.1	一种伽马刀传动滑块的表面处理挂装结构	先锋精科	实用新型	2024年7月26日起10年	原始取得
104	ZL202421851215.X	一种用于半导体精密零部件的去毛刺工作台	先锋精科	实用新型	2024年8月1日起10年	原始取得
105	ZL202422068340.X	一种圆柱形零件加工装夹工装	先锋精科	实用新型	2024年8月26日起10年	原始取得
106	ZL202422159436.7	一种高同轴度卧式加工中心轴零件孔加工装置	先锋精科	实用新型	2024年9月4日起10年	原始取得
107	ZL202422159716.8	一种实现 SHD 快速检验孔内残留切削液的工装	先锋精科	实用新型	2024年9月4日起10年	原始取得
108	ZL202422160146.4	一种用于研磨密封面的打磨工具	先锋精科	实用新型	2024年9月4日起10年	原始取得
109	ZL202422170659.3	一种卡套接头防弹出工装	先锋精科	实用新型	2024年9月5日起10年	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					年	
110	ZL202422194951.9	一种新型阳极氧化夹具	先锋精科	实用新型	2024年9月9日起10年	原始取得
111	ZL202422195621.1	一种用于 SHD 类零件的负压清洗装置	先锋精科	实用新型	2024年9月9日起10年	原始取得
112	ZL202422196420.3	一种用于光伏气体分配法兰焊接槽内铁屑的清洗装置	先锋精科	实用新型	2024年9月9日起10年	原始取得
113	ZL202422197011.5	一种法兰点焊盖板工装	先锋精科	实用新型	2024年9月9日起10年	原始取得
114	ZL202422209680.X	电动螺丝刀适配快速内螺纹检测装置	先锋精科	实用新型	2024年9月10日起10年	原始取得
115	ZL202422211232.3	一种本色阳极氧化非表处零件防护工装	先锋精科	实用新型	2024年9月10日起10年	原始取得
116	ZL202422213044.4	一种焊接弯管定位工装	先锋精科	实用新型	2024年9月10日起10年	原始取得
117	ZL202422213189.4	一种用于各类凝固胶的搅拌棒	先锋精科	实用新型	2024年9月10日起10年	原始取得
118	ZL202422231348.3	一种针对锥孔特征 CNC 加工的专用刀具	先锋精科	实用新型	2024年9月12日起10年	原始取得
119	ZL202422259356.9	一种实现便捷观察零件孔内情况的工装	先锋精科	实用新型	2024年9月14日起10年	原始取得
120	ZL202322778779.7	一种机械式焊接升降平台	无锡先研	实用新型	2023年10月17日起10年	原始取得
121	ZL202322804034.3	一种狭窄区域上螺丝扭力的扳手装置	无锡先研	实用新型	2023年10月19日起10年	原始取得
122	ZL202322868801.7	一种驱动座的开放孔抛光工装	无锡先研	实用新型	2023年10月25日起10年	原始取得
123	ZL202323034886.5	一种加工驱动座的导向型刀具	无锡先研	实用新型	2023年11月10日起10年	原始取得
124	ZL202420256377.2	一种手动拆卸工装	无锡先研	实用新型	2024年2月2日起10年	原始取得
125	ZL202420436017.0	一种半导体腔体盖板升降机构	无锡先研	实用新型	2024年3月7日起10年	原始取得

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类别	有效期	取得方式
					年	
126	ZL202422214225.9	一种测算正压压降测试工装	无锡先研	实用新型	2024年9月10日起 10年	原始取得
127	ZL202422220792.5	一种水气两用高压冲洗深孔接头	无锡先研	实用新型	2024年9月11日起 10年	原始取得
128	ZL202422219887.5	一种带导向柱刮较刀	无锡先研	实用新型	2024年9月11日起 10年	原始取得
129	ZL202423242214.8	一种自限位手动旋转工作台	无锡先研	实用新型	2024年12月27日起 10年	原始取得

注：上述 2-5 项专利系由发行人实际控制人游利转让予发行人，具体情况为：2018 年 3 月 16 日，游利与发行人签订《专利转让协议书》，将上述第 2 项专利权无偿转让予发行人；2020 年 11 月 12 日，游利与发行人签订《专利转让协议书》，将上述第 3-5 项专利权无偿转让予发行人。相关专利权转让已进行变更登记。

4、域名

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 4 项域名，具体情况如下：

序号	域名	域名持有者	域名到期日	网站备案/许可证号
1	sprint-tech.com	先锋精科	2027.9.3	苏 ICP 备 2020064806 号-1
2	spt-semi.com	先锋精科	2027.9.21	国际域名，无需备案
3	sprint-aero.com	靖江先捷	2030.4.23	未接入互联网使用，未备案
4	sprint-nmat.com	无锡先研	2026.11.08	未接入互联网使用，未备案

十一、最近三年的重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组。

十二、境外经营情况和境外资产情况

公司的境外经营主体详细情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司直接或间接控股公司情况”。

十三、报告期内的分红情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关

法规对于利润分配政策的规定以及《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

2、利润分配方式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司具备现金分红条件的，应当优先以现金方式进行股利分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的期限间隔

公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件时，原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红。

4、现金分红的具体条件

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，且经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

满足公司章程规定的现金分红的条件下，且公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，则公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%；重大投资计划或重大资金支出是指公司在一年内拟购买资产以及对外投资等交易涉及的累计支出超过最近一期经审计净资产的 10%或者资产总额的 5%。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、发放股票股利的具体条件和比例

如果有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足公司章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配；采用股票股利分配方式的将结合公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

6、公司利润分配的决策机制和程序

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划制定，董事会对利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。

(2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

(3) 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。

公司董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。

(4) 利润分配预案经审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股

股东会审议。股东会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

(5) 公司年度盈利且可供分配利润为正数但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途。

7、利润分配政策调整的决策机制与程序

(1) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(2) 公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况进行一次评估，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，决定是否对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

(3) 公司董事会在审议调整利润分配政策时，必须经全体董事的过半数表决同意通过。审计委员会在审议利润分配政策调整时，须经全体审计委员会成员过半数表决同意通过。

(4) 利润分配政策调整应当分别经董事会和审计委员会审议通过后方能提交股东会审议。审议通过后方能提交股东会审议。股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意。公司股东会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。

(二) 本次发行前后公司利润分配政策变化情况

本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（三）最近三年利润分配情况

最近三年内，公司利润分配情况详见“重大事项提示”之“六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”之“（三）最近三年利润分配情况”。

（四）公司最近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常的生产经营，以支持公司未来战略规划和可持续性发展。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

十四、最近三年已公开发行人公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形

最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至 2025 年 12 月末，公司不存在任何形式的公司债券。

十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 7,978.54 万元、21,373.27 万元和 18,608.72 万元，平均可分配利润为 15,986.84 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 75,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

第五节 财务会计信息与管理层分析

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、审计意见

发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告已经立信会计师审计，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZA13463 号、信会师报字[2025]第 ZA11991 号、信会师报字[2026]第 ZA10917 号标准无保留意见审计报告。除特别说明以外，本节分析的内容以公司经审计的三年年度合并财务报表为基础。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动资产：			
货币资金	662,276,542.21	750,584,577.01	281,920,429.24
应收票据	54,070,149.84	30,749,830.38	3,346,573.55
应收账款	424,129,647.76	385,962,055.51	226,165,788.66
应收款项融资	31,551,503.20	70,742,812.08	25,741,632.78
预付款项	5,239,368.79	3,491,645.92	1,970,892.40
其他应收款	1,441,117.22	1,260,077.07	1,159,612.22
存货	305,543,868.74	266,376,338.39	176,642,236.66
其他流动资产	21,931,105.82	10,853,195.37	9,084,905.85

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动资产合计	1,506,183,303.58	1,520,020,531.73	726,032,071.36
非流动资产：			
固定资产	435,554,014.98	303,913,787.70	252,962,342.57
在建工程	145,236,217.66	61,492,399.29	15,400,570.08
使用权资产	3,703,227.83	7,595,213.70	3,724,784.77
无形资产	37,100,580.06	36,459,186.72	37,251,379.79
商誉	8,008,153.75	-	-
长期待摊费用	11,127,072.91	10,997,160.26	8,996,651.39
递延所得税资产	15,258,126.91	11,941,227.86	11,169,608.79
其他非流动资产	16,419,794.50	25,114,884.06	15,008,784.71
非流动资产合计	672,407,188.60	457,513,859.59	344,514,122.10
资产总计	2,178,590,492.18	1,977,534,391.32	1,070,546,193.46
流动负债：			
短期借款	39,023,750.00	39,026,833.33	30,026,250.00
应付票据	-	-	40,000,000.00
应付账款	341,632,788.11	354,756,239.66	203,739,462.56
合同负债	419,867.80	325,383.98	169,924.32
应付职工薪酬	17,517,934.70	24,334,984.52	9,639,656.18
应交税费	19,149,625.87	6,100,618.68	6,383,022.78
其他应付款	1,151,118.39	6,713,149.80	156,273.63
一年内到期的非流动负债	2,920,951.30	4,069,185.17	1,324,379.98
其他流动负债	21,663,231.16	29,813,503.12	1,422,090.16
流动负债合计	443,479,267.33	465,139,898.26	292,861,059.61
非流动负债：			
长期借款	67,752,123.37	-	-
租赁负债	677,733.95	3,767,688.58	2,552,776.70
递延收益	23,383,951.56	26,168,852.50	29,498,069.05
递延所得税负债	29,448.29	-	2,041,177.68
非流动负债合计	91,843,257.17	29,936,541.08	34,092,023.43
负债合计	535,322,524.50	495,076,439.34	326,953,083.04
所有者权益：			
股本	202,379,856.00	202,379,856.00	151,784,856.00
资本公积	953,668,384.14	941,278,166.14	466,954,511.22

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
盈余公积	53,926,387.65	36,077,730.24	14,760,000.89
未分配利润	433,293,339.89	302,722,199.60	110,093,742.31
归属于母公司所有者权益合计	1,643,267,967.68	1,482,457,951.98	743,593,110.42
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	1,643,267,967.68	1,482,457,951.98	743,593,110.42
负债和所有者权益总计	2,178,590,492.18	1,977,534,391.32	1,070,546,193.46

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,237,727,647.77	1,135,774,130.09	557,716,937.80
其中：营业收入	1,237,727,647.77	1,135,774,130.09	557,716,937.80
二、营业总成本	1,016,747,770.46	877,110,331.03	468,778,712.46
其中：营业成本	878,480,076.79	751,522,526.11	390,768,507.94
税金及附加	8,313,170.40	7,198,594.70	4,582,012.79
销售费用	5,796,747.90	6,641,727.47	5,019,640.01
管理费用	53,950,426.69	48,716,325.93	36,297,852.44
研发费用	71,377,055.49	64,083,194.59	36,308,998.87
财务费用	-1,169,706.81	-1,052,037.77	-4,198,299.59
其中：利息费用	3,501,874.52	2,184,085.50	1,700,251.65
利息收入	5,789,940.53	1,757,146.28	2,274,949.91
加：其他收益	10,118,653.40	8,998,415.73	6,802,626.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,858,580.29	-9,653,787.88	-4,126,267.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,983,872.43	-9,450,486.06	-1,565,000.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	200,371.34	-385,569.33	10,205.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	217,456,449.33	248,172,371.52	90,059,789.25
加：营业外收入	588.08	5,000.00	-
减：营业外支出	32,214.09	350,932.23	628,633.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	217,424,823.32	247,826,439.29	89,431,155.44
减：所得税费用	28,529,054.42	33,880,252.65	9,156,201.75

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
2.少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,895,768.90	213,946,186.64	80,274,953.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.93	1.38	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	0.93	1.38	0.53

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	911,862,437.05	804,532,272.01	474,435,612.65
收到的税费返还	2,490,857.90	1,439,111.54	639,275.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,109,011.29	54,034,828.71	72,432,786.43
经营活动现金流入小计	923,462,306.24	860,006,212.26	547,507,674.66
购买商品、接受劳务支付的现金	346,743,336.69	421,310,057.81	200,022,489.05
支付给职工以及为职工支付的现金	246,442,677.61	173,369,307.70	101,111,925.16
支付的各项税费	69,932,227.18	79,942,542.48	23,386,965.08
支付其他与经营活动有关的现金	63,405,742.94	80,541,558.44	86,912,322.14
经营活动现金流出小计	726,523,984.42	755,163,466.43	411,433,701.43

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	196,938,321.82	104,842,745.83	136,073,973.23
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,000.00	1,562,600.00	139,398.06
收到其他与投资活动有关的现金	16,400,000.00	16,400,000.00	5,600,000.00
投资活动现金流入小计	17,576,000.00	17,962,600.00	5,739,398.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,871,753.48	132,971,515.13	91,478,007.16
投资支付的现金	-	-	10.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,237,418.89	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,400,000.00	16,400,000.00	5,600,000.00
投资活动现金流出小计	304,509,172.37	149,371,515.13	97,078,017.21
投资活动产生的现金流量净额	-286,933,172.37	-131,408,915.13	-91,338,619.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	536,944,497.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	106,752,123.37	39,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	411,579.28	291,050.00	-
筹资活动现金流入小计	107,163,702.65	576,235,547.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,950,000.00	30,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,594,533.45	1,882,503.65	1,511,257.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,175,993.84	20,390,072.82	2,374,428.97
筹资活动现金流出小计	104,720,527.29	52,272,576.47	52,885,686.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,443,175.36	523,962,970.53	-17,885,686.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-756,359.62	1,267,346.54	4,260,750.53
五、现金及现金等价物净增加额	-88,308,034.80	498,664,147.77	31,110,418.30
加：期初现金及现金等价物余额	750,584,577.01	251,920,429.24	220,810,010.94
六、期末现金及现金等价物余额	662,276,542.21	750,584,577.01	251,920,429.24

三、发行人合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

发行人财务报表以持续经营假设为编制基础，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）合并财务报表范围

截至2025年12月31日，发行人财务报表合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	层级	注册资本	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1	靖江先捷	一级	10,000.00 万元	100.00	-	设立
2	无锡先研	一级	11,000.00 万元	100.00	-	设立
3	先锋精密（新加坡）	一级	3 万新加坡元	100.00	-	设立
4	无锡至辰	二级	600.00 万元	-	100.00	收购

（三）报告期合并财务报表范围的变化

报告期内，公司合并报表范围变动情况如下：

1、非同一控制下企业合并

单位：%

被购买方名称	购买日	股权取得比例	股权取得方式
无锡至辰	2025 年 3 月	100.00	收购

2、注销孙公司

单位：%

子/孙公司名称	注销时间	持股比例
ULYC（新加坡）	2023 年 4 月	100.00

四、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	3.40	3.27	2.48
速动比率（倍）	2.71	2.70	1.88
资产负债率（母公司）（%）	19.14	21.71	28.14
资产负债率（合并口径）（%）	24.57	25.04	30.54
主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	2.89	3.51	2.86
存货周转率（次）	2.81	3.08	2.01
每股经营活动现金流量（元/股）	0.97	0.52	0.90
每股净现金流量（元）	-0.44	2.46	0.20
研发投入占营业收入的比例（%）	5.77	5.64	6.51

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	12.15	0.93	0.93
	2024 年度	24.97	1.38	1.38
	2023 年度	11.55	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	11.97	0.92	0.92
	2024 年度	24.94	1.38	1.38
	2023 年度	11.48	0.53	0.53

（三）非经常性损益明细表

公司按照中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》编制了最近三年的非经常性损益表，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	19.53	-61.57	-40.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	313.27	99.69	123.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.65	-11.58	-21.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	330.15	26.54	61.33
减：所得税影响额	49.29	5.20	12.37
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	280.86	21.35	48.96

五、会计政策变更和会计估计变更

（一）会计政策变更情况

1、财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规

定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并

一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更情况

发行人报告期内无重要会计估计变更情况。

（三）会计差错更正情况

发行人报告期内无会计差错更正情况。

六、财务状况分析

（一）资产分析

报告期各期末，发行人资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	150,618.33	69.14	152,002.05	76.86	72,603.21	67.82
非流动资产	67,240.72	30.86	45,751.39	23.14	34,451.41	32.18
合计	217,859.05	100.00	197,753.44	100.00	107,054.62	100.00

报告期各期末，发行人资产总额分别为 107,054.62 万元、197,753.44 万元和 217,859.05 万元。随着业务规模的扩大，发行人资产规模整体呈增长态势。

资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，整体资产流动性良好。2024 年末，公司资产总额较年初增加 90,698.82 万元，流动资产占比上升，主要原因系当期期末公司收到首次公开发行募集资金；2025 年末资产总额较年初增加 20,105.61 万元，主要系当年未分配利润、盈余公积等留存收益增加，同时长期借款增加所致。

1、流动资产分析

报告期各期末，发行人流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	66,227.65	43.97	75,058.46	49.38	28,192.04	38.83
应收票据	5,407.01	3.59	3,074.98	2.02	334.66	0.46
应收账款	42,412.96	28.16	38,596.21	25.39	22,616.58	31.15
应收款项融资	3,155.15	2.09	7,074.28	4.65	2,574.16	3.55
预付款项	523.94	0.35	349.16	0.23	197.09	0.27
其他应收款	144.11	0.10	126.01	0.08	115.96	0.16
存货	30,554.39	20.29	26,637.63	17.52	17,664.22	24.33
其他流动资产	2,193.11	1.46	1,085.32	0.71	908.49	1.25
流动资产合计	150,618.33	100.00	152,002.05	100.00	72,603.21	100.00

报告期各期末，公司流动资产账面金额分别为 72,603.21 万元、152,002.05 万元和 150,618.33 万元，占各期末总资产比例分别为 67.82%、76.86%和 69.14%，整体资产流动性良好。

发行人流动资产主要由货币资金、应收票据与应收款项融资、应收账款、存货等构成，具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，发行人货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	3.46	0.01	3.68	0.00	0.72	0.00
银行存款	66,224.19	99.99	75,054.77	100.00	25,191.33	89.36
其他货币资金	-	-	-	-	3,000.00	10.64
合计	66,227.65	100.00	75,058.46	100.00	28,192.04	100.00
其中：存放在境外的款项总额	1,079.27	1.63	1,052.74	1.40	1,064.09	3.77

报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 28,192.04 万元、75,058.46 万元和 66,227.65 万元，占流动资产比例分别为 38.83%、49.38%和 43.97%。报

报告期各期末，发行人货币资金主要为银行存款，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。2024 年末，发行人货币资金较 2023 年末增加较多，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。随着募集资金有序投入使用，2025 年末，发行人货币资金余额有所下降。

(2) 应收票据与应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资均由银行承兑汇票构成，具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	5,407.01	63.15	3,074.98	30.30	334.66	11.50
应收款项融资	3,155.15	36.85	7,074.28	69.70	2,574.16	88.50
合计	8,562.17	100.00	10,149.26	100.00	2,908.82	100.00

报告期各期末，发行人应收票据账面金额分别为 334.66 万元、3,074.98 万元和 5,407.01 万元，占流动资产的比例分别为 0.46%、2.02%和 3.59%，应收款项融资账面金额分别为 2,574.16 万元、7,074.28 万元和 3,155.15 万元，占流动资产的比例分别为 3.55%、4.65%和 2.09%。2024 年度，受益于下游半导体行业景气周期，发行人营业收入大幅增长，当期客户支付的票据规模相应增加，期末银行承兑汇票、已背书转让且未到期的应收票据余额上涨。

(3) 应收账款

①应收账款变动情况

报告期各期末，发行人应收账款情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款余额	44,810.52	40,796.20	23,868.59
坏账准备	2,397.55	2,200.00	1,252.01
应收账款账面价值	42,412.96	38,596.21	22,616.58
营业收入	123,772.76	113,577.41	55,771.69
应收账款账面价值占营业收入的比例	34.27	33.98	40.55

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 22,616.58 万元、38,596.21

万元和 42,412.96 万元，占流动资产的比例分别为 31.15%、25.39%和 28.16%，占当期营业收入的比例分别为 40.55%、33.98%和 34.27%。报告期内，发行人期末应收账款账面价值与当期营业收入基本匹配。

②应收账款账龄情况

报告期各期末，发行人应收账款账龄情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	44,219.49	98.68	39,918.14	97.85	23,558.75	98.70
1-2 年	236.39	0.53	782.90	1.92	229.06	0.96
2-3 年	295.76	0.66	29.57	0.07	60.65	0.25
3-4 年	1.41	0.00	46.12	0.11	20.13	0.08
4-5 年	37.99	0.08	19.47	0.05	-	-
5 年以上	19.47	0.04	-	-	-	-
合计	44,810.52	100.00	40,796.20	100.00	23,868.59	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄绝大多数为 1 年以内，应收账款质量较好。

③坏账准备计提情况

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提情况具体如下：

单位：万元、%

项目		2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
单项计提坏账准备的应收账款	应收账款余额	-	-	-
	坏账准备余额	-	-	-
	计提比例	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	应收账款余额	44,810.52	40,796.20	23,868.59
	坏账准备余额	2,397.55	2,200.00	1,252.01
	计提比例	5.35	5.39	5.25
合计	应收账款余额	44,810.52	40,796.20	23,868.59
	坏账准备余额	2,397.55	2,200.00	1,252.01
	计提比例	5.35	5.39	5.25

报告期各期末，公司无单项计提坏账准备的应收账款，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款均为账龄组合。

④应收账款余额前五大客户情况

报告期各期末，发行人应收账款余额前五大客户情况如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	关系	应收账款余额	余额占比
2025.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	16,377.88	36.55
2	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	4,931.26	11.00
3	成都超纯应用材料股份有限公司	非关联方	4,102.87	9.16
4	北京中硅泰克精密技术有限公司	非关联方	2,909.71	6.49
5	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	2,125.71	4.74
合计			30,447.42	67.95
2024.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	15,910.49	39.00
2	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	5,031.63	12.33
3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	非关联方	2,911.90	7.14
4	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	2,501.86	6.13
5	北京中硅泰克精密技术有限公司	非关联方	1,767.45	4.33
合计			28,123.33	68.93
2023.12.31				
1	北京北方华创微电子装备有限公司	非关联方	6,650.49	27.86
2	江苏微导纳米科技股份有限公司	非关联方	2,530.67	10.60
3	中微半导体（上海）有限公司	非关联方	2,048.55	8.58
4	拓荆科技（上海）有限公司	非关联方	1,520.92	6.37
5	北京屹唐半导体科技股份有限公司	非关联方	957.10	4.01
合计			13,707.72	57.42

报告期各期末，发行人应收账款前五名客户与当期主要客户基本一致。

(4) 存货

报告期各期末，发行人存货构成情况如下：

单位：万元、%

日期	项目	账面余额		跌价准备	账面价值
		金额	占比		
2025.12.31	原材料	2,786.56	8.31	475.02	2,311.54

日期	项目	账面余额		跌价准备	账面价值
		金额	占比		
	委托加工物资	2,844.15	8.48	182.77	2,661.38
	在制品	17,672.08	52.72	1,462.96	16,209.12
	库存商品	8,129.83	24.25	674.33	7,455.51
	发出商品	2,087.80	6.23	170.96	1,916.84
	合计	33,520.42	100.00	2,966.03	30,554.39
	2024.12.31	原材料	2,458.25	8.47	282.60
	委托加工物资	2,968.95	10.22	231.87	2,737.08
	在制品	13,909.95	47.90	1,137.31	12,772.64
	库存商品	6,913.36	23.81	568.77	6,344.59
	发出商品	2,787.57	9.60	179.89	2,607.68
	合计	29,038.07	100.00	2,400.44	26,637.63
2023.12.31	原材料	1,890.31	9.57	310.96	1,579.36
	委托加工物资	2,205.19	11.16	220.45	1,984.74
	在制品	9,214.05	46.65	878.37	8,335.68
	库存商品	3,824.12	19.36	495.91	3,328.21
	发出商品	2,619.70	13.26	183.47	2,436.23
	合计	19,753.38	100.00	2,089.15	17,664.22

报告期各期末，发行人存货余额分别为 19,753.38 万元、29,038.07 万元和 33,520.42 万元，账面价值分别为 17,664.22 万元、26,637.63 万元和 30,554.39 万元，占流动资产的比例分别为 24.33%、17.52%和 20.29%。发行人存货主要由在制品、库存商品、发出商品、委托加工物资、原材料等构成，各期末存货结构整体较为稳定。2024 年末，发行人存货余额大幅上升，主要原因系当期发行人收入显著增长，为保障订单及时交付，公司相应增加备货。

2、非流动资产分析

报告期各期末，发行人非流动资产构成具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	43,555.40	64.78	30,391.38	66.43	25,296.23	73.43
在建工程	14,523.62	21.60	6,149.24	13.44	1,540.06	4.47

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
使用权资产	370.32	0.55	759.52	1.66	372.48	1.08
无形资产	3,710.06	5.52	3,645.92	7.97	3,725.14	10.81
商誉	800.82	1.19	-	-	-	-
长期待摊费用	1,112.71	1.65	1,099.72	2.40	899.67	2.61
递延所得税资产	1,525.81	2.27	1,194.12	2.61	1,116.96	3.24
其他非流动资产	1,641.98	2.44	2,511.49	5.49	1,500.88	4.36
非流动资产合计	67,240.72	100.00	45,751.39	100.00	34,451.41	100.00

报告期各期末，发行人非流动资产分别为 34,451.41 万元、45,751.39 万元和 67,240.72 万元，随公司生产经营规模的扩大而逐年增加，占资产总额比例分别为 32.18%、23.14%和 30.86%。发行人的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，报告期各期末，三项资产合计金额分别为 30,561.43 万元、40,186.54 万元和 61,789.08 万元，占非流动资产的比例分别为 88.71%、87.84%和 91.89%。

2025 年 3 月，公司收购无锡至辰，形成商誉 800.82 万元，截至报告期末，相关资产组经营状况良好，商誉不存在减值迹象。

（1）固定资产

报告期各期末，发行人固定资产情况如下所示：

单位：万元、%

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	账面价值占比
2025.12.31					
房屋及建筑物	17,056.30	2,005.41	-	15,050.89	34.56
机器设备	31,523.36	9,186.27	-	22,337.09	51.28
运输设备	489.16	324.95	-	164.21	0.38
电子设备	827.58	426.76	-	400.82	0.92
其他设备	9,781.96	4,179.57	-	5,602.39	12.86
合计	59,678.37	16,122.97	-	43,555.40	100.00
2024.12.31					
房屋及建筑物	9,355.06	1,417.95	-	7,937.11	26.12
机器设备	23,598.22	6,503.32	-	17,094.90	56.25

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	账面价值占比
运输设备	400.05	234.60	-	165.45	0.54
电子设备	540.48	279.67	-	260.80	0.86
其他设备	8,004.84	3,071.73	-	4,933.10	16.23
合计	41,898.65	11,507.27	-	30,391.38	100.00
2023.12.31					
房屋及建筑物	9,094.59	980.73	-	8,113.87	32.08
机器设备	17,672.19	4,986.73	-	12,685.46	50.15
运输设备	291.97	173.20	-	118.77	0.47
电子设备	286.21	207.88	-	78.34	0.31
其他设备	6,434.38	2,134.59	-	4,299.79	17.00
合计	33,779.36	8,483.12	-	25,296.23	100.00

报告期各期末，发行人固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备。报告期内，发行人固定资产原值持续增长，主要原因系：1）报告期内，为满足更高制程对半导体零部件日益严格的质量要求，发行人新建多间高标准洁净车间、购置大量机器设备；2）发行人首发募投项目等工程项目有序建设，随着厂房陆续完工转固，房屋及建筑物原值相应增加。

整体来看，发行人固定资产运行良好，能够按照预定用途发挥经济效益，不存在需要计提减值准备的情形。

（2）在建工程

报告期各期末，发行人在建工程构成如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
无锡先研设备模组生产与装配基地项目	7,701.33	-	-
机器设备及车间改造	5,479.68	2,223.77	1,540.06
新港高新园区二期厂房	1,107.56	3,925.47	-
江苏先锋精密科技股份有限公司6#、7#厂房建设项目	235.06	-	-
合计	14,523.62	6,149.24	1,540.06

报告期各期末，发行人在建工程金额分别为 1,540.06 万元、6,149.24 万元和 14,523.62 万元，逐年上升。

2024年末，公司在建工程账面价值较2023年末增加4,609.18万元，主要原因系发行人新港高新园区二期厂房开工建设。2025年末，公司在建工程账面价值较2024年末增加8,374.38万元，主要原因系：1) 发行人稳步推进募投项目建设，期末无锡先研设备模组生产与装配基地项目金额增加较多；2) 为提升产品工艺能力，发行人当期投入机器设备及车间改造金额较多。

(3) 无形资产

报告期各期末，发行人无形资产构成如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	3,423.99	92.29	3,499.89	95.99	3,575.78	95.99
软件使用权	206.39	5.56	146.03	4.01	149.36	4.01
专利权	8.79	0.24	-	-	-	-
排污权交易费	70.88	1.91	-	-	-	-
合计	3,710.06	100.00	3,645.92	100.00	3,725.14	100.00

报告期各期末，发行人无形资产金额分别为3,725.14万元、3,645.92万元和3,710.06万元，主要为土地使用权、软件使用权。

(二) 负债分析

报告期各期末，发行人负债结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	44,347.93	82.84	46,513.99	93.95	29,286.11	89.57
非流动负债	9,184.33	17.16	2,993.65	6.05	3,409.20	10.43
负债总额	53,532.25	100.00	49,507.64	100.00	32,695.31	100.00

报告期各期末，发行人负债总额分别为32,695.31万元、49,507.64万元和53,532.25万元，流动负债占负债总额的比例分别为89.57%、93.95%和82.84%，为公司负债的主要组成部分。

1、流动负债分析

报告期各期末，发行人的流动负债具体构成及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	3,902.38	8.80	3,902.68	8.39	3,002.63	10.25
应付票据	-	-	-	-	4,000.00	13.66
应付账款	34,163.28	77.03	35,475.62	76.27	20,373.95	69.57
合同负债	41.99	0.09	32.54	0.07	16.99	0.06
应付职工薪酬	1,751.79	3.95	2,433.50	5.23	963.97	3.29
应交税费	1,914.96	4.32	610.06	1.31	638.30	2.18
其他应付款	115.11	0.26	671.31	1.44	15.63	0.05
一年内到期的非流动负债	292.10	0.66	406.92	0.87	132.44	0.45
其他流动负债	2,166.32	4.88	2,981.35	6.41	142.21	0.49
流动负债合计	44,347.93	100.00	46,513.99	100.00	29,286.11	100.00

报告期各期末，发行人流动负债分别为 29,286.11 万元、46,513.99 万元和 44,347.93 万元。2024 年末，发行人流动负债金额较 2023 年末大幅上升，主要原因系：受益于下游半导体行业景气周期，2024 年度发行人产销两旺，采购规模大幅增长，从而期末经营性应付金额较高。

报告期各期末，发行人流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、其他流动负债等构成，具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，发行人短期借款余额分别为 3,002.63 万元、3,902.68 万元和 3,902.38 万元，占发行人流动负债比例分别为 10.25%、8.39%和 8.80%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	3,000.00	3,900.00	3,000.00
信用借款	900.00	-	-
应付利息	2.38	2.68	2.63
合计	3,902.38	3,902.68	3,002.63

报告期各期末，发行人短期借款余额较为稳定。

(2) 应付票据和应付账款

报告期各期末，发行人应付票据和应付账款金额合计分别为 24,373.95 万元、35,475.62 万元和 34,163.28 万元，占流动负债比例分别为 83.23%、76.27% 和 77.03%，是发行人流动负债的主要组成部分，主要为应付供应商材料款和应付工程设备款。报告期内，随着发行人业务规模扩大以及新厂房建设投资增加，材料采购、委外加工、设备购置和工程施工等增多，使得期末应付款项规模整体呈上升趋势。

报告期各期末，发行人应付账款前五大单位如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	金额	占比	款项性质
2025.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	3,701.99	10.84	定制件和外协采购款
2	东贺隆（昆山）电子有限公司	2,810.57	8.23	外协采购款
3	江苏禹翔建设有限公司	2,560.08	7.49	工程款
4	苏州市乐了精密机械制造厂	1,814.96	5.31	定制件和外协采购款
5	无锡元基精密机械有限公司	1,595.12	4.67	定制件和外协采购款
合计		12,482.72	36.54	-
2024.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	4,658.20	13.13	定制件和外协采购款
2	江苏禹翔建设有限公司	3,838.04	10.82	工程款
3	苏州市乐了精密机械制造厂	3,691.02	10.40	定制件和外协采购款
4	东贺隆（昆山）电子有限公司	2,406.55	6.78	外协采购款
5	无锡元基精密机械有限公司	1,620.40	4.57	定制件和外协采购款
合计		16,214.21	45.71	-
2023.12.31				
1	靖江新恒和半导体科技有限公司	2,705.44	13.28	定制件和外协采购款
2	苏州市乐了精密机械制造厂	1,829.84	8.98	定制件和外协采购款
3	无锡元基精密机械有限公司	1,367.92	6.71	定制件和原材料采购款
4	苏州美德航空航天材料有限公司	1,017.21	4.99	原材料采购款
5	江苏广锋建筑工程有限公司	1,007.01	4.94	工程款
合计		7,927.42	38.91	-

(3) 应付职工薪酬

报告期各期末，发行人应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一、短期薪酬	1,749.58	2,433.34	963.64
二、离职后福利—设定提存计划	1.69	0.15	0.33
三、辞退福利	0.52	-	-
合计	1,751.79	2,433.50	963.97

报告期各期末，发行人应付职工薪酬余额分别为 963.97 万元、2,433.50 万元和 1,751.79 万元，占流动负债比例分别为 3.29%、5.23%和 3.95%。应付职工薪酬主要为短期薪酬，由月度工资、季度奖金、年终奖等构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准以及奖金计提相关。2024 年末应付职工薪酬余额较年初增长较多，主要由于公司人员数量随业务规模扩大而增加，且当年末计提奖金增加。

(4) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 142.21 万元、2,981.35 万元和 2,166.32 万元，占流动负债比例分别为 0.49%、6.41%和 4.88%。其他流动负债明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
待转销项税额	12.82	4.23	2.21
票据背书未终止确认的负债	2,153.50	2,977.12	140.00
合计	2,166.32	2,981.35	142.21

公司其他流动负债主要为已背书未到期但不符合终止确认条件的银行承兑汇票。

2、非流动负债分析

报告期各期末，发行人非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	6,775.21	73.77	-	-	-	-

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	67.77	0.74	376.77	12.59	255.28	7.49
递延收益	2,338.40	25.46	2,616.89	87.41	2,949.81	86.52
递延所得税负债	2.94	0.03	-	-	204.12	5.99
合计	9,184.33	100.00	2,993.65	100.00	3,409.20	100.00

报告期各期末，发行人非流动负债金额分别为 3,409.20 万元、2,993.65 万元和 9,184.33 万元，主要由长期借款和递延收益组成。

（1）长期借款

2023 年末、2024 年末，发行人不存在长期借款。2025 年末，为满足靖江先捷项目建设及相关设备投资资金需求，发行人借入抵押借款。

（2）递延收益

发行人递延收益均为与资产相关的政府补助，报告期各期末金额分别为 2,949.81 万元、2,616.89 万元和 2,338.40 万元，占非流动负债的比例分别为 86.52%、87.41%和 25.46%，随着大额政府补助分期确认为其他收益，递延收益余额减少。

（三）偿债能力分析

1、发行人偿债能力指标

报告期内，发行人的主要偿债指标情况如下表所示：

单位：倍、%

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率	3.40	3.27	2.48
速动比率	2.71	2.70	1.88
资产负债率（合并）	24.57	25.04	30.54

报告期各期末，发行人流动比率分别为 2.48、3.27 和 3.40，速动比率分别为 1.88、2.70 和 2.71。报告期内发行人销售情况良好，回款正常，短期偿债能力指标处于正常水平，不存在显著的短期偿债风险。

报告期各期末，发行人资产负债率分别为 30.54%、25.04%和 24.57%，资产负债率处于适中水平。2024 年末资产负债率下降，主要原因系当期公司首发

募集资金到账。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主要偿债指标对比如下：

单位：倍、%

公司简称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率			
富创精密	1.80	2.17	3.43
珂玛科技	2.68	3.04	1.74
托伦斯	1.91	2.61	2.23
可比公司平均值	2.13	2.61	2.47
先锋精科	3.40	3.27	2.48
速动比率			
富创精密	1.34	1.65	2.67
珂玛科技	2.00	2.41	1.28
托伦斯	1.60	2.22	1.78
可比公司平均值	1.65	2.09	1.91
先锋精科	2.71	2.70	1.88
合并资产负债率			
富创精密	47.78	43.77	37.29
珂玛科技	29.75	22.77	45.44
托伦斯	40.70	31.06	37.41
可比公司平均值	39.41	32.53	40.05
先锋精科	24.57	25.04	30.54

注 1：可比公司数据根据可比公司公开披露数据计算

注 2：受限于数据可得性，富创精密、珂玛科技采用 2025 年三季度报数据

整体而言，发行人的流动比率、速动比率高于可比公司，合并资产负债率略低于可比公司，主要与经营理念及上市时间有关。具体而言：1) 发行人致力于建设持续稳定的精益生产管理体系，经营较为稳健，举债较为谨慎；2) 2023 年末，公司流动比率、速动比率低于富创精密，主要原因系富创精密于 2022 年上市，首发募集资金到账后短期借款金额大幅降低；3) 2024 年，公司流动比率、速动比率大幅上升，高于可比公司平均水平，主要原因系 2024 年末发行人首发募集资金到账。

综上，公司的资产负债结构较为合理，偿债风险较低，后期随着业务规模的提升以及恰当的直接融资，公司的偿债能力将进一步提升。

（四）营运能力分析

1、发行人资产周转能力指标分析

报告期内，发行人资产周转能力有关财务指标如下：

单位：次

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	2.89	3.51	2.86
存货周转率	2.81	3.08	2.01

注：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

报告期各期，发行人应收账款和存货周转总体情况良好。2024 年度，发行人应收账款周转率、存货周转率上升，主要原因系受益于下游半导体设备市场步入上行周期及国产化进程持续推进，当期发行人收入同比增长 103.65%，而期初应收账款、存货余额相对较低。2025 年度，公司收入、成本温和增长，应收账款周转率、存货周转率有所回落。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期各期末，发行人应收账款周转率、存货周转率与同行业上市公司的比较情况如下：

单位：次

公司简称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款周转率			
富创精密	2.64	2.98	3.00
珂玛科技	2.47	2.77	2.31
托伦斯	3.15	3.57	2.96
可比公司平均值	2.75	3.11	2.76
先锋精科	2.89	3.51	2.86
存货周转率			
富创精密	2.40	2.32	2.04
珂玛科技	1.64	1.68	1.77
托伦斯	3.17	3.29	2.16

公司简称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
可比公司平均值	2.40	2.43	1.99
先锋精科	2.81	3.08	2.01

注 1：可比公司数据根据可比公司公开披露数据计算

注 2：受限于数据可得性，富创精密 2025 年数据由 2025 半年报数据简单年化处理，珂玛科技 2025 年数据由 2025 年前三季度数据简单年化处理

报告期内，发行人应收账款周转率、存货周转率略高于可比公司平均水平。2024 年度，下游半导体行业景气周期下，发行人与可比公司应收账款周转率、存货周转率变动趋势基本相同。

（五）公司最近一期末未持有金额较大的财务性投资

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条等相关规定，“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、截至最近一期末公司财务性投资的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司相关的会计科目情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	财务性投资金额
1	货币资金	66,227.65	-
2	其他应收款	144.11	-
3	其他流动资产	2,193.11	-
	合计	68,564.88	-

(1) 货币资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金账面价值为 66,227.65 万元，全部为库存现金、银行存款，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 144.11 万元，主要为押金及保证金、备用金，不属于财务性投资。

(3) 其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 2,193.11 万元，全部为增值税留抵税额，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

2026 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资，具体情况如下：

(1) 类金融

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在对融资租赁、商业保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情形。

(2) 设立或投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不存在设立或投资产业基金、并购基金的情形。

(3) 拆借资金、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不存在对外拆借资金、委托贷款的情形。

(4) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。

(5) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司存在使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的情形,上述产品不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”,公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

(6) 非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不存在投资金融业务的情形。

(7) 实施或拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

七、经营成果分析

(一) 营业收入分析

1、营业收入构成情况

报告期内,公司营业收入具体情况如下:

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	123,024.01	99.40	112,781.62	99.30	55,002.93	98.62
其他业务	748.75	0.60	795.79	0.70	768.76	1.38
合计	123,772.76	100.00	113,577.41	100.00	55,771.69	100.00

报告期各期，发行人营业收入分别为 55,771.69 万元、113,577.41 万元和 123,772.76 万元，2024 年度，受益于下游半导体设备市场步入上行周期及国产化进程持续推进，发行人营业收入增长 103.65%。

公司主营业务突出，报告期各期主营业务收入占营业收入的比重均超过 98%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司其他业务收入主要为废料、长库龄原材料销售及技术服务等。

2、主营业务收入分产品分析

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	89,409.33	72.68	81,906.26	72.62	37,079.81	67.41
结构部件	23,784.85	19.33	22,663.22	20.09	9,631.65	17.51
其他部件	3,450.90	2.81	3,139.64	2.78	6,434.93	11.70
模组	5,019.95	4.08	4,216.50	3.74	1,194.07	2.17
表面处理	1,358.99	1.10	855.99	0.76	662.47	1.20
合计	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

(1) 工艺部件

报告期内，发行人工艺部件收入分别为 37,079.81 万元、81,906.26 万元和 89,409.33 万元，占主营业务收入比例分别为 67.41%、72.62%和 72.68%。2024 年起，发行人工艺部件收入占比上升，主要系为应对半导体行业景气周期下旺盛需求，发行人产能向半导体零部件倾斜。

(2) 结构部件

报告期内，发行人结构部件收入分别为 9,631.65 万元、22,663.22 万元和

23,784.85 万元，占主营业务收入比例分别为 17.51%、20.09%和 19.33%。2024 年度，发行人结构部件收入、收入占比上升。发行人结构部件主要为工艺部件提供配套，其收入变化趋势与工艺部件基本一致。

（3）其他部件

报告期内，发行人其他部件收入分别为 6,434.93 万元、3,139.64 万元和 3,450.90 万元，占主营业务收入比例分别为 11.70%、2.78%和 2.81%。2024 年度，发行人其他部件收入、收入占比下降，主要原因系下游半导体行业景气周期下，发行人向光伏部件分配的产能减少。

（4）模组

报告期内，发行人模组收入分别为 1,194.07 万元、4,216.50 万元和 5,019.95 万元，占主营业务收入比例分别为 2.17%、3.74%和 4.08%，随着发行人模组业务的逐渐成熟，整体呈上升趋势。

（5）表面处理

报告期内，发行人表面处理收入分别为 662.47 万元、855.99 万元和 1,358.99 万元，占主营业务收入比例为 1.20%、0.76%和 1.10%，占比较低。报告期内，发行人表面处理业务收入有所增长，主要原因系：1）公司新增多条表面处理产线，为半导体行业客户配套提供的表面处理服务增多；2）2025 年，先捷航空表面处理业务通过客户验证，航空零部件表面处理收入增加；3）2025 年一季度，公司收购了主营业务为表面处理涂层业务的无锡至辰。

3、主营业务收入分地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆地区	120,875.82	98.25	110,827.51	98.27	53,779.80	97.78
中国大陆以外	2,148.20	1.75	1,954.10	1.73	1,223.13	2.22
合计	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

报告期内，发行人主营业务收入主要来自中国大陆地区。公司树立了优先服

务国内本土半导体设备企业的战略方针，深耕半导体产业链核心领域，筑牢国产半导体设备供应链安全基础，积极推动国内大循环。

4、主营业务收入的季节性变动

报告期内，公司各季度主营业务收入情况如下：

单位：万元、%

期间	2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	29,804.56	24.23	21,441.48	19.01	9,599.10	17.45
第二季度	35,279.98	28.68	32,943.61	29.21	12,274.56	22.32
第三季度	31,182.19	25.35	31,905.12	28.29	14,938.69	27.16
第四季度	26,757.28	21.75	26,491.41	23.49	18,190.59	33.07
合计	123,024.01	100.00	112,781.62	100.00	55,002.93	100.00

报告期内，发行人主营业务收入不存在显著季节性特征，各季度收入变动主要受半导体行业周期性影响。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	87,847.57	100.00	75,152.25	100.00	38,982.86	99.76
其他业务	0.43	0.00	-	-	93.99	0.24
合计	87,848.01	100.00	75,152.25	100.00	39,076.85	100.00

报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本。发行人其他业务主要为销售生产过程中产生的废料，上述废料未归集成本。

2、主营业务成本构成情况

公司主营业务成本按产品分类情况如下表：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	60,263.65	68.60	52,571.99	69.95	23,714.33	60.83
结构部件	18,914.32	21.53	15,438.52	20.54	7,267.51	18.64
其他部件	3,403.58	3.87	3,145.61	4.19	6,419.47	16.47
模组	4,188.77	4.77	3,490.80	4.64	1,152.83	2.96
表面处理	1,077.26	1.23	505.34	0.67	428.73	1.10
合计	87,847.57	100.00	75,152.25	100.00	38,982.86	100.00

报告期各期，公司工艺部件、结构部件、其他部件等各类零部件销售成本占主营业务成本的比例分别为 95.94%、94.68%和 94.01%，系主营业务成本的主要构成部分。报告期内，公司的主营业务成本与主营业务收入构成基本一致，变动趋势相符。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利分析

报告期各期，公司毛利构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	35,176.44	97.92	37,629.37	97.93	16,020.07	95.96
其他业务	748.32	2.08	795.79	2.07	674.77	4.04
合计	35,924.76	100.00	38,425.16	100.00	16,694.84	100.00

报告期各期，发行人毛利主要来自主营业务，主营业务突出，其他业务对公司综合毛利的贡献较小。

报告期各期，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工艺部件	29,145.68	82.86	29,334.28	77.96	13,365.48	83.43
结构部件	4,870.53	13.85	7,224.70	19.20	2,364.15	14.76
其他部件	47.32	0.13	-5.96	-0.02	15.46	0.10

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
模组	831.18	2.36	725.70	1.93	41.24	0.26
表面处理	281.73	0.80	350.65	0.93	233.74	1.46
合计	35,176.44	100.00	37,629.37	100.00	16,020.07	100.00

报告期各期，公司工艺部件、结构部件等半导体设备零部件贡献了主营业务毛利的 98.19%、97.16%和 96.70%，系主营业务毛利的主要源泉。

2、主营业务毛利率分析

报告期内公司主营业务各类产品的毛利率及占主营业务收入的比重如下：

单位：%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
工艺部件	32.60	72.68	35.81	72.62	36.05	67.41
结构部件	20.48	19.33	31.88	20.09	24.55	17.51
其他部件	1.37	2.81	-0.19	2.78	0.24	11.70
模组	16.56	4.08	17.21	3.74	3.45	2.17
表面处理	20.73	1.10	40.96	0.76	35.28	1.20
合计	28.59	100.00	33.36	100.00	29.13	100.00

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 29.13%、33.36%和 28.59%。2024 年度，受下游半导体行业景气周期叠加设备国产化进程加速影响，发行人产能利用率提升，单个产品分摊的固定成本下降，同时发行人产能集中于半导体行业，毛利率较低的其他部件收入占比降低，故主营业务毛利率有所提升。2025 年度，发行人主营业务毛利率下降，主要原因系：1）公司根据市场需求及发展规划进行了适度的产能预增，2025 年度，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，但下游行业在经历 2023 年下半年、2024 年扩产后进入新增产能消纳阶段，下游客户需求阶段性放缓，发行人新增产能未得充分吸收；2）为应对下游客户需求，当年员工规模同比提高，导致薪酬支出增加；3）随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品质量要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升。

报告期各期，公司主营业务各类主要产品的毛利率变化情况如下：

（1）工艺部件

报告期各期，公司工艺部件毛利率分别为 36.05%、35.81%和 32.60%。2025 年，发行人工艺部件毛利率有所下降，主要原因系关键工艺部件以外的其他工艺部件毛利率下降。

报告期各期，发行人关键工艺部件和其他工艺部件收入及毛利率情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
关键工艺部件	54,268.14	33.96	46,634.35	34.67	23,412.58	37.36
其他工艺部件	35,141.19	30.49	35,271.91	37.33	13,667.23	33.80
合计	89,409.33	32.60	81,906.26	35.81	37,079.81	36.05

2024 年度，发行人关键工艺部件毛利率下滑，主要原因系当期开发加热器新品较多，前期良率较低。2024 年至 2025 年，发行人关键工艺部件毛利率较为稳定。

2024 年度，发行人其他工艺部件毛利率上升，主要原因系半导体行业景气周期下，发行人产能利用率提升，单个产品分摊的固定成本有所下降。2025 年度，发行人其他工艺部件毛利率下降，主要原因系：1）随着国产半导体设备向先进制程迭代，下游半导体厂商对产品洁净度等指标要求日益严苛，发行人在多工序、各环节加强质量管控，成本相应上升；2）发行人围绕产能布局、人才储备高强度投入，子公司先捷航空新建厂房陆续投产、无锡先研新增租用厂房投入使用，带来固定成本增加；3）受客户需求波动影响，发行人为客户配套提供的部分低毛利工艺部件收入上升。

（2）结构部件

报告期各期，公司结构部件毛利率分别为 24.55%、31.88%和 20.48%。2024 年，发行人结构部件毛利率上升，主要受益于下游半导体行业景气周期。2025 年度，发行人结构部件毛利率下降，主要原因系：1）2025 年结构件新品收入占比提高，新品的订单量相对较少，难以形成批量效应，新品的生产效率相对较低。随着熟练度的提升和客户的需求增加，后续毛利率将得到提升；2）相对较高毛利率的成熟产品销售占比较上年同期有所下降。

（3）其他部件

报告期内，发行人其他部件毛利率分别为 0.24%、-0.19%和 1.37%。2024 年起，发行人其他部件主要为医疗零部件及医疗模组，业务培育期成本效益尚未完全释放。

（4）模组

报告期内，发行人模组业务毛利率分别为 3.45%、17.21%和 16.56%，2024 年，发行人模组毛利率上升，主要原因系发行人模组业务规模扩大、厂房设备利用率提升，单个产品分摊的固定成本下降。

3、与同行业上市公司毛利率比较

报告期内，公司与同行业上市公司毛利率的比较情况如下：

单位：%

公司简称	毛利率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
富创精密	24.94	25.80	25.20
珂玛科技	53.94	58.49	39.93
托伦斯	27.14	29.89	23.26
可比公司平均值	35.34	38.06	29.46
发行人	29.02	33.83	29.93

注 1：数据来自同行业（拟）上市公司公开信息

注 2：受数据可得性影响，富创精密、珂玛科技采用 2025 年 1-9 月数据

报告期内，发行人毛利率先升后降，变动趋势与同行业上市公司基本一致。

报告期内，发行人各期毛利率高于富创精密、托伦斯，低于珂玛科技。发行人与可比公司毛利率差异的主要原因系：（1）富创精密主营产品中，半导体设备模组类产品占比较高，由于模组类产品外购零部件成本占比较大，因此毛利率较低；（2）在产品结构上，托伦斯附加值较低的半导体设备结构部件收入占比较高；

（3）珂玛科技主营业务为陶瓷类半导体设备零部件，其上游原材料主要为成本较低的陶瓷粉末，原材料成本较低，加工过程中产生的附加值较原材料成本而言较高，因此毛利率较高；而目前发行人主营业务为金属类半导体设备零部件，尽管在精密加工过程中产生的附加值亦较高，但由于铝、不锈钢等金属原材料成本占比相较于陶瓷粉末而言较高，一定程度上摊薄了整体毛利率水平。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比
销售费用	579.67	0.47	664.17	0.58	501.96	0.90
管理费用	5,395.04	4.36	4,871.63	4.29	3,629.79	6.51
研发费用	7,137.71	5.77	6,408.32	5.64	3,630.90	6.51
财务费用	-116.97	-0.09	-105.20	-0.09	-419.83	-0.75
合计	12,995.45	10.50	11,838.92	10.42	7,342.82	13.17

报告期内，公司期间费用总额分别为 7,342.82 万元、11,838.92 万元和 12,995.45 万元，占各期营业收入比例分别为 13.17%、10.42%和 10.50%，2024 年度，受下游半导体行业景气周期影响，发行人收入规模快速增长，幅度大于期间费用，稀释了期间费用收入占比。

1、销售费用

报告期内，发行人销售费用明细如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	180.67	31.17	167.18	25.17	164.20	32.71
股份支付	96.35	16.62	96.35	14.51	96.35	19.20
业务招待费	131.93	22.76	239.18	36.01	109.63	21.84
其他费用	170.71	29.45	161.46	24.31	131.78	26.25
合计	579.67	100.00	664.17	100.00	501.96	100.00

报告期各期，发行人销售费用金额分别为 501.96 万元、664.17 万元和 579.67 万元，分别占当期营业收入的 0.90%、0.58%和 0.47%，占比较低，主要为职工薪酬、业务招待费和股份支付。2025 年度，公司业务招待费有所下降，主要系受下游需求短期调整影响，公司强化费用管理。

2、管理费用

报告期内，发行人管理费用明细如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,396.12	44.41	2,032.97	41.73	1,521.28	41.91
股份支付	728.23	13.50	803.09	16.49	785.94	21.65
折旧与摊销	435.77	8.08	505.68	10.38	519.50	14.31
办公费	422.09	7.82	390.07	8.01	226.84	6.25
财产保险费	101.57	1.88	35.86	0.74	36.63	1.01
业务招待费	77.29	1.43	128.05	2.63	60.38	1.66
中介机构费	135.92	2.52	132.25	2.71	75.77	2.09
垃圾处理费	183.79	3.41	80.93	1.66	109.01	3.00
残疾人保障金	123.01	2.28	71.68	1.47	65.99	1.82
服务费	130.01	2.41	65.78	1.35	11.83	0.33
其他	661.24	12.26	625.26	12.83	216.61	5.97
合计	5,395.04	100.00	4,871.63	100.00	3,629.79	100.00

报告期各期，发行人管理费用分别为 3,629.79 万元、4,871.63 万元和 5,395.04 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.51%、4.29%和 4.36%，主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销、办公费等构成。报告期内，发行人管理费用总额增长，主要原因系：1）随着公司经营规模扩大和组织结构优化，管理人员数量有所增加，工资、奖金、办公费用相应增长；2）2025 年度，发行人多条表面处理产线投产，危险废物产生量随之增加，相关垃圾处理费提高。

3、研发费用

报告期内，发行人研发费用明细如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,091.61	43.31	2,484.45	38.77	1,467.53	40.42
股份支付	199.54	2.80	163.79	2.56	134.67	3.71
折旧与摊销	123.38	1.73	131.17	2.05	85.12	2.34
材料费	3,627.68	50.82	3,452.11	53.87	1,860.31	51.24
其他费用	95.50	1.34	176.80	2.76	83.26	2.29
合计	7,137.71	100.00	6,408.32	100.00	3,630.90	100.00

报告期各期，发行人研发费用分别为 3,630.90 万元、6,408.32 万元和 7,137.71 万元，主要由研发材料费、研发人员薪酬等构成。发行人高度重视研发活动，前瞻性布局非金属材料、粉末冶金等多个前沿研发方向，研发投入持续增长。

4、财务费用

报告期内，发行人财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	350.19	218.41	170.03
其中：租赁负债利息费用	27.38	30.10	20.28
减：利息收入	578.99	175.71	227.49
汇兑损益	104.52	-161.24	-370.09
其他	7.31	13.35	7.73
合计	-116.97	-105.20	-419.83

报告期各期，发行人财务费用分别为-419.83 万元、-105.20 万元和-116.97 万元，主要为借款利息费用、融资租赁利息费用和汇兑损失。

报告期内，公司存在外销，主要结算货币为美元，汇兑损益主要由美元的汇率波动产生。

（五）其他影响经营成果的主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	566.76	457.61	528.56
直接减免的增值税	-	0.23	1.50
进项税加计抵减	437.69	424.63	140.26
代扣个人所得税手续费	7.42	17.37	9.94
合计	1,011.87	899.84	680.26

报告期内，公司其他收益分别为 680.26 万元、899.84 万元和 1,011.87 万元，主要由收到的政府补助、增值税进项税加计抵减等构成。

2、信用减值损失

报告期内，发行人信用减值损失具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款坏账损失	160.40	957.19	396.21
其他应收款坏账损失	25.45	8.19	16.41
合计	185.86	965.38	412.63

发行人信用减值损失主要为应收账款坏账损失。2024 年度，受益于下游半导体行业景气周期，发行人营业收入同比增长 103.65%，期末应收账款账面余额同比增长 16,927.61 万元，计入当期损益的应收账款坏账损失随之增加。2025 年末，发行人期末应收账款余额同比增长 4,014.31 万元，计入当期损益的应收账款坏账损失降低。

3、资产减值损失

报告期内，发行人资产减值损失金额分别为 156.50 万元、945.05 万元和 1,198.39 万元，均为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，随发行人业务规模扩大，期末存货规模增长，库龄略有上升，存货跌价损失相应上升。

4、资产处置收益

报告期内，发行人资产处置损益分别为 1.02 万元、-38.56 万元和 20.04 万元，主要为固定资产处置损益和使用权资产处置损益，金额较低，对发行人整体业绩无重大影响。

5、营业外收入

报告期内，发行人营业外收入分别为 0.00 万元、0.50 万元和 0.06 万元，为偶发的违约金及赔偿收入，金额较低。

6、营业外支出

报告期内，发行人营业外支出具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	0.51	23.02	41.70

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
对外捐赠	-	2.06	0.71
其他	2.71	10.02	20.45
合计	3.22	35.09	62.86

报告期内，发行人营业外支出分别为 62.86 万元、35.09 万元和 3.22 万元，主要为非流动资产毁损报废损失。

（六）非经常性损益分析

报告期内，发行人非经常性损益项目情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	19.53	-61.57	-40.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	313.27	99.69	123.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.65	-11.58	-21.16
小计	330.15	26.54	61.33
减：所得税影响额	49.29	5.20	12.37
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	280.86	21.35	48.96
非经常性损益金额占当期归属于母公司股东的净利润比例	1.49	0.10	0.61

报告期内，发行人归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 48.96 万元、21.35 万元和 280.86 万元，占当期归属于母公司股东的净利润比例分别为 0.61%、0.10%和 1.49%，主要由计入当期损益的政府补助构成。公司非经常性损益金额占当期归属于母公司股东净利润的比例较低，对盈利能力影响较小。

（七）发行人现金流量分析

报告期内，发行人现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,693.83	10,484.27	13,607.40
投资活动产生的现金流量净额	-28,693.32	-13,140.89	-9,133.86
筹资活动产生的现金流量净额	244.32	52,396.30	-1,788.57

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.64	126.73	426.08
现金及现金等价物净增加额	-8,830.80	49,866.41	3,111.04

1、经营活动现金流量分析

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	91,186.24	80,453.23	47,443.56
收到的税费返还	249.09	143.91	63.93
收到其他与经营活动有关的现金	910.90	5,403.48	7,243.28
经营活动现金流入小计	92,346.23	86,000.62	54,750.77
购买商品、接受劳务支付的现金	34,674.33	42,131.01	20,002.25
支付给职工以及为职工支付的现金	24,644.27	17,336.93	10,111.19
支付的各项税费	6,993.22	7,994.25	2,338.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,340.57	8,054.16	8,691.23
经营活动现金流出小计	72,652.40	75,516.35	41,143.37
经营活动产生的现金流量净额	19,693.83	10,484.27	13,607.40

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,607.40 万元、10,484.27 万元和 19,693.83 万元。发行人经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，与公司收入增长基本匹配。

2024 年度较 2023 年经营活动现金流量净额减少，主要原因系：2024 年收入大幅增长，为保证订单交付，公司新招聘较多员工，当期支付的人力成本大幅增加；收入的大幅增加同时使销售回款及采购支付款项同步增加；

2025 年度较 2024 年度经营活动现金流量净额增加，主要原因系：公司收到的客户回款金额增加，同时 2025 年收到的其他与经营活动相关的现金大幅减少，该部分金额主要为公司使用从客户端收到银行承兑票据支付采购部分款项，而 2024 年银行调整了该类票据的结算模式，取消了之前的票据保证金，公司自 2024 年开始逐步推行并在 2025 年彻底执行。

报告期内，发行人净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	18,889.58	21,394.62	8,027.50
加：信用减值损失	185.86	965.38	412.63
资产减值准备	1,198.39	945.05	156.50
固定资产折旧	4,468.26	3,320.57	2,586.77
使用权资产折旧	445.81	292.69	159.40
无形资产摊销	106.51	148.09	152.58
长期待摊费用摊销	818.44	486.70	385.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-20.04	38.56	-1.02
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0.51	23.02	41.70
财务费用(收益以“－”号填列)	454.71	57.16	-200.07
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-331.69	-77.16	-555.94
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	2.86	-204.12	-13.88
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,940.02	-9,918.46	-565.15
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,940.73	-25,395.68	-9,533.87
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,105.71	14,138.42	9,893.06
其他	1,249.68	4,269.43	2,662.08
经营活动产生的现金流量净额	19,693.83	10,484.27	13,607.40

报告期各期，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要来自于经营性应收应付项目、存货金额的变动和计提的折旧摊销。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，发行人投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117.60	156.26	13.94
收到其他与投资活动有关的现金	1,640.00	1,640.00	560.00
投资活动现金流入小计	1,757.60	1,796.26	573.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,687.18	13,297.15	9,147.80
投资支付的现金	-	-	0.001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,123.74	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,640.00	1,640.00	560.00

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资活动现金流出小计	30,450.92	14,937.15	9,707.80
投资活动产生的现金流量净额	-28,693.32	-13,140.89	-9,133.86

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，表现为净投资。报告期内，发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额持续增长，主要原因系：1）随着半导体设备国产化进程的不断推进，国内半导体设备厂商产品技术更新迭代快，公司新建多间厂房、购置大量机器设备，用于工艺能力提升及新产品研发、生产；2）2024 年末，发行人首发募集资金到位，首发募投项目建设投入相应增加。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，发行人筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	53,694.45	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,675.21	3,900.00	3,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41.16	29.11	-
筹资活动现金流入小计	10,716.37	57,623.55	3,500.00
偿还债务支付的现金	4,495.00	3,000.00	4,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,459.45	188.25	151.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,517.60	2,039.01	237.44
筹资活动现金流出小计	10,472.05	5,227.26	5,288.57
筹资活动产生的现金流量净额	244.32	52,396.30	-1,788.57

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流入主要系首发募集资金到账及取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金。2024 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较高，主要原因系公司于年内收到首发募集资金。

综上，报告期内，公司现金流量的变动情况与经营状况基本相符。

八、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 9,147.80 万元、13,297.15 万元和 27,687.18 万元，公司重大资本性支出主要投向为首次公开发行股票募投项目。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的资本性支出项目主要为公司前次募集资金投资项目的继续投入、本次募集资金计划投资的项目、半导体先进涂层产业化项目和民用航空航天结构件开发制造项目。公司前次募集资金投资项目及本次募集资金计划投资的项目具体情况详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”“第八节 前次募集资金的使用情况”。

除上述募投项目外，公司计划进一步增强适用于半导体零部件的先进涂层表面处理能力，实施“半导体先进涂层产业化项目”，项目预计首期投资金额为 5,000 万元人民币，以适配下游客户日益严苛的表面处理要求；此外，公司拟利用现有零部件制造技术和经验积累，实施“民用航空航天结构件开发制造项目”，项目预计首期投资金额为 10,000.00 万元人民币，积极应对国内蓬勃发展的航空航天产业需求，为航空航天领域客户提供高性能结构件产品。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

报告期内，公司通过募投项目的实施，将核心技术深度应用于丰富的半导体客户场景及广泛的下游制程领域，针对更高制程需求，持续对核心产品进行升级迭代，进一步丰富产品结构，提高产品质量及精度、满足客户日益提升的需求。前次募投项目和本次募投项目聚焦半导体设备核心精密零部件关键技术突破与产能升级，巩固和提升公司的市场地位。

此外，公司一方面自建半导体先进涂层产能，提高半导体零部件特种表面处理能力；另一方面，公司将在半导体零部件领域积累的经验和优势进一步扩展至航空航天领域，为国内航空航天事业增添助力。

九、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、与产品或服务有关的技术情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：

单位：万元

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
高温合金匀气盘制造工艺研发	正在进行微孔钻削加工工艺设计及工装测试。	此项目为高温合金材料的匀气盘微孔加工高效切削工艺及质量提升技术研发。	将匀气盘微孔孔径公差控制在极小范围	优于客户标准	精密机械制造工艺	636
氮化钛金属硬膜掩膜刻蚀机零部件研发	新品研发已经交付并实现小批量订单交付，目前处于持续跟踪客户反馈并优化。	此项目为氮化钛金属硬膜掩膜刻蚀机零部件国产化的开发。	完成该类客户设备机台中例如反应腔，水冷盘等关键核心零部件的开发。	优于客户标准	精密机械制造工艺	655
PECVD 设备核心部件加热气体分配器制造工艺研发	项目即将结项，已完成研发件试制、PPAP 验证，核心技术指标达标，完成规模化生产方案制定，相关专利申报推进中，量产筹备工作已落地，各项既定任务即将全部完成。	研发 PECVD 设备核心部件加热气体分配器，整合传统气体分配器与高温晶圆加热器，开展仿真、结构设计、APQP 策划及试制验证，攻克孔径、温均性等技术难点，推动国产化量产。	实现加热气体分配器国产化并达国际水平，孔径标准差、粗糙度、温均性达既定指标，年量产 1500 套、年产值 5000 万元，申报 2 项以上相关专利。	优于客户标准	半导体 PECVD 机台设备	755
SIC-CVD 外延设备零部件制造工艺优化	已完成外延设备零部件制造的背景与市场需求，了解相关行业的技术发展状态及加工产品的加工难度与加工可行性。	此项目为外延设备零部件制造工艺优化。	提高外延设备的生产效率 and 产品质量	优于客户标准	外延设备	420
金属硅化物毫秒级退火设备组件研发	无磁材料验证、焊接结构设计阶段	此项目拟通过无磁性材料及焊接后磁性验证进行相关产品开发。	保证客户设备运行不受磁力影响	优于行业标准	关键工艺部件	1,050
一种半导体快速退	焊接结构优化，第二轮样品制作	结合 RTP 设备退火工艺需求	确保蜂窝灯源阵列部件无任何泄漏点，各通	优于客户标准	半导体快速退火设	780

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
火设备 (RTP) 蜂窝灯源阵列部件研发		(适配 12 英寸晶圆、毫秒级退火、精准温控), 设计蜂窝灯源阵列焊接、加工、检测等工艺方案。	道尺寸完全符合客户装配要求, 最终实现灯源均匀性 $\leq\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1100°C 环境下), 升温速率 $\geq 200^{\circ}\text{C/s}$, 降温速率 $\geq 80^{\circ}\text{C/s}$, 使用寿命 ≥ 20000 小时。		备	
次常压化学气相沉积设备核心部件研发	工艺研发已完成, 开始将工艺应用于部分实验产品。	此项目为设计、材料和制造工艺的优化, 应用与核心部件生产。	实现设备的低压力、低温度运行, 提高设备的性能、稳定性和寿命, 实现客户次常压化学气相沉积设备核心组件的国产化。	优于客户标准	关键工艺部件	735
一款半导体设备传输模块用过渡腔的开发	转移腔内零部件持续开发中, 待交付客户验证。	此项目为腔体加工工艺、表面处理工艺开发以及高真空测漏验证和组装工艺优化进行产品开发。	旨在开发出外观如同镜面且保留加工纹理外观以及超低漏率的过渡腔。	优于客户标准	半导体腔体	300
半导体超防腐化学存储腔室设备零部件研发	工艺路线已经定制完成, 加工件测试喷涂试验进行中。	此项目开发国内自主的防腐腔室特殊喷涂工艺进行产品开发。	实现防腐腔室国产化	优于客户标准	关键工艺部件	620
先进制程匀气盘开发及成熟制程匀气盘研发	项目进展 30%, 基础能力搭建中, 正在测试分项制造能力, 微孔位置度以及孔内粗糙度。	开发适用先进制程薄膜沉积设备用的关键零部件气体分配器。	攻克面向 5nm 及以下先进制程的高性能匀气盘制造关键技术, 完成产品研发、中试验证与客户导入, 建成一条技术安全、具备批量供应能力的示范生产线, 实现高端匀气盘的国产化, 关键性能指标达到国际主流产品水平。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	850
铝基碳化硅 ESC 基座研发	项目进展 50%, CNC 加工能力, 喷涂能力已经搭建完成, 当前正在开发焊接工艺。	开发适用高低温频繁变换工艺温度的刻蚀机设备用的 ESC 基座。	攻克铝基碳化硅 ESC 基座的材料配比、精密焊接、超精密加工、特种喷涂等核心技术, 开发出满足超低温刻蚀工艺需求的产品, 通过中微公司、北方华创、新凯来等目标客户的产品验证, 形成稳定的批量生产能力, 实现铝基碳化硅 ESC 基座的国产化, 关键性能指标达到国际先进水平。	优于客户标准	半导体刻蚀设备	380

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
半导体设备用陶瓷静电吸盘开发	方案论证及设计早期阶段	开发一种广泛应用于半导体工艺中的陶瓷 ESC，主要内容包括：介电层陶瓷材料性能的精准调控；介电层与电极层的制备技术；介电层、电极层与基座的连接技术；静电吸盘介电层的表面处理技术；静电吸盘热区分布、电极层设计的模拟技术；静电吸盘各项技术性能指标测量方法和标准的建立。	介电层电阻率：库伦型 $>E+14\Omega\cdot\text{cm}$ ，J-R 型 $E+9\sim E+12\Omega\cdot\text{cm}$ ；介电强度：库伦型 $\geq 20\text{kV/mm}$ ，J-R 型 $\geq 15\text{kV/mm}$ ；工作面平面度 $\leq 5\mu\text{m}$ ；最大吸附力 $\geq 200\text{gf/cm}^2$ 。	由于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	2,985
高性能电镀镍工艺研发	工艺路线基本确定，电镀药剂采购中，实验设备处于定制阶段。	此项目为先进制程 CVD 工艺零部件的表面处理工艺开发。	形成用于先进制程的、有效提升稳定性的化学配方与工艺路径。	达到先进制程的行业标准	关键工艺部件	886
化学镍旋流搅拌过滤工艺研发	已完成工艺设计、产线试产，已完成部分客户盘类工艺件的生产首件测试。	项目核心围绕化学镍旋流搅拌过滤工艺开展全流程研发，覆盖“工艺设计—设备适配—参数优化—中试验证—技术沉淀”全环节。	形成 1 套可工业化应用的旋流搅拌过滤工艺方案，配套研发 1 套中试级专用设备，确保工艺稳定可靠、环保达标，可直接适配工业级化学镍废液处理场景。	优于行业标准	半导体薄膜设备（CVD、ALD 等）核心工艺部件	825
刻蚀设备零部件的铝合金钝化工艺开发	已完成全流程研发与验证，实现无铬钝化工艺固化并达成批量生产条件，各项技术指标均验证达标。	针对刻蚀设备零部件研发铝合金无铬钝化工艺，完成新型无铬钝化剂筛选与配方优化，确定最佳工艺参数，依次开展实验室小试、中试生产验证工艺可行性，优化工艺流程后实现工艺固化，达成产业化批量应用。	研发出适配刻蚀设备零部件的环保高效铝合金无铬钝化工艺，膜层耐蚀性、附着力等性能超传统含铬工艺，工艺流程简化且生产无污染，实现工艺固化与批量生产，满足相关零部件的工业化应用需求。	优于客户标准	半导体刻蚀设备	545
铝基晶圆	项目处于研发阶段，已	研发铝基晶圆加	实现铝基晶圆加热器	优于客户	半导体 PECVD	1,050

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
加热器表面耐高温氟化铝涂层工艺研发	完成目标制定、技术调研与研发路线确认, 正开展氟化铝涂层工艺筛选及基本性能测试工作, 按计划推进配方试制相关研究。	热器表面耐高温氟化铝涂层工艺, 含涂层工艺与配方设计、制备工艺探索、性能测试评估, 同时制定规模化生产方案, 解决涂层高温可靠性、均匀性等技术难点。	耐高温氟化铝涂层国产化, 解决铝离子超标等问题, 提升加热器性能, 量产后预计年销2000套, 年产值约4000万元, 申请2项以上相关专利。	标准	机台设备	
半导体设备零部件用先进陶瓷涂层和新工艺开发	项目进展70%, YF3、YOF、YAG涂层工艺已完成开发, 新的涂层工艺已确定超致密涂层的设备和EB-PVD设备的采购, AD工艺目前在进行调研和实验中, 氧化钇粉国产化已经完成前期基础工作, 目前正在推进客户验证。	本项目拟采用APS、HVOF、以及ALD工艺, 开发喷涂型静电吸盘所需的高性能氧化铝涂层。通过APS工艺, 采用适配的原料粉末, 经过喷涂工艺参数的优化, 做好喷涂YF3、YAG、YOF涂层的技术储备。本项目拟和国内氧化钇粉末厂家共同开发半导体级别高纯氧化钇粉末, 并对熔射后的结果进行系列检测和实验。	喷涂型氧化铝静电吸盘满足客户要求的技术指标; 做好YF3、YOF、YAG等新涂层开发的技术储备。涂层新工艺SPS、HOVF、AD、EB-PVD等做好技术储备。实现国内高纯氧化钇粉末熔射的产品各项性能指标达到进口粉末产品同等水平, 为后续全产业链国产化做好准备工作。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD机台等设备	900
高性能微弧氧化膜制备工艺与技术研发	项目处于研发收尾阶段, 已完成工艺参数优化、设备研发与膜层性能测试, 正优化工艺流程, 即将完成验收总结并申报相关专利, 整体开发接近尾声。	针对半导体设备零部件耐腐蚀、耐高温的需求, 研发铝合金微弧氧化工艺, 优化工艺参数与制备设备, 检测分析氧化膜性能, 优化工艺流程, 研发自主知识产权的工艺技术及制备设备。	研发适配半导体设备零部件的铝合金微弧氧化工艺, 提升氧化膜防腐、耐热冲击性能, 形成自主知识产权的工艺技术及设备, 实现氧化膜性能稳定达标。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD机台等设备	480
高性能刷镀镍工艺研发	完成了多种刷镀液配方的测试, 分析了影响工艺质量的过程因	本项目聚焦高性能刷镀镍工艺的全链条研发, 突	1. 完成高性能刷镀镍工艺的中试验证, 建立中试生产线, 实现批量	优于客户标准	半导体刻蚀类设备核心工艺	520

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
	素（温度、杂质、速度、电流等），目前正在进行定制化刷镍机的设计开发。	破传统刷镀镍工艺在环保性、稳定性、功能性上的核心瓶颈，整合材料配方、工艺参数、装备适配、质量管控四大维度，形成一套可产业化、适配多场景的高性能刷镀镍技术体系。	生产适配，中试产品合格率 $\geq 97\%$ ，形成可直接转化的产业化技术方案，解决工艺规模化应用中的稳定性、成本控制等问题。2. 优化工艺成本，使高性能刷镀镍的单位成本较进口同类工艺降低20%-30%，较传统刷镀镍工艺降低10%以上，提升产品市场竞争力。		部件	
铝合金高致密氧化工艺研发	项目已完成全部研发工作，完成工艺参数固化、小型零件认证测试及实验室成果转化，形成自主知识产权的工艺技术与氧化膜性能检测报告，正式结项。	针对半导体设备用铝合金零部件，开展原材料选型、表面预处理、阳极氧化工艺及槽液优化，研发膜层封闭技术，经多轮样块实验与性能测试，最终固化核心工艺参数，形成完整工艺方案。	研发适配半导体设备的铝合金零部件的高致密阳极氧化工艺，实现膜层厚度、致密性等核心指标达标，显著提升铝合金耐腐蚀、耐热冲击及耐击穿性能，满足零部件高温工况使用需求。	优于行业标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	380
刻蚀机零部件先进表面加工工艺开发	项目进展30%，氧化钇涂层耐盐酸腐蚀满足要求，氧化铝涂层性能提升有待进一步改进和验证。	本项目拟采用大气等离子喷涂APS工艺，对刻蚀机设备零件表面进行陶瓷涂层加工，制备满足性能要求的氧化钇和氧化铝陶瓷涂层。通过对大气等离子喷涂后的陶瓷涂层，进行精细的磨削机加工，来满足客户的图纸要求，制备尺寸精度和表面外观满足客户要求的刻蚀机设备零部件。	项目预期实现的目标： (1) 氧化钇涂层的耐盐酸（浓度5%）腐蚀时间 > 5 小时； (2) 氧化铝涂层的孔隙率 $< 2.5\%$ ； (3) 氧化铝涂层耐低温性能指标：在低温箱最低温度需低于 -80°C ，在高温箱最低温度需高于 50°C ，两箱温冲 ≥ 5 次。试验后使用紫外光灯检查涂层外观，要求无损伤。	由于客户标准	半导体刻蚀设备	600
焊接技术在半导体金属加热	制定焊前制备标准，设计合理关键控制点，建立此类产品，产品导入	此项目为加热器、匀气盘等的钎焊、搅拌摩擦	研发分析总结出设计和材料、焊前制备、焊接工艺、工装及设备控	优于行业标准	钎焊及电子束工艺	560

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
器中应用	评审流程。	焊、电子束焊的焊接工艺研发，包括焊前制备控制、焊接装配以及焊接参数、填充材料、工装的检验验证。	制的标准工艺，已达到高度一次制造合格率和钎合率，同时实现窄小气道及水道不堵塞。			
陶瓷金属复合晶圆加热器研发	项目已完成结题验收，按期完成工艺定型与批量生产，样件成功通过客户认证，1项专利完成授权。	研发陶瓷金属复合晶圆加热器，重点优化陶瓷金属复合材料配方与制备工艺，开发高温高绝缘涂层及喷涂、CVD等涂覆工艺，设计定制化发热片结构并研究精密加工工艺，攻克材料复合、涂层稳定、隔热层高效设计三大核心技术难点。	研发出高导热、耐高温的陶瓷金属复合材料并制成晶圆加热器，实现700°C最高工作温、±1°C控温精度等核心技术指标，加热效率较传统产品提升20%以上，实现规模量产并达成年总产值5000万元以上的经济目标。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD机台等设备	920
晶圆加热器表面温度检测模组研发	项目已完成结项，完成了全流程研发、样机制作与各类测试验证，相关检测模组已完成实际应用验证，完成生产线筹备，进入规模化生产前期阶段。	研发晶圆加热器表面温度检测模组，融合红外测温、TC-Wafer技术，结合模拟真空腔体与智能算法，完成设备选型、集成设计、样机制作及测试优化等全流程研发工作。	实现0.1°C高精度测温，输出全表面温度分布数据，模组适配高温真空环境，具备高抗干扰性与稳定性，降低生产损耗，实现模组量产并提升晶圆加热器良率。	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD机台等设备	500
刻蚀机用非真空加热组件开发	项目已完成结题验收，实现刻蚀机用非真空加热组件国产化，完成小批量生产与量产工艺优化，可实现批量供货，相关发明专利进入受理阶段。	研发刻蚀机用非真空加热组件，从基体材料、成型工艺研发试制，优化元件结构，提升加热元件利用率、温度均匀性和传热效率，解决加热效率低、升温慢等问题。	实现该加热组件国产化，达成既定技术指标，年销售2000套，量产后年产值约5000万元，申请多项相关专利，形成可量产的加工工艺。	优于客户标准	半导体刻蚀设备	690
半导体设备用铸铝加热器研	项目进入收尾阶段，已完成小批量生产，各项性能检测达标，首样通	开展半导体铸铝加热器结构、浇铸工艺等研发，	实现铸铝加热器国产化并达国际水平，温度均匀性≤±0.5%，产品	优于客户标准	半导体刻蚀、CVD机台等设	680

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
发	过客户验收，正推进量产落地与标准作业指导书落地，完成全部研发节点。	攻克材料调配、焊接、模具设计等难点，完成试模、表面处理及性能检测，实现小批量试制与客户验证。	无外观及内部缺陷，可真空使用，成膜效果优异，达成年量产 3000 套、年营收 6000 万元目标。		备	
半导体设备晶圆陶瓷加热器开发	开发进行中，首件测试样件已交给客户进行测试，其他款产品正在准备交付客户首件进行测试验证。材料关键性能和关键结构参数控制在继续优化中。	开发一种广泛应用于半导体工艺中的 AIN 陶瓷加热器。主要开发内容包括：高性能 AIN 材料及制备技术的开发，满足热场均温要求和一定使用寿命的加热丝设计和制造，及多层 AIN 加热器制造工艺技术开发。	温度均匀性： 450°C<5°C；550°C<5°C 550°C体电阻： ≥5E8Ω·cm mesh 网平整度： ≤0.15mm 表面平面度：<10μm	由于客户标准	半导体刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	1,050
半导体光刻、刻蚀及薄膜沉积设备用流体加热器工艺研发	处于研发攻关阶段，产品需求规格书编制与详细技术方案设计已完成，正在推进样机试制、测试验证，已有三款样件送至客户端验证。	本项目聚焦半导体光刻、刻蚀及薄膜沉积设备用流体加热器工艺研发，围绕铠装加热管、高功率密度加热棒、陶瓷加热板、铸铝成型流体加热器四类核心产品，针对国产同类产品精密铸造缺失、材料处理工艺不足、制造精度低、一致性控制弱等核心问题，从材料、结构、控温、集成四个维度推进技术优化与工艺突破。	技术上实现加热棒功率密度至 32w/cm ² ，25-500°C控温精度 ±0.5°C内，批量性能偏差≤5%，连续运行寿命 ≥3 年，升温响应≤4S，集成智能化功能并实现高端材料国产化。产业化上实现产品批量生产、性能达国际水平，建成小批量产线。	优于客户标准	半导体光刻、刻蚀、CVD、PVD 机台等设备	800
放疗设备用头框架零部件制造工艺开发	开发进行中，关键部件样件已完成交付客户验证。	此项目为多种类零件的制造和表面处理等工艺的验证和开发。	提高产品质量，实现稳定的产品交付能力，为承接更多同类型高端医疗客户业务形成技术能力。	优于客户标准	医用直线加速器	600
放疗屏蔽	钨合金叶片不同类型	此项目系针对不	打破一人一机模式，实	优于行业	医用直线	110

项目	所处阶段	项目内容	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域	项目预算
钨合金叶片的工艺优化	已分别交付客户验证成功,可以实现小批次生产。	同叶片类型进行自动化磨削加工工艺优化,控制叶片产品的尺寸以及变形量。	现一人多机操作,提高生产效率,降低人工成本。同时可以显著提高后续组装的精度以及动态测试的稳定性。	标准	加速器	
半导体快速热处理设备组装开发	开发进行中,首批次模组系统已交付客户,关键数据验证中。	此项目拟通过进行关键部件等离子喷涂工艺开发、组装、测试等集成配套工艺,完成相关产品验证。	保证客户对于真空泄漏、反射率等热处理设备性能指标要求的提升,可实现国产化能力以及批量供货的目标。	优于客户标准	半导体热处理设备	345
半导体光刻机设备精密零部件开发	工艺开发完成,试验件尺寸加工验证中。	此项目涉及到公司历史上较少加工的钛合金、不锈钢等材料,以及所需产品的形位公差达到2-5微米的精度,需要突破公司在加工制造工艺上的突破,并形成稳定可靠的量产技术能力。	攻克难加工材料镍基合金的超精密加工,开发出满足EUV光刻机使用的平台框架,新凯来等目标客户的产品验证,助力实现国产EUV光刻机的制造,关键性能指标达到国际先进水平。	优于行业标准	EUV光刻机	580

(三) 保持持续技术创新的机制和安排

1、建立了三大技术革新反馈机制

技术创新的动力来自客户及市场需求,公司经过多年与下游头部客户的深度合作,与客户建立了技术革新反馈机制。首先,公司会派出工程师在主要客户处长期驻场,第一时间了解客户对公司产品瑕疵、性能更新需求等,通过该机制,公司能够及时掌握下游客户的发展动态;其次,在与客户的不断沟通交流中实现双方产品的协同及共同迭代进步,因此,公司还与客户建立了合作开发新工艺的机制,即公司会不定期地与客户协同开发重点产品及新工艺研发、验证和应用,通过该机制,一方面公司能够明确技术更新迭代方向,加快技术研发,另一方面也能帮助国产设备厂商加快完成产品的研发和设计。

除与客户建立技术革新反馈机制外,公司也建立了与供应商的技术革新反馈机制。由于半导体设备零部件工序繁多且专业度高,即使是行业龙头也无法覆盖全部生产工序,但公司是向客户交付最终合格产品的第一责任人,因此,公司需

要整合多方产业资源，为客户提供优秀的产品解决方案。基于此，公司通过深耕行业，积累了一批长期合作的外协供应商，不断根据客户需求研究技术更新，带领供应商共同发展，在相互配合中共同突破工艺瓶颈、迭代升级。

除上述两大反馈机制外，公司还建立了全平台技术革新反馈机制，即通过全员合理化建议的实施，公司在研发、工程和生产部门间建立了有效、通畅的沟通渠道，定期对员工提出的优化改善措施进行评估和奖励，极大地激发员工创新行动热情。通过该机制，公司将研发和生产两者有机结合，相辅相成，加速完善技术研发的同时，保证了技术研发有效地转化为生产力，进一步丰富了高科技制造型企业的创新路径。

综上，公司通过上述与客户、与供应商、与员工建立的三大技术革新反馈机制，形成了一个以高端零部件为载体的，多工艺联合研发创新和生产的生态系统，在该生态系统下，公司能够以较快的响应速度及具有竞争力的价格为客户提供高质量的产品，上述机制系公司研发和技术创新的主要机制。

2、前瞻性研究、产品导向、工艺迭代有机结合的研发框架

公司高度重视研发创新活动，设立了专门的研发中心主导工艺和产品开发。公司由首席技术官主持统筹研发中心的研发创新活动，下辖研发管理部、研发一部、研发二部、研发三部和研发四部，具体部门职责如下：

一级部门	二级部门	职责简述
研发中心	研发管理部	1、各级横向及纵向课题、项目的对接和管理。2、研发体系的管理。3、和其他部门日常事务的对接和管理。
	研发一部	1、负责产品的设计及模拟。2、负责金属加热类产品的研发、新品工艺制定及工艺技术支持等工作。3、负责本部门开发产品、工艺标准的制定
	研发二部	1、负责新材料类产品的研发。2、负责陶瓷类材料及产品的研发。3、负责干法表面处理研发和工艺技术支持。4、负责本部门开发产品、工艺标准的制定
	研发三部	1、负责公司各品类产品精密加工工艺的开发。2、负责 SHD 产品开发。3、负责本部门工艺标准的制定。
	研发四部	1、负责湿法表处工艺的开发和工艺技术支持。2、负责公司实验室建设和管理。3、负责公司理化性能检测。4、负责本部门工艺标准的制定。

报告期内，公司研发投入金额分别为 3,630.90 万元、6,408.32 万元和 7,137.71 万元，保持持续增长，占各期营业收入的比例分别为 6.51%、5.64%

和 5.77%。截至 2025 年末，公司研发人员 156 人，占员工总数的 10.25%。公司未来将持续加大研发投入，为持续创新和技术储备提供保障。

3、强化知识产权，保护自有知识产权

公司高度重视核心技术和知识产权的保护，不断强化知识产权管理。公司内部所有技术文件均经过保密处理，有严格的审批解密管理流程。同时，公司及时对研发形成的专利技术、软件申请专利权和软件著作权。通过技术保密和知识产权申请等手段相结合，对公司核心技术进行保护。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、仲裁、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》，本募集说明书所指的“重大诉讼、仲裁”系指涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或者市值 1%以上的未决诉讼、仲裁案件。

十一、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大。本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务开展，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，有利于公司保持并进一步提升自身的生产实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为游利，公司控制权不会发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

报告期内，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。

截至本募集说明书签署日，公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

序号	企业名称	主营业务/经营情况
1	英瑞启	无实际业务
2	优正合伙	员工持股平台
3	优合合伙	员工持股平台

上述企业与发行人之间不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

控股股东、实际控制人游利作出如下承诺：

“1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股企业以外的其他企业均未直接或通过其他任何形式间接从事任何与公司及其控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦未直接或间接拥有任何与公司及其控股企业构成或可能构成竞争的其他企业、经济组织的权益。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股企业以外的其他企业将继续不以任何方式直接或间接从事、参与、投资任何与公司及其控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、自本承诺函签署之日起，如公司及其控股企业进一步拓展其业务经营范围，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股企业以外的其他企业将不与公司及其控股企业拓展后的业务相竞争；若与公司及其控股企业拓展后的业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股企业以外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入公司及其控股企业，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股企业经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司及其控股企业，并尽力将该商业机会让予公司及其控股企业。

4、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

如违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司及其控股企业构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人愿意对违反上述承诺而给公司及其控股企业造成的经济损失承担赔偿责任。

本承诺函自签署之日起生效，在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。”

（三）本次发行对公司同业竞争的影响

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不会因本次发行产生同业竞争。

四、关联方和关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规定，公司存在的关联方及关联方关系如下：

1、控股股东和实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为游利。具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”。公司的控股股东及实际控制人关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。

本募集说明书所称“关系密切的家庭成员”，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他股东

直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他股东如下：

单位：%

序号	股东名称	持股类型	持股比例
1	优立佳合伙	直接持股	12.70
2	英瑞启	直接持股	9.26
3	优正合伙	直接持股	7.75
4	邵佳、李欢夫妇	直接持股	5.73
		间接持股	0.69
		合计	6.42
5	XU ZIMING	直接持股	4.01
		间接持股	1.31
		合计	5.32

注：上述持股比例截至 2025 年 12 月 31 日

上述自然人股东关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。

3、公司董事、高级管理人员

公司现任董事或高级管理人员的基本情况详见本募集说明书“第四节 发行

人基本情况”之“六、董事、高级管理人员、其他核心人员”。上述自然人关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。

4、前述关联法人、关联自然人直接或间接控制的或施加重大影响的除发行人外的其他企业，或由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事或高级管理人员的除发行人外的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1.	英瑞启	控股股东、实际控制人控制的其他企业
2.	优正合伙	控股股东、实际控制人控制的其他企业
3.	优合合伙	控股股东、实际控制人控制的其他企业
4.	苏州工业园区福恩特企业服务咨询有限公司	控股股东、实际控制人游利的弟弟游晖及其配偶谢雪梅共同控制，且游晖担任执行董事的企业
5.	JINGE CO., LTD	控股股东、实际控制人游利的女儿游锦格控制并担任董事的企业
6.	佳佳精密	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任执行董事、总经理的企业
7.	靖江佳晟	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任董事长、经理的企业
8.	北京佳正合真空技术有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任董事、经理、财务负责人的企业
9.	上海海檀半导体科技有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇控制，且邵佳担任执行董事的企业
10.	张家港佳惠汽车配件有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇控制，且邵佳担任执行董事、总经理的企业
11.	靖江格物致知企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东李欢控制，且李欢担任执行事务合伙人的企业
12.	靖江佳奇胜企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东李欢控制，且李欢担任执行事务合伙人的企业
13.	靖江佳正合企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东李欢控制，且李欢担任执行事务合伙人的企业
14.	靖江大道至简企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东李欢控制，且李欢担任执行事务合伙人的企业
15.	上海璟行行止企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东李欢控制，且李欢担任执行事务合伙人的企业
16.	JIAJIA PERFECT VACUUM TECHNOLOGY CO., LIMITED	持有发行人 5%以上股份的股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任总经理、李欢担任董事的企业
17.	江苏飞翔缝制有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制的企业
18.	吉凯恩航空技术（上海）有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶 GU YONGKANG 担任董事长兼总经理的企业

序号	关联方名称	关联关系
19.	吉凯恩航空零部件（靖江）有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶 GU YONGKANG 担任董事长的企业
20.	凯飞航空制造有限责任公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶 GU YONGKANG 担任董事的企业
21.	福克.埃尔莫（廊坊）电气有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶 GU YONGKANG 担任董事长的企业
22.	重庆恩享科技有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶的姐姐顾虹担任董事的企业。
23.	重庆小恩科技有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶的姐姐顾虹担任董事的企业。
24.	重庆长嘉汇智慧生活服务有限公司	董事、董事会秘书 XIE MEI 的配偶的姐姐顾虹间接控制的企业。
25.	扬州同辉化工技术有限公司	董事李镝持股并担任执行董事、总经理的企业
26.	上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司	董事李镝持股并担任董事的企业
27.	扬州市宝茂塑料电器有限公司	董事李镝担任董事的企业
28.	泰州中山广告有限公司	董事李镝的妹妹李晖及其配偶李俊共同控制的企业
29.	泰州市高港区李鱣书画院	董事李镝妹夫李俊的个体工商户
30.	泰州国艺文化艺术培训有限公司	董事李镝妹夫李俊控制并担任董事的企业
31.	扬州金店有限公司	董事李镝配偶的弟弟王鹏及其母亲何秀珍控制，且王鹏担任董事长兼总经理、何秀珍担任董事的企业
32.	扬州鑫泉商贸有限公司	董事李镝配偶的弟弟王鹏控制并担任执行董事的企业
33.	扬州瑞泉文化传媒有限公司	董事李镝配偶的弟弟王鹏控制并担任执行董事的企业
34.	吴中区木渎浩安商务信息咨询服务部	独立董事沈培刚的个体工商户
35.	苏州拓普恒正企业管理咨询有限公司	独立董事沈培刚的配偶蒋悦及其母亲浦彩芳控制且蒋悦担任执行董事、总经理的企业。
36.	中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	独立董事沈培刚担任负责人。
37.	苏州工业园区则成商务信息咨询服务部	独立董事沈培刚的配偶蒋悦的个体工商户。
38.	苏州友泽财税服务有限公司	首席财务官杨丽华及其配偶张科良控制，且张科良担任执行董事、杨丽华担任监事的企业
39.	启能电热科技（靖江）有限公司	首席财务官杨丽华配偶张科良担任经理的企业

5、公司子公司

公司子公司包括靖江先捷、无锡先研、无锡至辰及先锋精密（新加坡），其基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司的组织结

构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司直接或间接控股公司情况”。

6、报告期内曾经存在的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1.	吴晓旭	报告期内曾任公司董事，已于 2025 年 10 月 16 日离任
2.	ULYC（香港）（已注销）	控股股东、实际控制人曾控制的企业
3.	大晟航空	控股股东、实际控制人游利的弟弟游晖曾控制的企业
4.	靖江佳仁（已注销）	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇曾控制的企业
5.	靖江市甘佳泉环保科技有限公司（已注销）	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇曾控制的企业
6.	靖江顺希（已注销）	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇曾控制的企业
7.	靖江通普斯极耳新能源有限公司（已注销）	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇曾经控制，且邵佳曾经担任执行董事、总经理的企业
8.	泰州市高港广告装潢服务部（已注销）	董事李镡的妹夫李俊曾投资的个体工商户
9.	高港区李鱻书画研究院（已注销）	董事李镡的妹夫李俊曾投资的个体工商户
10.	砺铸智能设备（天津）有限公司	前董事吴晓旭担任董事的企业
11.	谛有科技（上海）有限公司	前董事吴晓旭控制的企业
12.	重庆机电控股（集团）公司	独立董事杨翰的姐夫刘永刚曾担任副总经理的企业
13.	重庆赛力盟电机有限责任公司	独立董事杨翰的姐夫刘永刚曾担任副董事长的企业
14.	南通市华文财税咨询有限公司（已注销）	独立董事沈培刚曾担任执行董事的企业
15.	苏州艾吉威机器人有限公司	首席财务官杨丽华曾担任副总经理、财务总监的企业
16.	ULYC（新加坡）（已注销）	发行人曾经的孙公司

（二）关联交易情况

1、报告期内关联交易情况

发行人及子公司报告期内与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）向关联方销售商品及服务

单位：万元、%

关联方	关联交易主要内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
靖江佳晟	提供表面处理服务	210.29	94.73	1.39
靖江顺希	销售铝屑废料	-	-	77.00

合计	210.29	94.73	78.39
占当期营业收入比例	0.17	0.08	0.14

(2) 向关联方采购产品及服务

单位：万元、%

关联方	关联交易主要内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
靖江佳晟	外协加工、定制件、辅材	264.88	1,128.68	729.01
	水电、物业费	228.92	146.31	101.42
佳佳精密	定制件	72.07	63.22	-
靖江佳仁	外协加工、定制件	-	-	40.54
大晟航空	外协加工	-	0.84	0.45
合计		565.88	1,339.05	871.42
占当期营业成本比例		0.64	1.78	2.23

(3) 向关联方租赁厂房

出租方	承租方	租赁内容	面积	租金	租赁期限
靖江佳晟	先锋精科	位于靖江经济开发区新兴路9号的厂房	1,974.98m ²	18元/月/m ² (不含物业费)	2022.5.1-2027.7.31
靖江佳晟	先锋精科	位于靖江经济开发区新兴路9号的厂房	1,974.98m ²	18元/月/m ² (不含物业费)	2022.8.1-2027.9.30

(4) 关键管理人员薪酬

单位：万元

关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	759.92	795.60	648.87

(5) 接受关联方担保

单位：万元

序号	借款人	担保人	借款银行	担保主债权金额	担保债权起始日	担保债权到期日
1	先锋精科	游利	农业银行	500	2022.4.20	2023.4.19
2	先锋精科	游利	农业银行	500	2022.7.21	2023.7.20
3	先锋精科	游利	农业银行	1,500	2022.7.21	2023.7.20
4	先锋精科	游利	农业银行	500	2022.11.23	2023.11.22
5	先锋精科	游利	农业银行	500	2022.12.28	2023.11.22

序号	借款人	担保人	借款银行	担保主债权金额	担保债权起始日	担保债权到期日
6	先锋精科	游利	农业银行	500	2023.4.18	2023.11.22
7	先锋精科	游利	工商银行	900	2023.9.1	2024.8.30
8	先锋精科	游利	工商银行	600	2023.9.15	2024.8.31
9	先锋精科	游利	农业银行	500	2023.11.22	2024.11.21
10	先锋精科	游利	农业银行	500	2023.11.28	2024.11.27
11	先锋精科	游利	农业银行	500	2023.11.28	2024.11.27
12	先锋精科	游利	工商银行	900	2024.8.27	2025.8.26
13	先锋精科	游利	工商银行	600	2024.9.20	2025.9.18
14	先锋精科	游利	招商银行	900	2024.9.29	2025.9.29
15	先锋精科	游利	农业银行	500	2024.11.25	2025.11.20
16	先锋精科	游利	农业银行	500	2024.11.28	2025.11.24
17	先锋精科	游利	农业银行	500	2024.11.28	2025.11.24
18	先锋精科	游利	农业银行	1,000	2025.5.26	2026.5.20
19	先锋精科	游利	农业银行	500	2025.5.26	2026.5.25
20	先锋精科	游利	工商银行	900	2025.8.29	2026.8.27
21	先锋精科	游利	工商银行	600	2025.9.18	2026.9.16

除上述借款合同外，游利还为发行人下列银行授信提供保证担保，担保最高金额为发行人在各授信合同项下的授信额度。

单位：万元

序号	债务人	债权人	授信额度	授信有效期	授信合同编号	担保合同编号	履行情况
1	发行人	招商银行股份有限公司泰州分行	3,500.00	2022.8.30-2023.8.29	2022年授字第210800183号	2022年保字第210800183号	已履行完毕
2	发行人	招商银行股份有限公司泰州分行	3,500.00	2023.9.26-2024.9.25	2023年授字第210800483号	2023年保字第210800483号	已履行完毕
3	发行人	招商银行股份有限公司泰州分行	6,000.00	2024.9.29-2025.9.28	2024年授字第210800583号	2024年保字第210800583号	已履行完毕

(6) 收购关联方资产

2025年1月，公司全资子公司无锡先研与刘国辉、陈艳、李新民签署了《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，约定以人民币1,200.00万元收购上述3名交易对方持有的无锡至辰100.00%的股权。本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，为本公司关联自然人，本次交易构

成关联交易。上述交易的内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2、报告期内与关联方往来余额情况

报告期各期末，公司与关联方的往来款项余额情况具体如下：

（1）应收账款

单位：万元

关联方	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
靖江佳晟	161.67	8.08	104.39	5.22	1.57	0.08

（2）应付账款

单位：万元

关联方	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
靖江佳晟	86.68	598.95	404.28
佳佳精密	37.94	59.14	-
合计	124.62	658.09	404.28

（3）其他应收款

单位：万元

关联方	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
靖江佳晟	30.79	12.35	30.79	7.71	30.79	3.87

（4）租赁负债

单位：万元

关联方	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
靖江佳晟	133.43	210.58	284.16

3、关联交易的必要性及价格的公允性

（1）关联销售

报告期内，发行人向靖江顺希销售的主要为发行人加工生产过程中产生的铝废料，销售价格以长江有色网前一月铝锭的挂牌均价为基础，结合废料的含水含

油量及回收价值等因素由双方协商一致确定，其中含水含油量根据当日的称重量及充分日晒后的称重量对比确定，交易价格公允。

为进一步减少和规范关联交易，截至 2023 年末，发行人已停止向靖江顺希销售废料，相关废料转向无关联第三方回收公司销售。

报告期内，发行人向靖江佳晟提供少量表面处理加工服务，表面处理加工的产品主要为半导体阀门，与公司产品差异较大。2025 年度，由于靖江佳晟自身业务规模扩展较大，其向公司采购的表面处理加工服务金额有所上升，对应的采购价格根据表面处理的面积、需要表面处理区域及工艺类型综合确定，交易价格公允。

（2）关联采购

靖江佳晟、靖江佳仁及佳佳精密系公司外协及定制件供应商，公司将部分精密零部件的初道粗加工工序通过外协加工的形式交由其协助加工，或指定其向公司认证的金属原材料供应商采购原材料进行初道粗加工后，再向其采购加工完成的定制件。上述关联方作为公司所在的靖江市内规模较大、加工能力较为成熟、产品一致性较为稳定的机加工厂商，公司向其采购外协加工服务及定制件，能够提高自身产能利用率和营运资金使用效率，具有合理性。公司外协加工价格根据各细分产品加工所涉及的工序、设备类型、加工工时等因素综合确定。定制件的定价为在原材料价格的基础上增加按照相同标准确定的加工费。报告期内，靖江佳仁、靖江佳晟、佳佳精密为公司销售的加工服务和定制件单价公允，加工单价与其他非关联外协加工厂商使用的同类加工设备的加工单价一致。

报告期内，公司积极开发其他符合加工要求的非关联外协及定制件供应商，并控制向靖江佳晟、靖江佳仁、佳佳精密的外协和定制件采购规模。对于新产品，公司将不再交由关联外协厂进行加工，仅保留现有合作产品的外协加工以保证交期和产品一致性。2024 年度，由于公司业绩增长迅速，向关联方的采购的初道粗加工外协及定制件的金额有所上升，但占当期营业成本的比例仍有所下降。报告期内，公司向靖江佳仁、靖江佳晟、佳佳精密采购的外协和定制件占当期营业成本的比例分别为 1.97%、1.59%和 0.38%，呈下降趋势。

报告期内，公司向大晟航空采购外协加工服务共 1.29 万元，为偶发零星采

购。

报告期内，公司向靖江佳晟支付了租赁厂房所产生的物业费及靖江佳晟代收的水电费。物业费与靖江当地同类厂房价格无较大差异。

(3) 关联租赁

报告期内，公司因现有厂区无法满足持续扩大的生产规模，向关联方靖江佳晟租赁两处库房用于部分工序加工，公司向关联方租赁厂房的不含税单价为 24 元/月/m²（含 6 元/月/m²物业费），与靖江市内其他类似厂房租赁单价不存在显著差异。

(4) 关联担保

报告期内，公司因生产经营规模持续扩大，向银行借款融资，为满足银行融资担保要求，控股股东、实际控制人游利向公司提供了担保。上述融资款项用于公司日常经营。

(5) 收购关联方资产

无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。公司本次收购无锡至辰的目的为进一步增强公司在半导体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量的政策要求。

公司本次交易采用市场法评估标的公司的市场价，通过选取可比案例的市盈率作为估值参数指标，同时综合考虑标的公司的业务财务状况、发展前景及未来盈利能力，结合近期可比交易的价格，遵循公平合理的定价原则，友好协商确定本次交易对价为 1,200.00 万元。本次交易的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

4、关联交易履行的程序合规性

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东会议事规则》《董

事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。就报告期内与关联方发生的交易，发行人均已按照相关法律、法规规定、《公司章程》及其他内部管理制度履行了必要决策程序。

5、独立董事对关联交易发表的独立意见

发行人在《公司章程》《关联交易管理制度》等内部规定中明确了关联交易决策的程序，上述关联交易决策程序为保护中小股东的权益、避免不正当交易提供了适当的法律保障。

报告期内，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，发行人独立董事就关联交易的必要性、关联交易价格的公允性、批准程序的合规性以及减少和规范关联交易措施的有效性发表了事前认可意见和独立意见。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30,401.55	28,750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.57	25,050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5,911.37	5,200.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		78,783.49	75,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于江苏省靖江市斜桥镇，项目总投资额为 30,401.55 万元，拟使用本次募集资金金额为 28,750.00 万元。

本项目旨在通过新建高标准厂房及百级洁净车间、大规模引进多轴联动数控加工中心等先进生产与检测设备，升级真空扩散焊等特种工艺能力，构建更高标准的规模化、自动化、洁净化的精密制造基地，以突破产能瓶颈并满足更高制程对金属加热器等高端器件的严苛需求。

本项目除将重点扩建金属加热器产线外，还将同时配套扩大匀气盘等关键工艺部件产能，以满足下游客户日益紧迫的国产半导体设备突破创新需求。

2、项目实施的必要性

（1）突破现有产能瓶颈，满足下游客户持续增长订单需求

当前，在全球半导体产业链区域化重构和国产化战略深入推进的双重驱动下，国内半导体设备市场呈现出强劲的增长态势。以刻蚀、薄膜沉积为代表的前道核心设备需求持续攀升，拉动了对金属加热器等关键工艺器件的采购需求。公司作为国内少数能够进入主流设备商供应链并实现批量交付的供应商，已与中微公司、北方华创、拓荆科技等行业龙头建立了稳固的合作关系。来自该些战略客户的订单持续、快速增长，公司业务的销售收入从 2023 年的基础量级扩张至 2025 年的 10 亿元以上规模，未来增长预期明确。

随着公司业务规模在持续扩大，现有厂房已无法满足现有工艺需求，部分工艺开始依赖于租赁厂房。在现有设备布局与工艺流程下，租赁厂房的产能潜力已得到充分挖掘，进一步拓展的空间较为有限。目前生产区域内的物料流转与在制品暂存空间已趋近于最大容量，若继续在当前条件下增设设备，对产能提升的边际效应将明显减弱，甚至可能影响现有的生产效率。此外，在租赁场地上进行重大设备投资，始终面临租约到期无法续租、租金上涨或场地被收回的经营不确定性。这种不确定性抑制了公司进行长期、重型资产投资的意愿，影响了生产布局的优化和工艺深化的节奏，从战略上制约了公司的核心竞争力建设。实施本次产能扩建项目，将有效释放公司生产潜能，为现有成熟工艺提供制造土壤。

项目建成后，公司将拥有充足的物理空间与先进产能，不仅能应对现有客户订单的持续增长，更能主动规划并匹配客户未来的扩产节奏与技术升级需求。这将显著提升公司的供应链保障能力与快速响应能力，使公司在与核心客户的战略协同中扮演更为关键的角色。通过产能的规模化与专业化升级，公司将有能力承

接更大规模、更高要求的订单，从而进一步深化与客户的合作层次，从单一产品供应向深度协同研发与系统化解决方案延伸，并为核心业务市场份额的持续提升与公司整体战略目标的实现，提供稳定的产能基础与竞争优势。

(2) 建设高标准洁净车间，应对先进制程严苛环境要求

随着半导体制造技术的持续演进，产业对生产环境与核心器件性能的标准正在进行更高要求的变化。一方面，在先进制程工艺中，即使亚微米级的颗粒污染也可能导致产品缺陷，因此，为核心器件的制造、清洗、装配及测试环节提供百级甚至更高标准的洁净环境，已成为确保终端产品良率与设备运行可靠性的先决条件。另一方面，为满足更高功率密度、更优热匹配及更强耐腐蚀性等需求，新型复合材料开始被引入器件设计，其加工工艺与连接技术，对生产环境的洁净度、温湿度稳定性及防微振控制提出了前所未有的严苛要求。租赁厂房在空气洁净度、温度、湿度等关键环境参数上较难实现升级改造，难以构建和维持稳定的环境。这直接导致涉及的超高纯清洗、表面处理等关键工序无法在公司内部完成，产品洁净度无法达到客户规格，成为获取高端订单的首要障碍。在此背景下，公司现有租赁厂房的局限性，已构成实质性瓶颈。

项目将重点规划并建设符合百级、万级洁净标准的专业化生产车间，并系统性地引入适配新材料、新工艺的特种加工与处理单元。这不仅是对公司现有制造能力的一次升级，更是构建面向未来的核心竞争力。通过建设高标准洁净制造环境，公司将能够确保其产品洁净度、材料性能与可靠性等维度满足更加严苛规范。此举将使公司有能力参与客户关键核心零部件的同步设计与迭代，从源头确立技术协同优势。这不仅能够巩固与现有战略客户的合作黏性，更能提升公司在高端市场的品牌形象与技术声誉，为开拓更广阔的半导体先进制程器件市场奠定坚实的基础，最终将技术门槛转化为可持续的行业领导力与市场份额。

(3) 规模化生产与管理升级，提升整体运营效率

当前，公司业务已进入规模化、高质量增长的关键阶段。然而，现有的分散式生产布局，在物料流转、生产协同、环境管控及管理精细化等方面逐渐暴露出瓶颈，制约了运营效率的进一步提升与规模效应的充分发挥。

项目通过新建集中式厂房，将目前分散的各项工序进行一体化布局。这种集

约化的设计，将从根本上优化内部物流路径，为推行精益生产和标准化作业提供理想的物理空间基础。为生产计划的顺畅执行、设备的高效协同以及生产过程的透明化管理创造了前提条件。

项目将引入自动化加工与检测单元。在扩大产能规模的过程中，公司并非进行简单的设备数量叠加，而是致力于推动生产模式的转型。这不仅能显著提升关键设备的综合利用率，降低单位产出对直接人工的依赖与干预，更能有效减少人为差错，提升生产效率，使大规模生产下的质量与成本控制成为可能。

本项目通过产能的集中化建设、生产过程的自动化升级与运营管理的数字化赋能，将构建一个高效、可控的现代化制造体系。该体系将直接支撑公司在业务规模扩张过程中，实现运营效率的持续提升、产品质量的稳定可靠以及综合成本的优化控制，形成可持续的规模化竞争优势。

3、项目实施的可行性

(1) 契合产业链安全的战略导向

半导体金属器件作为高端装备、新能源、电子信息等战略性新兴产业的核心器件，其自主化水平直接关系到产业链供应链安全稳定，因此我国积极推动产业链安全、制造业高质量发展、强化基础工业能力、以及攻克关键领域核心技术的国家战略导向。

2016年12月，由国家发展改革委同科技部、工信部、财政部等部门牵头编制的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将夯实工业基础、突破核心环节作为战略性新兴产业发展的重要支撑，推动核心器件技术攻关与供给能力提升，为半导体金属器件产业发展提供了战略指引；2021年12月由工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、科技部等八个部门联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出攻克基础技术与核心器件瓶颈，支持核心器件研发与产能扩张；2025年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》进一步明确“十五五”期间（2026-2030）集成电路产业发展目标：关键半导体设备国产化率突破70%。

一系列政策密集出台，明确了产业发展的战略定位，为半导体金属器件产业提供了全方位保障，本项目专注于半导体先进制程金属器件的研发与生产，与国

家的战略导向高度契合，符合公司的发展规划与长期目标。

（2）具有成熟完备的工艺体系，明确技术升级路线

公司深耕半导体金属器件制造领域多年，已构建起覆盖原材料加工、精密加工、表面处理、焊接等全流程的成熟工艺体系，核心制造环节历经长期产业化验证与持续优化，形成了兼具稳定性与可靠性的工艺标准。在半导体关键金属器件生产中，公司积累了扎实的量产经验，能够确保产品在精度、性能等关键指标上的一致性与稳定性，为规模化生产奠定了实践基础。

依托长期的技术沉淀，公司在关键工艺环节形成了显著优势，实现了生产流程实时跟踪与追溯，通过节点管理缩短制造周期，提高交付效率。针对金属器件的精密加工需求，公司有自主优化的成型工艺与焊接技术，是国内较早通过美国焊接学会（AWS）认证的焊接制造商（CWF），能够有效解决复杂结构件的精度控制难题，确保产品在严苛工况下的稳定运行；在表面处理环节，通过持续迭代的工艺方案，大幅提升了产品的耐磨性、耐腐蚀性与使用寿命，可灵活适配不同应用场景的高端需求，核心工艺经过长期实践检验，规避了基础工艺探索带来的技术不确定性，成为本次产能扩建的核心技术支撑。

公司持续跟踪行业技术发展趋势，聚焦产品性能提升与工艺优化，本次产能扩建并非全新技术的探索性应用，而是在现有成熟工艺平台上的规模扩大与精准升级，重点围绕现有产品的产能释放、高端产品的工艺迭代以及生产效率的优化提升展开，而非技术原理的未知性挑战。公司在工艺管控、生产组织等方面的丰富经验，以及完善的技术体系，能够有效保障本项目生产线扩增的顺利过渡与更新升级，实施风险总体可控。

（3）稳定的客户资源，为项目建立坚实市场基础

公司深耕国内半导体设备精密制造领域，经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。公司自设立时起即伴随中微公司、北方华创、拓荆科技等国产半导体设备龙头企业共同成长，深度参与客户多款先进设备的研发、定型和迭代升级。半导体高端装备奉行严格复制信条，即客户要求严格复制已经确立的工艺标准，基于此，公司与中国本土装备龙头企业的长期稳定合作形成了深厚的信任基础，建立了与客户协同迭代开发的持续反馈机制。

同时，公司较早确立了陪伴国内半导体设备厂商成长的经营理念，在半导体设备产业链安全的国产化浪潮中具有先发优势，伴随国产半导体设备需求量的提升，公司的业绩成长确定性较强。公司凭借稳定的产品性能、精准的技术适配能力及高效的供应链响应速度，已与国内多家主流半导体设备制造商建立起长期稳固的战略合作关系，形成了结构合理、粘性较强的核心客户群体。这一合作体系是基于多年来在产品质量管控、技术协同创新、交付周期保障等多方面的持续投入与验证，双方构建起互信共赢的长期合作机制，为市场需求的稳定性提供了核心支撑。

当前半导体设备行业正处于技术迭代加速与产能扩张的关键阶段，公司核心客户均在推进高端制程设备的研发与量产，同时持续扩大产能规模以满足下游芯片制造行业的增长需求。半导体金属器件作为半导体设备的核心功能组件，其性能直接影响设备的运行精度与稳定性，是客户产能扩张与技术升级过程中不可或缺的关键配套。未来 3-5 年，客户需求增长趋势清晰、采购意向稳定，长期合作形成的需求预判机制为项目新增产能提供了直接且可靠的市场出口，也为项目经济效益的稳步实现提供了保障。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 30,401.55 万元，拟使用募集资金投入金额为 28,750.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	18,160.78	17,600.00
2	设备及软硬件投入	9,348.30	9,000.00
3	项目预备费	507.96	550.00
4	铺底流动资金	2,384.51	1,600.00
合计		30,401.55	28,750.00

5、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益。项目建成达产后预估年均营业收入 37,284.89 万元，年均净利润 8,410.95 万元，年均毛利率为 40.62%，年均净利率为 22.60%。项目预计税后内部收益率为 16.65%，税后静态投资回收期为 6.48 年。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

(1) 营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 39,176.55 万元。

(2) 营业成本及费用测算

本项目的产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料参考各产品材料采购成本计算；人工成本按项目计算期需用员工人数及公司目前员工薪酬水平进行估算；制造费用中，固定资产按年限平均法直线折旧，无形资产按年限平均法直线摊销，其他费用按照销售收入的一定比例测算。

(3) 税金及附加

本项目增值税税率 9%、13%；城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；实施主体所得税率 15%。

7、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2026〕22号）。

(二) 半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于江苏省靖江市斜桥镇罗家村、柏一村（新兴路以北、新泰路以西、新旺路以南地块），项目总投资额为 26,470.57 万元，拟使用本次募集资金金额为 25,050.00 万元。

本项目中，公司将基于自身在半导体设备精密零部件及高端器件领域多年的技术积累，结合半导体行业向先进制程演进及核心部件突破创新的发展趋势，对半导体先进制程非金属材料及器件开展研发及产业化。项目建设有利于公司打破

国外技术垄断、完善产品布局、提升在细分市场的竞争力与占有率。

2、项目实施的必要性

(1) 填补国内缺口，提升公司细分领域市场地位

半导体先进制程非金属材料及器件，特别是陶瓷加热器，是半导体设备中实现高温、高均匀性的核心关键器件。其性能直接决定了薄膜沉积、刻蚀等关键工艺中的温度精度、能耗效率与长期运行可靠性。长期以来，该领域的高端市场被日本、美国等国际少数巨头所垄断，国内设备厂商严重依赖进口，这不仅带来高昂的采购成本与漫长的供应周期，更构成了半导体产业链安全战略中突出的关键环节。随着国内半导体设备行业的加速突破，下游龙头客户对于实现此类高性能陶瓷器件国产化、保障供应链安全与技术自主的需求已变得极为明确和紧迫。

在此背景下，国内具备量产能力并得到行业认可的供应商极为稀缺，市场存在显著的供给缺口。这为公司切入该赛道、确立先发优势提供了机遇。因此，实施本半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目，其核心战略意义在于填补国内在该领域的产能缺口。

本项目是对已明确存在的国内半导体核心功能器件需求的直接响应。通过项目建设形成规模化的半导体先进制程非金属材料及器件供应能力，公司将能解决下游战略客户的痛点，从当前金属器件供应商升级为覆盖金属与陶瓷两大核心材料体系的半导体关键器件供应商。成功实施本项目，意味着公司将在国内半导体设备产业链中，占据一个技术壁垒更高、附加值更大、竞争格局更优的位置，从而根本性地提升公司在细分领域的市场地位。

(2) 开辟全新增长曲线，优化公司产品与盈利结构

当前，半导体制造技术向先进制程的快速演进，对设备核心模块的性能与集成度提出了系统性升级要求。半导体功能器件（如陶瓷加热器）具备独立、完整的物理功能与电气特性，是直接决定设备工艺性能的核心模块，其技术壁垒与附加值远高于基础结构件。然而，此类高端功能器件市场目前主要由少数国际厂商主导，是我国半导体产业链安全的关键短板之一。

公司长期深耕半导体设备金属零部件制造，已建立稳固的市场地位和成熟的工艺体系。但单一依赖金属零部件产品，使公司业务结构与盈利能力面临瓶颈，

难以充分适应下游技术快速迭代和材料升级的趋势。实施本半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目，是公司主动进行战略扩张的关键举措。本项目旨在将公司的核心制造能力，从成熟的金属器件领域，拓展至技术壁垒更高、附加值更大的半导体先进制程非金属材料及器件领域。

通过本项目的建设，公司将构建国内稀缺的半导体先进制程非金属材料及器件全流程量产能力，实现产品矩阵从金属到非金属的重要扩充。这不仅能够直接响应下游客户对先进制程装备的迫切需求，更能为公司开辟一条极具成长潜力的全新业务增长曲线。项目成功实施后，公司将形成金属与非金属材料并重的产品格局，显著优化产品结构，提升整体解决方案能力。同时，半导体先进制程非金属材料通常享有更高的毛利率，其规模化生产将有力提高公司的盈利能力，增强抗风险能力。因此，本项目是公司优化业务布局、提升综合竞争力的重要战略步骤。

(3) 适配更高阶的工艺控制需求，满足公司战略发展需要

半导体设备技术的快速迭代，对相关功能器件的制造环境与工艺控制提出了极为严苛的要求。当前，全球半导体产业持续扩张，下游市场对高性能、高可靠性器件的需求规模迅速增长，为公司带来了重要的战略机遇。然而，公司现有生产场地的物理空间与环境控制能力存在一定限制，无法建设和维护高规格生产环境，也难以针对新一代半导体材料加工进行大规模、专用化的产线布局与工艺深化。

现有场地在环境参数的精准与稳定控制方面存在根本性瓶颈，难以满足高端制造对关键指标的长期稳定要求。这导致部分关键工序无法在内部完成，产品性能难以达到高端客户规格，成为公司获取高端市场份额的核心障碍。同时，对于需要部署大型专用设备及独立环境控制单元的新材料工艺研发与量产线，现有空间布局已无法容纳，严重制约了公司工艺能力的纵向拓展。

为把握下游市场规模增长带来的机遇，并满足客户对器件性能高阶要求，公司必须构建具备高阶工艺控制能力的制造基地。本项目的实施，旨在通过建设高标准生产设施，突破上述发展制约。项目将规划建设满足高阶环境控制要求的各类洁净加工与装配区域，并配套引入面向新一代材料与精密制造的关键工艺装

备，构建起支持未来技术迭代的先进工艺平台。

本项目直接响应了下游市场对产品技术指标的持续提升需求，通过建立先进制造能力，不仅能巩固与现有战略客户的合作，更有助于切入高端市场，服务更广泛的客户群体。建设一个具备高阶工艺控制标准的制造基地，是公司突破当前发展瓶颈的必然选择。本项目通过提供与之相适应的硬件设施与工艺平台，将为公司巩固行业领先地位奠定坚实基础。

3、项目实施的可行性

(1) 拥有扎实的技术储备，为项目实施构筑稳固技术根基

公司已在半导体先进制程非金属材料及器件领域完成了系统性、前瞻性的技术布局与研发储备，形成了覆盖“材料-工艺-装备-测试”的完整技术链，为本项目的产业化落地构筑了坚实的根基。

在材料体系与核心工艺方面，公司已深度介入氮化铝陶瓷的研发全流程。根据已有研发项目，公司明确了以粉末冶金为核心的技术路线，对 AlN 原料粉末选型与造粒、常压/热压烧结等关键工艺环节进行了专项技术攻关规划，旨在实现高导热率、低烧结变形的高性能半导体先进制程非金属材料及器件制备。针对加热器核心结构，公司已开展多层加热盘埋丝设计与热压成形、陶瓷粘接剂配方开发以及高温热压接合等先进工艺研究，以解决内部介质层均匀性、气密性及连接可靠性等技术难点。

在专用技术与装备层面，公司基于研发和生产目标，已规划了覆盖全工艺流程的专用设备方案，包括球磨、喷雾造粒、干袋压机、热压接合炉及各类精密加工与检测设备。

公司对半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目的技术攻坚已形成系统性的设计、清晰的工艺路线图和具体的研发行动计划。扎实的前期工作与技术储备，确保了本项目能够从一个目标明确、路径清晰的研发状态，高效有序地过渡到规模化量产，显著降低了技术不确定性带来的产业化风险。

(2) 利用现有客户渠道资源，缩短新产品市场导入周期

公司在半导体设备领域长期深耕，已与国内龙头半导体设备制造商建立了稳

定深入的战略合作关系，并已进入其核心供应链体系。这一成熟的客户基础与销售渠道，为非金属材料及器件新产品的市场导入提供了优势，能显著缩短市场开拓周期，降低推广成本。

公司现有客户正是国产半导体先进制程设备的主要研发与生产者，其对更高性能、更高可靠性的半导体先进制程非金属材料及器件有明确且迫切的需求。公司的新产品研发方向直接响应了客户设备升级需求，市场对接精准，无需从零开始培育客户。凭借在半导体设备领域长期合作所建立的品质信誉，新产品可以借助现有合作关系，更顺畅地与客户对接。公司对客户的采购标准有深刻理解，能够更有针对性地进行产品开发与验证，从而加速样品测试、小批量试用直至批量供应的全过程。

半导体先进制程非金属材料及器件与现有产品在部分设备中属于配套关系。公司可利用现有产品线提供整体解决方案，增强客户黏性，同时带动新产品的销售。客户也更倾向于向已证明可靠性的一级供应商采购新品类产品，以降低供应链管理复杂度与风险。本项目并非面向陌生市场进行开拓，而是对现有客户需求的价值延伸。现有客户资源将成为新产品快速实现市场突破、形成初始销售规模的最有力保障，极大地提高了项目的市场成功率和投资回报确定性。

(3) 具备高层次技术团队，为工艺优化与量产建立人才基础

本项目的成功实施与后续高效量产，高度依赖于一支具备深厚理论功底与工程实践经验的技术团队。公司已前瞻性地围绕陶半导体先进制程非金属材料及器件这一战略方向，构建了一支结构合理、专业覆盖完整的核心技术队伍。这支团队是确保前沿技术从实验室成功走向产业化、并实现持续工艺优化与稳定量产的关键保障。

团队构成具备显著的跨学科优势，与项目技术链条高度匹配。根据研发团队组织架构，核心成员的专业背景精准覆盖了从材料科学到精密制造的完整价值链。这种多元化的知识结构，使得团队能够深入理解并协同攻关半导体先进制程非金属材料及器件涉及的一系列复杂且相互关联的工艺环节。这种深度交叉融合的能力，是解决关键工艺难题不可或缺的基础。

公司已建立起体系化的研发管理机制与高效的技术攻关能力，完成了陶瓷加

热器项目的正式立项与资源规划，其中部分产品已完成小试并投入小批量生产。该计划明确了包括材料制备、成型烧结、特种连接、性能测试等在内的数十项标志性技术节点，体现了公司对技术实现路径的深刻理解与周密部署。公司能够围绕明确的技术节点，调配各部门相关资源，确保攻关任务的有序推进。在项目执行中，公司建立了职责清晰、协同高效的工作模式，由核心技术人员牵头各关键技术环节，辅以多职能团队的支持，形成了目标导向、权责分明的协作体系。

公司现有的高层次、跨领域技术团队，是项目从技术研发成功跨越至产业化成功的核心保障。他们的专业知识与工程实现能力，将确保项目在后续的过程中，能够有效应对挑战，实现快速稳健的产业化目标。

4、项目投资概算

项目总投资额为 26,470.57 万元，拟使用本次募集资金金额为 25,050.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	11,701.03	11,000.00
2	设备及软硬件投入	12,000.00	12,000.00
3	项目预备费	493.13	450.00
4	铺底流动资金	2,276.41	1,600.00
合计		26,470.57	25,050.00

5、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益。项目建成达产后预估年均营业收入 34,991.70 万元，年均净利润 8,613.07 万元，年均毛利率为 42.89%，年均净利率为 24.62%。项目预计税后内部收益率为 24.22%，税后静态投资回收期为 6.00 年。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

(1) 营业收入预计

本项目营业收入的测算系以市场调研销售单价为基础，结合未来发展趋势，及各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 36,064.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目的产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用。由于公司相关产品尚未量产，上述产品成本细分科目采用同行业可比公司相关数据作为测算依据。

除营业成本外的其他费用中，销售费用、管理费用采用报告期内发行人自身费用占比平均值，考虑到本项目产品尚未大规模量产，谨慎考虑，研发费用采用高于报告期内费用占比平均值、按 6% 测算。

（3）税金及附加

本项目境内主体按照增值税税率 9%、13%；城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；所得税率 15%。

7、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2026〕22号）。

（三）半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为江苏先锋精密科技股份有限公司，建设地点位于中国江苏省靖江市斜桥镇罗家村、柏一村（新兴路以北、新泰路以西、新旺路以南地块），项目总投资额为 5,911.37 万元，拟使用本次募集资金金额为 5,200.00 万元。

公司将围绕高性能介电层陶瓷材料精密烧结、微纳电极图案化制备、异质材料高可靠连接、多区精准温控等核心技术难点，开展全链条技术攻关与产品研制，实现陶瓷基板孔隙率低于 0.01%（4N 及以上）的精密烧结工艺、高精度图案化设计以均匀分布电场，同时达到陶瓷介电层、电极层及基底层等异质材料层间在严苛热循环下的高可靠、低热阻连接，开发出超 100 温区的分区温控技术。项目实施将有助于填补国内高端陶瓷静电吸盘供应空白，推动半导体设备产业链安全进程，进一步巩固公司在半导体核心零部件领域的领先地位。

2、项目实施的必要性

（1）有利于突破关键技术壁垒，提升公司自主创新能力

静电吸盘（ESC）作为半导体刻蚀与薄膜沉积设备中固定、控温及传导射频信号的核心部件，其技术性能直接决定先进制程工艺的精度与稳定性，属于我国半导体设备产业链中亟待突破的关键环节。当前，全球半导体制造正加速向 7nm 及更先进制程演进，对静电吸盘的精度、可靠性及耐等离子体腐蚀性能提出了近乎苛刻的要求，国内高端市场长期被海外厂商垄断，已成为制约国产设备竞争力与产业链安全的突出短板。因此，攻克并掌握静电吸盘的自主设计与制造技术，是公司直面行业最严峻挑战、履行产业链核心企业责任的必然选择。

同时，伴随下游半导体设备国产化进程的加速与深入，国产供应链正从工艺部件、结构部件等外围部件向静电吸盘、射频电源等核心子系统深化，这一趋势对从业企业的技术纵深、跨学科研发能力及与主机设备的协同创新提出了前所未有的更高要求，企业必须在巩固现有精密制造优势的基础上，向材料科学、静电学、热力学及先进陶瓷工艺等前沿领域进行战略性拓展，实现从“制造”到“创造”、从“配合研发”到“定义系统”、从“跟跑”到“并跑”的能力跃迁。本项目正是公司为应对这一根本性挑战，通过集中资源攻克最尖端瓶颈，从而推动自身研发体系升级、构建技术护城河的关键举措。

目前，公司凭借在半导体设备精密零部件领域深耕多年的技术积累，已成为国内领先的设备厂商的核心供应商，本研发项目建成后，公司将系统构建静电吸盘从设计仿真、材料制备到精密加工、测试验证的全链条自主能力，显著提升公司在跨学科技术融合、原始创新与系统集成方面的核心能力，从而将公司的创新水平推升至新高度，为抢占下一代半导体设备技术制高点、开拓更广阔的战略市场奠定坚实基础。

（2）有利于攻克核心部件技术壁垒，巩固公司技术领先优势

静电吸盘的研发，是公司主动响应并引领半导体设备精密零部件领域深刻技术变革的战略举措，是面向产业核心瓶颈的一次前瞻性战略卡位，是规避未来技术断层风险、构筑长期竞争优势的必要举措。

当前，下游应用领域对核心部件的性能要求正经历根本性提升，具体体现在

对产品的高洁净度、超强耐腐蚀能力、高可靠性与长使用寿命等综合性指标的极致追求上，这些需求迭代的速度远超传统产品。若不及早布局静电吸盘这类必需功能部件的自主研发与突破，将无法参与未来高端市场的竞争，这意味着，一旦客户工艺向更先进节点迈进，公司将难以应对客户快速升级的工艺要求，可能面临核心技术供给与市场需求脱节的风险，现有技术领先地位将被削弱。

同时，静电吸盘的技术能力是打开未来高价值功能器件市场的“钥匙”，代表超精密、高可靠的技术体系，其应用场景正从集成电路制造快速向第三代半导体、高端显示面板、先进光伏以及半导体高端封装等更为广阔的泛半导体领域扩展，这些新兴领域对精密控温与静电吸附解决方案有着明确而迫切的需求，项目的实施，掌握进入新兴战略市场的核心技术能力，从而为公司开辟全新的增长轨道。

通过本项目的实施，公司将系统性地整合研发资源，针对高性能材料、精密加工工艺、极端环境耐受性等关键技术瓶颈进行集中攻关，驱动公司建立起能够持续应对下一代技术挑战的、动态演进的核心技术平台，确保公司技术路线与行业演进方向同步，从而在未来竞争格局中占据领先地位。

(3) 有利于优化产品盈利结构，提升公司核心价值

实施静电吸盘研发项目，是公司突向高附加值核心功能部件领域进行战略性延伸的关键一步，对于从根本上优化产品与利润结构、提升公司在产业链中的核心价值地位具有决定性意义，当前，公司产品虽已覆盖半导体设备关键工艺部件领域并获认可，但产品附加值和技术壁垒存在提升空间。随着市场竞争加剧及成本压力传导，单一依靠扩大规模或成本控制的盈利模式可持续性面临挑战。相比之下，静电吸盘作为直接决定设备工艺性能的核心子系统，其技术密集、研发驱动、客户粘性强的特点，决定了其具有远高于普通结构件的毛利率和市场定价权。

静电吸盘的产业化意味着由核心技术驱动的高毛利产品占比将获得显著提升，这将有效增强公司盈利的稳定性和抗周期性，减少对中低附加值产品市场的依赖。同时，掌握静电吸盘这一核心部件技术，将使公司从设备制造商的供应商升级为不可或缺的技术合作伙伴，从而在商业谈判、价值分配中占据更有利地位，提升整体盈利能力。

一家拥有高端核心部件自主研发能力、且该部件具备稀缺属性的企业，将获得更高的技术估值和品牌溢价。通过本项目构建的完整研发与量产体系，不仅能直接贡献利润，更能作为强大的技术平台，支撑未来系列化高端功能部件的快速孵化，形成持续的价值增长曲线。因此，本项目是公司优化短期财务结构、布局长期价值增长的战略性投资，将有力驱动公司从一家优秀的精密制造企业，向引领细分领域技术方向、定义市场标准的平台型科技公司跃迁。

3、项目实施的可行性

(1) 符合国家前沿技术攻关与未来产业发展导向

半导体设备及其核心精密零部件是支撑信息技术产业发展的基石，属于国家战略性高科技产业的关键环节，其技术水平直接关系到产业链的安全与竞争力。当前，全球科技竞争日益聚焦于前沿技术与高端制造能力，而静电吸盘作为半导体制造设备中晶圆处理的核心部件，推动此类核心基础部件的突破，不仅是产业发展的内在需求，更是响应国家战略号召、把握未来产业发展主动权的必然选择。

我国高度重视制造业特别是高端装备与核心技术的自主创新与发展。2015年，国务院明确提出将“创新驱动”置于制造业发展全局的核心位置，强调要“强化工业基础能力”，攻克一批关键共性技术与核心基础部件；同时，国家持续通过《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策工具，明确将“集成电路装备”及其关键零部件列为鼓励发展的重点领域，引导社会资源投向产业短板环节；此外，为全面提升产业竞争力，国家多部委联合推动《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》，特别指出要在“关键原材料、基础零部件、电子元器件”等基础领域实现质量可靠性突破，打造精品装备，这些顶层设计共同构成了以创新为动力、以基础能力为支撑、以质量品牌为目标的产业发展政策体系。

本项目的实施精准对接了国家战略导向，项目致力于攻克半导体设备领域的一项关键零部件，直接服务于提升我国集成电路装备的自主化水平与产业链安全性，属于国家明确鼓励和支持的前沿技术攻关范畴，是顺应国家前沿技术攻关与未来产业发展方向的战略性投资，将为公司赢得宝贵的发展机遇和广阔的政策空间。

(2) 专业团队与客户协同验证为项目提供保障

本研发项目的实施,有公司内部长期积淀的专业技术团队作为核心驱动力和坚定保障,同时拥有与头部设备厂商深度绑定的验证机制,这共同构成了项目成功推进的坚实基础与独特优势。公司已构建了一支涵项目管理的核心团队,该团队由具备多年行业背景的资深专家领衔,成员覆盖战略规划、产品设计、先进制造、测试验证及产业化管理全链条,团队核心管理人员拥有成功主导复杂精密部件从研发到规模量产的全过程经验,深刻理解半导体设备行业的质量体系与供应链管理要求,能够确保项目在技术路径、资源调配与风险控制上高效协同。

公司主要客户现已覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、华海清科、拓荆科技、屹唐股份等知名半导体产业链厂商,长期陪伴国产半导体设备厂商发展、紧密配套,作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程,确保静电吸盘的研发方向始终与客户最前沿的工艺需求及设备升级路径紧密对齐。通过客户提供的产线测试机会和验证反馈通道,项目团队能够对原型设计进行快速迭代与优化,在真实应用场景中完成性能标定与工艺适配。

这种研发与市场无缝对接、创新与验证同步进行的闭环机制,极大地压缩了产品开发周期,显著提升了技术方案的成熟度与产业化成功率,为项目攻克工程化难题并最终实现商业落地提供了至关重要的双重保障。

(3) 公司深厚的技术积淀为项目实施提供坚实基础

公司在半导体设备精密零部件领域长达十余年的专注深耕,已构建了完整且被行业验证的技术研发与制造体系,这为本项目的成功实施提供了坚实可靠的技术底层支撑。公司持续保持高强度的研发投入,近三年研发投入复合增长率超25%,并建立了“江苏省基于5纳米芯片工艺刻蚀设备PM模块工程研究中心”等省级创新平台。

经过多年自主研发,公司具备了金属零部件精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、高性能陶瓷制备及精加工技术和定制化工装开发技术等多项领先技术开发体系。截至2025年12月31日,公司各项精密制造技术已形成129项获批专利,其中发明专利38项、实用新型91项,

全部应用于公司主营业务。公司凭借这些技术积累，已成为国内极少数能够量产供应 7 纳米及以下先进工艺刻蚀设备关键零部件的制造商，其产品在北京华创、中微公司等龙头企业的核心设备中实现了长期稳定可靠的应用验证。

这种从基础工艺到复杂系统件、从技术开发到规模化量产的完整能力闭环，特别是公司在应对极端洁净、高精度、耐等离子体腐蚀等严苛工况方面所积累的独到工艺诀窍和庞大的工程数据库，为静电吸盘这类涉及多学科、多工艺集成的超精密核心部件的自主研发，扫清了从材料选型、结构设计到工艺实现路径上的大量不确定性，确保了项目能够基于可靠的技术起点向更高的创新目标迈进。

4、项目投资概算

项目总投资额为 5,911.37 万元，拟使用本次募集资金金额为 5,200.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额
1	工程建设投资	627.00	550.00
2	设备及软硬件投入	3,590.00	3,500.00
3	研发投入	1,267.57	1,100.00
4	工装开发费用	355.00	-
5	项目预备费	71.80	50.00
合计		5,911.37	5,200.00

5、项目经济效益分析

本项目为研发类项目，不适用项目经济效益分析。

6、项目备案、环评情况

本项目的备案手续已完成，并取得备案证“靖数备〔2026〕339号”。

本项目的环评批复已完成，并取得关于《江苏先锋精密科技股份有限公司先锋精科半导体先进制程核心工艺器件研发制造项目环境影知响报告表的批复》（泰环审（靖江）〔2026〕22号）。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

公司作为半导体设备核心精密零部件领域的领军企业，致力于以核心精密制造技术推动半导体产业国产化进程。公司主要产品为半导体设备核心精密零部件，根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务归属于“2 高端装备制造产业”，聚焦半导体专用设备核心零部件领域，属于国家重点支持的国产化范畴。

本次募投项目“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”，系公司对现有优势产品的升级迭代与产能扩充，核心目的为顺应下游半导体设备扩产及先进制程技术迭代的行业趋势，进一步完善公司在半导体核心零部件领域的产品布局，精准匹配下游半导体设备厂商及晶圆厂的核心需求，巩固并提升公司在金属加热器领域的国内领先地位，满足成熟制程及先进制程对高可靠性加热部件的批量供应需求。

本次募投项目“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”，聚焦陶瓷加热器的关键技术攻关、核心组件研发及规模化生产，重点突破高纯度氮化铝粉体合成、薄膜电路共烧等核心技术壁垒。该项目的实施，有助于提升公司在半导体高端加热部件领域的核心竞争力，加速陶瓷加热器的国产化进程，打破国外厂商在高端领域的垄断格局，保障我国半导体产业链供应链安全。半导体专用设备核心零部件制造行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，陶瓷加热器作为薄膜沉积等高精度工艺的核心关键部件，是半导体先进制程实现突破的重要支撑。

本次募投项目“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”，围绕半导体静电吸盘核心技术开展系统性攻关，重点聚焦氮化铝陶瓷基底制备、耐等离子体涂层、高压静电控制等关键技术环节，推进核心部件研发及整机组件研制。该项目的实施，有助于推动国产化静电吸盘方案落地应用，打破国外厂商在高端静电吸盘领域的技术垄断，实现核心零部件产业链安全与降本增效，同时满足先进制程对晶圆固定、精准温控的严苛技术要求，拓展半导体先进制程核心零部件的应用场景，

助力我国半导体产业链实现自主安全发展。

综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向，均围绕科技创新领域开展，聚焦半导体设备核心精密零部件关键技术突破与产能升级，符合《注册管理办法》第十二条的相关规定。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

半导体设备核心精密零部件行业属于典型的科技创新型产业，核心技术的积累及持续的技术创新能力，是企业掌握核心竞争优势的关键因素。将精密制造技术、材料技术与半导体工艺深度融合，应用于刻蚀、薄膜沉积等半导体核心制程场景，需在精密机械制造、材料科学、表面处理、加热电路集成、静电夹持技术、真空密封技术等多个领域积累大量核心技术，跨越机械、材料、电子、半导体等多个学科领域，对生产厂商的技术水平、工艺积累提出了极高要求，尤其是先进制程对零部件的精度、可靠性、耐腐蚀性等指标要求更为苛刻。

公司自成立以来，始终高度重视自主创新，持续提升公司技术及产品的核心竞争力。经过十余年的持续研发与深度深耕，公司在半导体核心精密零部件核心技术的关键领域实现多项技术突破，构建了精密机械制造、表面处理、焊接、高端器件设计开发、高性能陶瓷制备及精加工技术及定制化工装开发等六大核心技术体系，部分产品已批量应用于 7nm 芯片生产线。

本次募投项目的实施，将助力公司将核心技术深度应用于丰富的半导体客户场景及广泛的下游制程领域，针对先进制程需求，持续对金属加热器、陶瓷加热器、半导体静电吸盘等核心产品进行升级迭代，精准把握下游半导体设备厂商及晶圆厂的核心需求，进一步突破高端产品技术壁垒，完善核心技术体系，巩固公司核心竞争力，推动公司从单一金属零部件供应商向“金属及非金属材料+关键功能器件”一体化解决方案提供商的战略转型，助力半导体核心零部件国产化进程加速推进。

四、本次募集资金投资项目的资本化情况

本次募投项目的资本性支出及非资本性支出具体构成如下所示：

单位：万元、%

项目名称	序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：资本性投入

项目名称	序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额	是否属于资本性支出	其中：资本性投入
半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	1	工程建设投资	18,160.78	17,600.00	是	17,600.00
	2	设备及软硬件投入	9,348.30	9,000.00	是	9,000.00
	3	项目预备费	550.18	550.00	否	-
	4	铺底流动资金	2,342.29	1,600.00	否	-
	小计		30,401.55	28,750.00	-	26,600.00
半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	1	工程建设投资	11,701.03	11,000.00	是	11,000.00
	2	设备及软硬件投入	12,000.00	12,000.00	是	12,000.00
	3	项目预备费	493.13	450.00	否	-
	4	铺底流动资金	2,276.41	1,600.00	否	-
	小计		26,470.57	25,050.00	-	23,000.00
半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	1	工程建设投资	627.00	550.00	是	550.00
	2	设备及软硬件投入	3,590.00	3,500.00	是	3,500.00
	3	研发投入	1,267.57	1,100.00	否	-
	4	工装开发费用	355.00	-	否	-
	5	项目预备费	71.80	50.00	否	-
	小计		5,911.37	5,200.00	-	4,050.00
补充流动资金项目	1	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	否	-
募投项目合计	非资本性支出合计		21,350.00			
	非资本性支出占比		28.47			

由上表可见，公司本次募投项目中非资本性支出为 21,350.00 万元，占本次发行拟使用募集资金总额的 28.47%，符合不超过 30% 的规定。

第八节 前次募集资金的使用情况

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金及到账时间

2024年9月25日，中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325号）批准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股，增加注册资本人民币50,595,000.00元。截至2024年12月6日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）50,595,000股，发行价格11.29元/股，募集资金总额为571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币24,720,154.08元，募集资金净额为人民币512,224,342.92元，其中注册资本人民币50,595,000.00元，资本溢价人民币461,629,342.92元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZA14483号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

除此以外，公司近五年内没有通过增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序等方式募集资金。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，公司公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	初始存放金额 (注1)	截止日余额 (注2)
江苏先锋精密科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800378	536,944,497.00	190,858.11
江苏先锋精密科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司靖江支行	403020100100219459		14,819.65
江苏先锋精密科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江城城南支行	10220401040019030		4,272,124.92
江苏先锋精密	中国工商银行股	1115120129300811337		1,213,081.68

单位名称	银行名称	账号	初始存放金额 (注1)	截止日余额 (注2)
科技股份有限公司	份有限公司靖江支行			
无锡先研新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司靖江支行	523901886410008		53,956,424.78
无锡先研新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800254		40,594,081.18
合计			536,944,497.00	100,241,390.32

注1：公开发行股票募集资金总额为571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收到的募集资金为536,944,497.00元，扣除其他发行费用人民币24,720,154.08元，实际募集资金净额为人民币512,224,342.92元。

注2：募集资金账户截止日余额中不包括未到期定期存款的5,000.00万元，尚未使用的募集资金余额150,241,390.32元。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至2026年3月31日，公司首次公开发行A股股票的募集资金使用进度如下：

单位：万元、%

投资项目			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	16,377.10	14,290.88	8,928.88	-5,362.00	2027.06.30
2	无锡先研设备模组生产与装配基地项目	无锡先研设备模组生产与装配基地项目	25,362.70	22,131.84	16,907.65	-5,224.19	2027.12.31
3	无锡先研精密制造技术研发中心项目	无锡先研精密制造技术研发中心项目	7,465.26	6,514.29	2,385.64	-4,128.65	2027.12.31
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	9,494.94	8,285.42	8,335.56	50.14	不适用
合计			58,700.00	51,222.43	36,557.73	-14,664.70	
实际投资金额比例							71.37

（二）前次募集资金的变更情况

公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资

金专户的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路 21 号-1）变更为靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江经济技术开发区新兴路 6 号、靖江经济开发区新太路 1 号、靖江经济开发区新兴路 9 号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 4 号库、5 号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路 6 号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

前次募集资金变更主要系根据公司战略规划增加实施主体、增加或变更实施

地点、调整内部投资结构等，相关变更均及时履行了内部审议程序及信息披露义务，不存在前次募集资金用途发生变更或项目延期的情况。

（三）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止 2025 年 1 月 15 日，自筹资金累计投入 7,871.36 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA10018 号）。公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,871.36 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司共预先使用自有资金支付募投项目所需资金 17,143,999.61 元，已经进行置换 14,828,266.48 元，尚未进行置换 2,315,733.13 元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司根据 2024 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本公司根据 2025 年 12 月 19 日公司召开第二届审计委员会第二次会议和 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司与部分募集专户签订协定存款协议，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 5,000.00 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	存放银行	产品名称	金额	起息日	到期日或支取日	存款利率	产品类型
1	中国农业银行靖江城南支行	7 天通知存款	2,000.00	2026/1/13	不适用	0.65%	通知存款
2	中国农业银行靖江城南支行	7 天通知存款	1,000.00	2026/1/13	不适用	0.65%	通知存款
3	中国农业银行靖江城南支行	3 个月定期存款	1,000.00	2026/1/13	2026/4/13	0.80%	定期存单
4	中国农业银行靖江城南支行	3 个月定期存款	1,000.00	2026/1/13	2026/4/13	0.80%	定期存单
正在履行合计			5,000.00				

（五）前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金实际募集资金金额为 51,222.43 万元，前次募集资金未承诺效益，截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金项目均处于建设期，实际投资金额占实际募集资金金额比例超过 70%，按公司战略规划有序投入使用。

（六）前次募集资金节余使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，补充流动资金已使用完毕，其他前次募集资金项目仍处于建设期，不存在募集资金节余情况。

（七）未使用完毕的前次募集资金计划和安排

截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金 15,024.14 万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），尚未使用募集资金（不含孳息及手续费净额）占前次募集资金净额比例为 29.33%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 21 日出具《关于江苏先锋精密科技股份有限公司截至 2026 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA12001 号），认为公司管理层编制的截至 2026 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了先锋精科截至 2026 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况。

四、前次募集资金项目实施后有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等情况

公司前次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，实施后整体上有利于提升公司资产质量、营运能力和盈利能力。具体情况如下：

（一）靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目

靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目建成后将进一步提升公司的规模化生产能力，优化精密加工、真空钎焊、洁净清洗等核心生产工艺，提升生产

效率与产品良率，强化对下游半导体设备厂商的批量交付能力，提升公司营运稳定性与盈利能力。

公司通过本次产能扩容，显著提升了刻蚀、薄膜沉积设备核心金属精密零部件的产能规模，有效缓解了此前产能不足的瓶颈问题，支撑了公司近年来营业收入的持续增长，项目实施后公司相关产品的市场交付份额稳步提升，为公司 2023 年度至 2025 年度营业收入的稳步增长提供了坚实产能保障。

（二）无锡先研设备模组生产与装配基地项目

无锡先研设备模组生产与装配基地项目建成后将进一步提升公司的设备模组化产品生产能力，优化模组集成、装配测试、全流程验证等生产工艺，提升生产效率与产品附加值，强化整体解决方案供应能力，提升公司综合竞争力与持续盈利能力。

公司通过本次项目建设，实现了半导体设备核心零部件向模组化产品的延伸拓展，丰富了公司的产品结构，提升了单客户订单价值与综合服务能力，相关模组产品已实现批量供应，有效优化了公司营收结构。

（三）无锡先研精密制造技术研发中心项目

无锡先研精密制造技术研发中心项目建成后将进一步提升公司的高端精密零部件研发能力，完善精密加工、材料改性、洁净制造等核心技术研发体系，加快研发进度，提升公司技术壁垒与长期竞争力，为盈利能力的持续提升奠定基础。

公司通过研发中心建设，为公司产品结构升级与国产替代进程提供了技术支撑，研发成果已逐步转化为实际的产品竞争力，为公司未来盈利增长储备了新的动能。

（四）补充流动资金项目

补充流动资金项目的实施，为公司业务的快速扩张提供了必要的资金支撑，有效缓解了公司营运资金紧张的压力，助力公司进一步加大市场开拓力度、强化核心竞争优势。同时，本次募资有效降低了公司债务融资规模，公司偿债能力得到增强，经营风险与财务风险水平同步下降。

五、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用



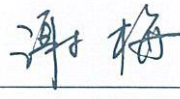

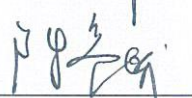


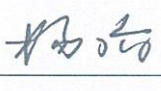
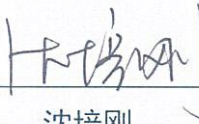
公司前次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务及科技创新领域展开，其中“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”“无锡先研精密制造技术研发中心项目”是对公司半导体精密零部件、模组的产能扩充及升级；“补充流动资金”保障了公司对扩产、研发和创新的资金支持，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

 游利	 XU ZIMING	 XIE MEI
 管明月	 陈彦娥	 李镝
 于赞	 杨翰	 沈培刚

审计委员会委员：

 沈培刚	 于赞	 杨翰
--	--	---

董事以外的高级
管理人员：

 杨丽华	 刘国辉
--	---

江苏先锋精密科技股份有限公司

2026年4月24日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：


游利

2026 年 4 月 24 日

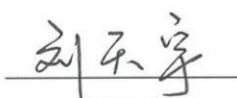
三、保荐人声明

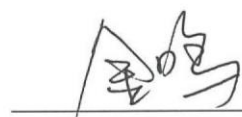
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


李雨滋

保荐代表人：


刘天宇


金鸣

法定代表人：


江禹

华泰联合证券有限责任公司



本人已认真阅读江苏先锋精密科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理：


马骁

保荐人董事长：


江禹

华泰联合证券有限责任公司



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



上海市锦天城律师事务所（盖章）

经办律师：


阙莉娜

负责人：



沈国权

经办律师：


李珊珊



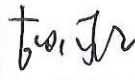

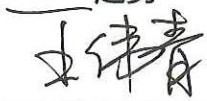



2026 年 4 月 24 日

五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供江苏先锋精密科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：

			
赵勇	中国注册会计师 赵勇	胡国仁	中国注册会计师 胡国仁
			
王伟青	中国注册会计师 王伟青	杨天航	中国注册会计师 杨天航

会计师事务所负责人：

	
杨志国	杨志国




立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
(公章)

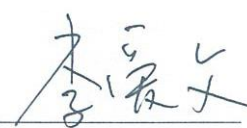
2026年 4 月 14 日

六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明

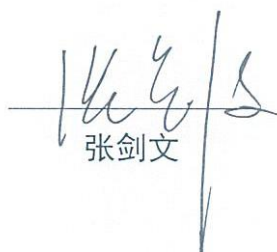
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：


刘惠琼


李爱文

评级机构负责人：


张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2026年4月24日



七、董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。



江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

第十节 备查文件

- (一) 发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 会计师出具的关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
- (五) 盈利预测报告及其审核报告（如有）；
- (六) 拟收购资产的评估报告及有关审核文件（如有）；
- (七) 资信评级报告（如有）；
- (八) 中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- (九) 其他与本次发行有关的重要文件。